

北京确安科技股份有限公司 股份报价转让说明书



推荐主办券商



上海市西藏中路 336 号 邮政编码：200001

电话：021-53519888 传真：021-63609593

二〇一一年七月二十五日

目 录

释义.....	1
第一章 声明.....	5
第二章 风险及重大事项提示.....	6
第三章 批准试点和推荐备案情况.....	9
第四章 股份挂牌情况.....	10
第五章 公司基本情况.....	12
一、公司基本情况.....	12
二、历史沿革.....	13
三、主要股东情况.....	21
四、员工情况.....	24
五、股权结构图.....	26
六、内部组织结构图.....	27
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	28
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	28
二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议.....	30
三、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施.....	31
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	31
第七章 公司业务和技术情况.....	32
一、业务情况.....	32
二、主要产品的技术含量、可替代性.....	38
三、所处行业基本情况.....	40
四、公司面临的主要竞争情况.....	55
五、知识产权和非专利技术.....	58
六、核心技术情况.....	67
七、研发情况.....	67
八、供应商及前五名客户情况.....	70
第八章 公司业务发展目标及其风险因素.....	74
一、未来两年发展计划.....	74
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及应对措施.....	76
第九章 公司治理.....	83
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	83
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情	

况.....	86
三、同业竞争情况.....	88
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	90
五、公司管理层的诚信状况.....	91
第十章 公司财务会计信息.....	92
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表.....	92
二、公司报告期的主要财务指标.....	105
三、公司报告期利润形成的有关情况.....	106
四、公司报告期主要资产情况.....	112
五、公司报告期重大债务情况.....	126
六、公司报告期股东权益情况.....	129
七、关联方及关联交易.....	129
八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	134
九、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	134
十、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析.....	135
第十一章 备查文件.....	137

释义

本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、确安科技	指	北京确安科技股份有限公司
有限公司、华大泰思特	指	北京确安科技股份有限公司的前身北京华大泰思特半导体检测技术有限公司
中国华大	指	中国华大集成电路设计集团有限公司及其前身中国华大集成电路设计有限责任公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
华大电子	指	北京中电华大电子设计有限责任公司
中电控股	指	中国电子集团控股有限公司
南京微盟	指	南京微盟电子有限公司
国民技术	指	国民技术股份有限公司
国投高科	指	国投高科技投资有限公司
北科永丰	指	北京北科永丰科技发展有限公司
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
本说明书、本股份报价转让说明书	指	北京确安科技股份有限公司股份报价转让说明书
股东大会	指	北京确安科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京华大泰思特半导体检测技术有限公司股东会
董事会	指	北京确安科技股份有限公司或北京华大泰思特半导体检测技术有限公司董事会
监事会	指	北京确安科技股份有限公司或北京华大泰思特半导体检测技术有限公司监事会
公司章程	指	北京确安科技股份有限公司或北京华大泰思特半导体检测技术有限公司章程

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上海证券、推荐主办券商	指	上海证券有限责任公司
内核小组	指	上海证券有限责任公司报价转让业务代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
挂牌	指	北京确安科技股份有限公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IC/集成电路	指	在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统。
Wafer/晶圆	指	将单晶硅晶棒切割所得的一片一片薄薄的圆片，即是晶圆，或硅晶圆。
Foundry 模式	指	半导体产业存在两种商业模式之一，亦称为垂直分工模式，20 世纪 90 年代初兴起的一种新 IC 产业模式，该模式由知识产权（IP）供应商、无生产线设计公司（Fabless）、代工厂商（Foundry）以及封装企业（Package）以及测试企业（Testing）等组成。
IDM 模式	指	IDM 是英文 Integrated Device Manufactrue 的缩写，即垂直集成模式，IDM 模式的特点是，企业经营范围涵盖了芯片设计、生产制造、封装测试各环节，甚至延伸至下游终端。美国和日本半导体

		产业主要采用这一模式，IDM 企业规模大、投入高，典型的 IDM 企业有：英特尔、三星、德州仪器、东芝和意法半导体。
SoC	指	SoC 是英文 System-on-Chip 的缩写，即系统级芯片，指的是在单个硅片上集成子系统或系统，包括处理器、高密度逻辑电路、模拟和混合信号电路、存储器等。
RF	指	射频技术 (Radio Frequency)，是指利用无线频率变换对承载信息进行空间传播、并完成承载信息收发或读写的技术
CPU	指	CPU (Central Processing Unit) 中央处理器，计算机的心脏，包括运算部件和控制部件，是完成各种运算和控制的核⼼，也是决定计算机性能的最重要的部件。
DSP	指	DSP 芯片，也称数字信号处理器，是一种具有特殊结构的微处理器，具有专门的硬件乘法器，广泛采用流水线操作，提供特殊的 DSP 指令，可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。
MCU	指	MCU (Micro Controller Unit) 中文名称为多点控制单元，又称单片微型计算机 (Single Chip Microcomputer)，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。
FPGA	指	FPGA (Field-Programmable Gate Array)，即现场可编程门阵列，它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展

		<p>的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。</p>
Turnkey 业务	指	<p>集成电路整包服务，是公司针对设计公司的需求，依托测试服务优势，整合上下游资源，结合密切合作的封装、制造合作伙伴，为设计公司提供更为全面的整包服务，如“封装+成品测试”，“晶圆测试+封装+成品测试”，或“晶圆制造+晶圆测试+封装+成品测试”。</p>

第一章 声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、行业波动风险

从过去 30 年来看，全球集成电路行业呈现出市场呈周期性波动的特点，行业的发展与社会经济发展存在较强的关联性，全球经济状况强烈影响着集成电路产业的周期变化，经济的衰退一般同时带来集成电路市场的衰退。公司作为集成电路产业中的一员，行业波动对公司经营会产生一定的影响。

二、核心技术泄密风险

公司核心技术主要是围绕集成电路测试及其相关领域的新技术，公司核心技术在行业内具备一定的先进性，是公司核心竞争力的重要组成部分，对公司经营和发展起着重要作用。核心技术一旦泄密将会给公司带来不利影响。

三、行业政策风险

集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家给予了高度重视和大力支持，国家出台的一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了优良的政策环境，促进集成电路产业十年的快速发展。由此可见国家对于集成电路产业政策扶持对产业发展起到了至关重要的作用，若政策一旦发生变化将对集成电路产业未来能否持续、快速发展产生一定的影响，从而影响公司主营业务的发展。

四、关联交易风险

2008 年、2009 年和 2010 年公司向关联方销售金额分别为 1290.86 万元、1099.35 万元和 1496.50 万元，分别占当年销售收入的 80.05%、82.63%以及 85.72%；公司向关联方中国华大租赁测试设备，租赁价格为每年 30 万元，分别占 2008 年、2009 年和 2010 年采购的金额是 6.14%、12.85%和 6.85%。公司与关

关联方存在大量的关联交易，主要包括向华大电子、南京微盟、国民技术等集团成员企业提供测试服务，以及向公司大股东中国华大租赁测试设备。如果上述关联交易偏离市场化和公允性原则或者未能履行相关决策和程序，可能会给公司生产经营带来负面影响，进而损害公司以及股东的利益。此外，华大电子也是公司最大的客户，2008 年至今每年销售额占公司收入均超过 75%，若该客户测试业务大幅度下降，则可能会在短期内造成公司收入减少。

五、实际控制人没有出具避免同业竞争承诺函的风险

公司控股股东是中国华大集成电路设计集团有限公司，公司实际控制人是中国电子信息产业集团有限公司。

中国华大作为公司控股股东已经出具了《避免同业竞争承诺函》，表示中国华大目前未从事或参与、未来也不从事或参与与公司存在同业竞争的业务。

中国电子是国务院国资委直接管理的国内从事电子信息产业研发、制造、销售和服务的特大型国有独资集团公司，作为国家对电子信息产业进行布局和管理战略平台，肩负着对集成电路及其子行业投资和管理的使命。虽然公司目前是中国电子旗下唯一一家专业第三方集成电路测试企业，由于集成电路测试业务贯穿于集成电路行业的各环节，为严谨起见，公司实际控制人中国电子未能出具《避免同业竞争的承诺函》。

六、公司生产场所实际租赁期限超过二十年的风险

2005 年公司向北科永丰购买了位于北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层 202 号的房屋，作为公司办公、生产场地，双方于 2005 年 11 月 1 日签订了《房屋买卖合同》。合同签订后，公司向北科永丰一次性支付了全部购房款共计 9,712,720.00 元。由于北科永丰方面的原因，房屋权属转让登记手续无法办理，经友好协商，双方同意将房屋产权转让关系变为房产租赁关系，北科永丰将上述房屋分为三期租赁给公司。经公司董事会和股东会批准，公司与北科永丰于 2009 年 12 月 21 日签订了三份房屋租赁协议：《房屋租赁合同（2005 年 11 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日）》、《房屋租赁合同（2024 年 5 月 21 日至 2044 年 5 月 20 日）》、《房屋租赁合同（2044 年 5 月 21 日至 2054 年 5 月 20 日）》，共

计 48.5 年。

根据《合同法》第 214 条 “租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。” 的规定，由于公司生产场地实际租赁期限超过二十年，超过二十年部分的《房屋租赁合同》可能会被认定无效。若北科永丰与公司因房屋租赁合同发生纠纷向人民法院提起诉讼，公司可能会因房屋实际租赁期限超过二十年而败诉。

第三章 批准试点和推荐备案情况

根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》的规定和本公司 2010 年临时股东大会决议，本公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司进入代办股份转让系统进行股份报价转让的申请。2010 年 11 月 30 日，中关村科技园区管理委员会以中科园函【2010】273 号文，下达了《关于同意北京确安科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

上海证券作为本公司的推荐主办券商，对本公司进行了尽职调查和内部审核。经上海证券内核小组审核、表决通过，同意推荐本公司挂牌，并出具了《上海证券有限责任公司关于推荐北京确安科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的报告》。2010 年 12 月 30 日，上海证券向证券业协会报送了推荐北京确安科技股份有限公司挂牌的备案文件。

2011 年 7 月 6 日，证券业协会出具了《关于推荐北京确安科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函【2011】215 号），对上海证券报送的推荐北京确安科技股份有限公司挂牌报价文件予以备案。

第四章 股份挂牌情况

股份简称：确安科技

股份代码：430094

挂牌日期：2011年7月28日

公司股本总额为 23,800,000 股。

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。控股股东和实际控制人依照《中华人民共和国公司法》的规定认定。”

第十六条规定：“挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理适用前条的规定。”

第十七条规定：“挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让。”

《公司章程》第二十五条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。”

董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不

得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

截至本股份报价转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，无可报价转让股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

第五章 公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称：北京确安科技股份有限公司

英文名称：BEIJING CHIPADVANCED TECHNOLOGY INC.

注册资本：2380 万元

法定代表人：刘晋平

有限公司成立日期：2004 年 7 月 23 日

股份公司成立日期：2010 年 11 月 12 日

住所：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层

电话：010-58717623

传真：010-58717581

电子邮箱：infor@chipadvanced.cn

互联网网址：<http://www.chipadvanced.cn>

信息披露负责人：晏 云

所属行业：电子元器件制造业——集成电路测试行业

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发；货物进出口。（法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的、不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动。）。

主营业务：向集成电路设计、制造及封装等集成电路企业提供第三方集成电路测试服务，包括集成电路设计验证、集成电路晶圆测试（中测）、集成电路成品测试（成品测试）以及其他测试服务。

二、历史沿革

（一）公司前身北京华大泰思特半导体检测技术有限公司历史沿革

1、公司设立情况

北京华大泰思特半导体检测技术有限公司是经北京市工商行政管理局批准的有限责任公司，公司成立于2004年7月23日。企业法人营业执照注册号：1101081734631；注册地址：北京市海淀区北三环中路31号泰思特大厦四层；注册资本：2000万元；法定代表人：尹凤财；公司经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	出资人	货币出资 (万元)	实物出资 (万元)	出资总额 (万元)	出资比例 (%)
1	中国华大集成电路设计 有限责任公司	400.00	500.00	900.00	45.00
2	北京自动测试技术研究所	300.00	200.00	500.00	25.00
3	北京中电华大电子设计 有限责任公司	200.00	0.00	200.00	10.00
4	肖 钢	70.00	0.00	70.00	3.50
5	张志宏	70.00	0.00	70.00	3.50
6	宋鑫林	65.00	0.00	65.00	3.25
7	柳 炯	65.00	0.00	65.00	3.25
8	尹凤财	65.00	0.00	65.00	3.25
9	张 东	65.00	0.00	65.00	3.25
	合 计	1300.00	700.00	2000.00	100.00

有限公司设立时的货币出资没有验资机构出具的验资报告。根据2004年2月15日实施的《北京市工商局改革市场准入制度优化市场发展环境若干意见》第13条规定：投资人以货币形式出资的，应到设有“注册资本(金)入资专户”的银行开立“企业注册资本(金)专用帐户”交存货币注册资本(金)。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。因此，本次货币出资没有验资报告符合当时北京市工商局的相关规定，从入资银行出具的《交存入资资金报告单》来看，公司股东货币出资已真实到位。

北京中企华资产评估有限责任公司出具了编号为：中企华评报字（2004）第 138 号的《中国华大集成电路设计有限责任公司拟以部分资产出资项目资产评估报告书》，评估由中国华大集成电路设计有限责任公司投入的实物资产总值为 500 万元。北京科之源资产评估有限责任公司出具了编号为：科评报字[2004]第 058 号的《北京自动测试技术研究所资产评估报告书》，评估由北京自动测试技术研究所投入的实物资产总值为 200 万元。

2005 年 2 月 28 日，利安达信隆会计师事务所出具《资产转移鉴证报告》（利安达专字（2005）第 A1110 号），证实中国华大集成电路设计有限责任公司投入的实物资产 500 万元已经于 2004 年 8 月 6 日投入公司，北京自动测试技术研究所投入的实物资产 200 万元已经于 2004 年 8 月 5 日投入华大泰思特，公司股东的实物出资已真实到位。

2、有限公司第一次股东名称变更

2005 年 9 月 20 日，公司股东之一中国华大集成电路设计有限责任公司经北京市工商行政管理局核准变更为中国华大集成电路设计集团有限公司。

2005 年 12 月 16 日，公司在北京市工商行政管理局办理了股东名称变更手续，并相应修改章程。

2005 年 12 月 16 日，北京市工商行政管理局核准了上述变更备案。

3、有限公司第一次法定代表人、董事、经理变更

尹凤财因工作需要调离有限公司股东单位中国华大集成电路设计集团有限公司。不再担任有限公司董事职务。

2006 年 5 月 31 日上午 9 时，有限公司召开董事会，会议形成决议：同意免去尹凤财董事长职务。

2006 年 6 月 1 日上午 9 时，有限公司召开股东会，会议形成决议：同意免去尹凤财的董事职务，选举白明辉为公司董事。

2006 年 6 月 1 日上午 9 时 40 分，有限公司召开董事会，会议形成决议：选举白明辉为公司新任董事长。

根据《章程》，董事长为公司的法定代表人，法定代表人相应的变更为白明辉。

2006 年 5 月 26 日上午 9 时，有限公司召开董事会，会议形成决议：解聘肖

钢总经理职务，选举陆剑侠为公司新任总经理。

2006年6月28日，有限公司在北京市工商行政管理局办理了上述事项变更手续。

2006年6月28日，北京市工商行政管理局核准了上述变更备案。

4、有限公司第二次法定代表人、董事变更及第一次监事变更

白明辉因工作调动，不再担任有限公司董事职务。

2008年7月24日上午9时，有限公司召开股东会，会议形成决议：同意免去白明辉的董事的职务，选举刘晋平、张东、刘伟平、肖钢、宋矗林董事职务，免去张文雄、刘坚监事职务，选举蔡艳玲、姜军成、张志杰、程京霞为监事；

2008年7月25日上午9时，有限公司召开董事会，会议形成决议：同意白明辉辞去董事长职务。

2008年7月25日上午10时，有限公司召开董事会，会议形成决议：选举刘晋平为新任董事长。

根据《章程》，董事长为公司的法定代表人，法定代表人相应的变更为刘晋平。

2008年8月26日，有限公司在北京市工商行政管理局办理了上述事项变更手续。

2008年8月26日，北京市工商行政管理局核准了上述变更备案。

5、有限公司第一次注册号变更

2008年8月26日，有限公司收到北京市工商行政管理局海淀分局的通知，企业注册号依照国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》变更为：110108007346315。

6、有限公司第一次经营范围变更

2008年9月2日，有限公司召开股东会，同意增加经营范围：“货物进出口”，并相应修改章程。

修改后的经营范围为：货物进出口、法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经

工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

2008年9月24日，有限公司在北京市工商行政管理局办理了上述事项变更手续。

2008年9月24日，北京市工商行政管理局核准了上述变更备案。

7、有限公司第一次股权转让

2010年3月16日，有限公司在北京市海淀区北三环中路31号泰思特大厦四层召开股东会，会议形成以下决议，同意增加新股东吴江、徐文、邓辉、晏云、李亮、杨振宇、王国君、李瑞麟、张蕴书、任立娟、赵巍、石志刚、房宁、程京霞、孙昕、刘进伟、白洁、吉国凡、王彤。

2010年3月22日，有限公司在北京市工商行政管理局办理了上述事项变更手续。

2010年3月22日，北京市工商行政管理局核准了上述变更备案。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

序号	出资人	货币出资 (万元)	实物出资 (万元)	出资总额 (万元)	出资比例 (%)
1	中国华大集成电路设计 有限责任公司	400.00	500.00	900.00	45.000
2	北京自动测试技术研究 所	300.00	200.00	500.00	25.000
3	北京中电华大电子设计 有限责任公司	200.00	0.00	200.00	10.000
4	张 东	65.00	0.00	65.00	3.250
5	邓 辉	55.00	0.00	55.00	2.750
6	王 彤	55.00	0.00	55.00	2.750
7	晏 云	46.00	0.00	46.00	2.300
8	柳 炯	31.00	0.00	31.00	1.550
9	王国君	30.00	0.00	30.00	1.500
10	肖 钢	28.00	0.00	28.00	1.400
11	任立娟	28.00	0.00	28.00	1.400
12	吉国凡	27.00	0.00	27.00	1.350
13	程京霞	10.00	0.00	10.00	0.500
14	李瑞麟	6.00	0.00	6.00	0.300
15	徐 文	5.00	0.00	5.00	0.250
16	张蕴书	3.00	0.00	3.00	0.150
17	吴 江	3.00	0.00	3.00	0.150

18	白洁	2.00	0.00	2.00	0.100
19	刘进伟	1.00	0.00	1.00	0.050
20	李亮	1.00	0.00	1.00	0.050
21	杨振宇	1.00	0.00	1.00	0.050
22	房宁	1.00	0.00	1.00	0.050
23	赵巍	1.00	0.00	1.00	0.050
24	石志刚	0.50	0.00	0.50	0.025
25	孙昕	0.50	0.00	0.50	0.025
合计		1300.00	700.00	2000.00	100.000

本次股权转让的价格是经转让双方友好协商，按照原始出资价格确定的。转让方、受让方与公司关系如下：

转让方			受让方		
姓名	转让出资数 (万元)	与公司关系	姓名	受让出资数 (万元)	与公司关系
肖钢	70.00	公司员工	吉国凡	27.00	公司员工
			任立娟	28.00	外部人员
			程京霞	10.00	公司员工
			柳炯	2.00	公司员工
			刘进伟	1.00	公司员工
			李亮	1.00	公司员工
			杨震宇	1.00	公司员工
宋鑫林	65.00	公司董事、 控股股东单 位员工	肖钢	28.00	公司员工
			晏云	12.00	公司员工
			王彤	13.00	公司员工
			柳炯	10.00	公司员工
			白洁	2.00	公司员工
柳炯	65.00	公司员工	邓辉	55.00	外部人员
			徐文	5.00	公司员工
			吴江	3.00	公司员工
			房宁	1.00	公司员工
			赵巍	1.00	公司员工
张志宏	70.00	外部股东	晏云	34.00	公司员工
			王国君	30.00	公司员工
			李瑞麟	6.00	公司员工
尹凤财	65.00	前任董事	王彤	42.00	公司员工
			柳炯	19.00	公司员工
			张蕴书	3.00	公司员工
			孙昕	0.50	公司员工
			石志刚	0.50	公司员工

转让方肖钢、柳炯为公司员工，宋鑫林为公司董事以及公司控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司员工，尹凤财为公司前任董事。张志宏为外部股东，

与公司不存在关联关系。受让方吴江、徐文、晏云、李亮、杨振宇、王国君、李瑞麟、张蕴书、赵巍、石志刚、房宁、程京霞、孙昕、刘进伟、白洁、吉国凡、王彤为公司员工。邓辉、任丽娟为公司外部人员，与公司不存在关联关系。

本次股权转让于 2010 年 3 月 16 日经过公司股东会的批准，公司其他股东放弃了优先购买权。转让双方签订了《出资转让协议》，受让方实际支付了对价。本次股权转让的价格、转让程序及过程是合法有效的。

8、有限公司第三次董事变更、第二次经理变更、第一次注册地址变更

2010 年 3 月 30 日，有限公司召开股东会，会议决议免去刘伟平董事职务，选举姜世平为新任董事，变更公司注册地址为：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层。

2010 年 3 月 30 日，有限公司董事会召开会议，会议决议聘任公司新一届经营班子，王彤为总经理。

2010 年 4 月 21 日，有限公司在北京市工商行政管理局办理了上述事项变更手续。

2010 年 4 月 21 日，北京市工商行政管理局核准了上述变更备案。

9、有限公司第二次股权转让

2010 年 10 月 15 日，有限公司在北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层会议室召开股东会，会议形成以下决议：

- (1) 同意张东将实缴 65 万元货币出资转让给张惠福；
- (2) 同意任立娟将实缴 28 万元货币出资转让给胡冬梅；

公司其他原股东放弃优先购买权。

2010 年 10 月 20 日，有限公司在北京市工商行政管理局办理了上述事项变更手续。

2010 年 10 月 25 日，北京市工商行政管理局核准了上述变更备案。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

序号	出资人	货币出资 (万元)	实物出资 (万元)	出资总额 (万元)	出资比例 (%)
1	中国华大集成电路设计 有限责任公司	400.00	500.00	900.00	45.000

2	北京自动测试技术研究所	300.00	200.00	500.00	25.000
3	北京中电华大电子设计有限责任公司	200.00	0.00	200.00	10.000
4	张惠福	65.00	0.00	65.00	3.250
5	邓辉	55.00	0.00	55.00	2.750
6	王彤	55.00	0.00	55.00	2.750
7	晏云	46.00	0.00	46.00	2.300
8	柳炯	31.00	0.00	31.00	1.550
9	王国君	30.00	0.00	30.00	1.500
10	肖钢	28.00	0.00	28.00	1.400
11	胡冬梅	28.00	0.00	28.00	1.400
12	吉国凡	27.00	0.00	27.00	1.350
13	程京霞	10.00	0.00	10.00	0.500
14	李瑞麟	6.00	0.00	6.00	0.300
15	徐文	5.00	0.00	5.00	0.250
16	张蕴书	3.00	0.00	3.00	0.150
17	吴江	3.00	0.00	3.00	0.150
18	白洁	2.00	0.00	2.00	0.100
19	刘进伟	1.00	0.00	1.00	0.050
20	李亮	1.00	0.00	1.00	0.050
21	杨振宇	1.00	0.00	1.00	0.050
22	房宁	1.00	0.00	1.00	0.050
23	赵巍	1.00	0.00	1.00	0.050
24	石志刚	0.50	0.00	0.50	0.025
25	孙昕	0.50	0.00	0.50	0.025
合计		1300.00	700.00	2000.00	100.000

本次股权转让的价格是经转让双方友好协商，按照原始出资价格确定的。转让方、受让方与公司关系如下：

转让方			受让方		
姓名	转让出资数 (万元)	与公司关系	姓名	受让出资数 (万元)	与公司关系
张东	65.00	公司董事、 股东单位法定代表人	张惠福	65.00	外部人员
任立娟	28.00	外部股东	胡冬梅	28.00	外部人员

转让方张东为公司董事以及公司股东北京自动测试技术研究所法定代表人。任丽娟为外部股东，与公司不存在关联关系。受让方张惠福、胡冬梅均为公司外部人员，与公司不存在关联关系。

本次股权转让于2010年10月15日经过公司股东会的批准，公司其他股东

放弃了优先购买权。转让双方签订了《出资转让协议》，受让方实际支付了对价。本次股权转让的价格、转让程序及过程是合法有效的。

（二）有限公司整体变更为股份公司

2010年10月27日，有限公司股东会一致同意现有25名股东作为股份公司发起人，由北京华大泰思特半导体检测技术有限公司整体变更为北京确安科技股份有限公司。

2010年11月12日，股份公司第一次股东大会暨创立大会召开，通过设立公司的议案，并选举了董事、监事。

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的编号为：利安达审字【2010】第1237号《审计报告》（审计基准日为2010年3月31日），有限公司账面净资产审计值为：35,660,688.15元，其中的2380万元折成北京确安科技股份有限公司2380万股，净资产扣除股本后的部分转为股份公司的资本公积金，折股后的股份公司的注册资本为2380万元，股本为2380万股。

公司整体改制经利安达会计师事务所有限责任公司出具的编号为：利安达验字[2010]第A1060号《验资报告》审验并办理了工商变更登记。北京市工商行政管理局于2010年11月12日向股份公司颁发了注册号为110108007346315的《企业法人营业执照》。

此次变更后公司的注册资本为2380万元，股份总额为2380万股，此次工商变更登记后的股权结构如下：

发起人名称	认购股份数额 (万股)	实缴股份数额 (万股)	出资比例 (%)	出资方式
中国华大集成电路设计集团有限公司	1071.000	1071.000	45.000	净资产
北京自动测试技术研究所	595.000	595.000	25.000	净资产
北京中电华大电子设计有限责任公司	238.000	238.000	10.000	净资产
张惠福	77.350	77.350	3.250	净资产
王彤	65.450	65.450	2.750	净资产
邓辉	65.450	65.450	2.750	净资产
晏云	54.740	54.740	2.300	净资产

柳 炯	36.890	36.890	1.550	净资产
王国君	35.700	35.700	1.500	净资产
肖 钢	33.320	33.320	1.400	净资产
胡冬梅	33.320	33.320	1.400	净资产
吉国凡	32.130	32.130	1.350	净资产
程京霞	11.900	11.900	0.500	净资产
李瑞麟	7.140	7.140	0.300	净资产
徐 文	5.950	5.950	0.250	净资产
张蕴书	3.570	3.570	0.150	净资产
吴 江	3.570	3.570	0.150	净资产
白 洁	2.380	2.380	0.100	净资产
刘进伟	1.190	1.190	0.050	净资产
李 亮	1.190	1.190	0.050	净资产
杨振宇	1.190	1.190	0.050	净资产
房 宁	1.190	1.190	0.050	净资产
赵 巍	1.190	1.190	0.050	净资产
石志刚	0.595	0.595	0.025	净资产
孙 昕	0.595	0.595	0.025	净资产
合计	2380.000	2380.000	100.000	/

（三）有限公司整体变更为股份公司的审批情况

2011年4月29日，国务院国资委出具了编号为：国资产权[2011]286号的《关于北京确安科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》。同意北京华大泰思特半导体检测技术有限公司整体变更设立北京确安科技股份有限公司的国有股权管理方案。

三、主要股东情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为中国华大集成电路设计集团有限公司。中国华大持有公司1071万股股份，占公司总股本的45%。

中国华大集成电路设计集团有限公司，注册登记号：1100001618870；法定代表人：卢明；住所：北京市朝阳区高家园一号；注册资本：36,700万元；经营范围：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生

产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

中国电子信息产业集团有限公司是国务院国资委直接管理的国有独资特大型集团公司，代表国务院国资委对中国华大履行出资人职责，为中国华大的控股股东及公司的实际控制人。中国电子通过中国华大间接控制公司 1071 万股股份，通过华大电子间接控制公司 238 万股股份，中国电子合计间接控制公司 1309 万股股份，占公司总股本的 55%。

中国电子信息产业集团有限公司，注册登记号：100000000010245；法定代表人：熊群力；住所：北京市万寿路 27 号；注册资本：793,002.2 万元。经营范围：许可经营项目：（无）；一般经营项目：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

（二）持有公司股份 5%以上股东的基本情况

北京自动测试技术研究所，注册登记号：110000001883200；法定代表人：张东；住所：北京市海淀区北三环中路 1 号；注册资本：2083 万元人民币；企业类型：全民所有制；经营范围：集成电路测试技术方法、设备及系统的研制开发、销售；工业自动化控制设备、仪器仪表、办公设备、计算机软硬件及外围设备、集成电路的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；编辑、出版《电子测试》期刊；设计和制作印刷品广告；利用自有《电子测试》杂志发布广告。

北京自动测试技术研究所持有公司 595 万股股份，占公司股份总数的 25%。

北京中电华大电子设计有限责任公司，注册登记号：110000003868306；法定代表人：董浩然；住所：北京市朝阳区利泽中路2号望京科技园A座五、六层；注册资本：5000万元人民币；企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；经营范围：许可经营项目：集成电路芯片模块封装生产。一般经营项目：集成电路设计、开发与销售；软件产品开发、销售及服务；整机技术与集成电路应用产品开发与销售；技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

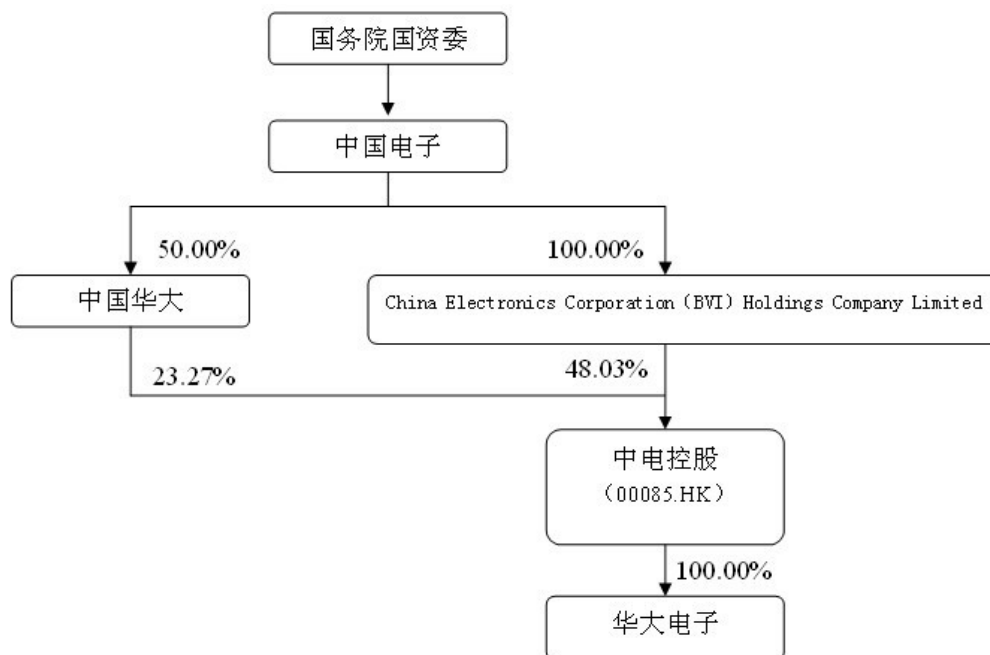
北京中电华大电子设计有限责任公司持有公司238万股股份，占公司股份总数的10%。

（三）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系

序号	股 东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	中国华大集成电路设计集团有限公司	1071.00	45.00%
2	北京自动测试技术研究所	595.00	25.00%
3	北京中电华大电子设计有限责任公司	238.00	10.00%
4	张惠福	77.35	3.25%
5	王 彤	65.45	2.75%
6	邓 辉	65.45	2.75%
7	晏 云	54.74	2.30%
8	柳 炯	36.89	1.55%
9	王国君	35.70	1.50%
10	肖 钢	33.32	1.40%

公司第一大股东为中国华大，第三大股东为华大电子。中国华大、华大电子同为中电控制的下属企业。

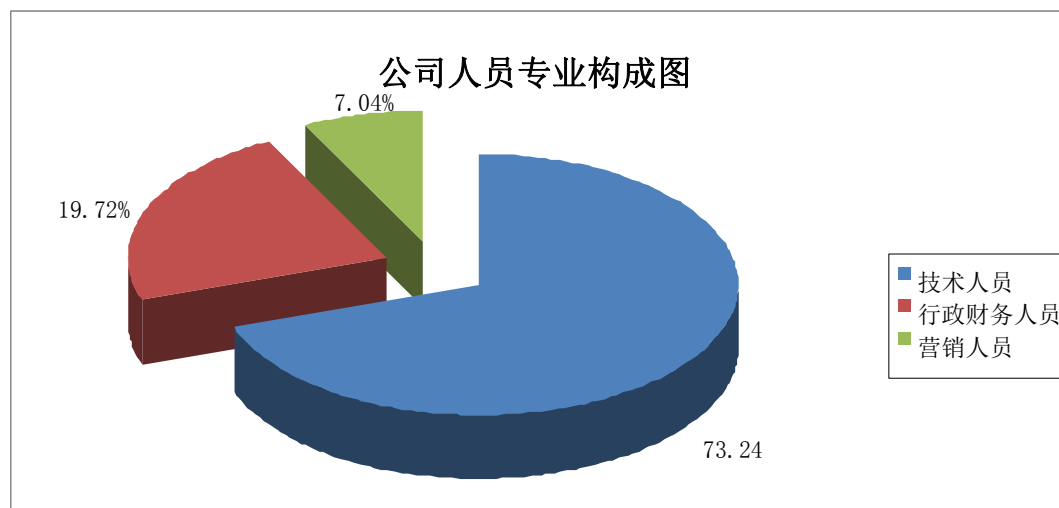
华大电子的全资股东为中电控股。中国电子通过其全资子公司 China Electronics Corporation (BVI) Holdings Company Limited 间接持有中电控股已发行股本的48.03%，通过中国华大间接持有中电控股已发行股本的23.27%，中国电子合计间接持有中电控股已发行股本的71.3%。中国华大持有华大电子全资股东中电控股23.27%的股份，具体情况如下图所示：



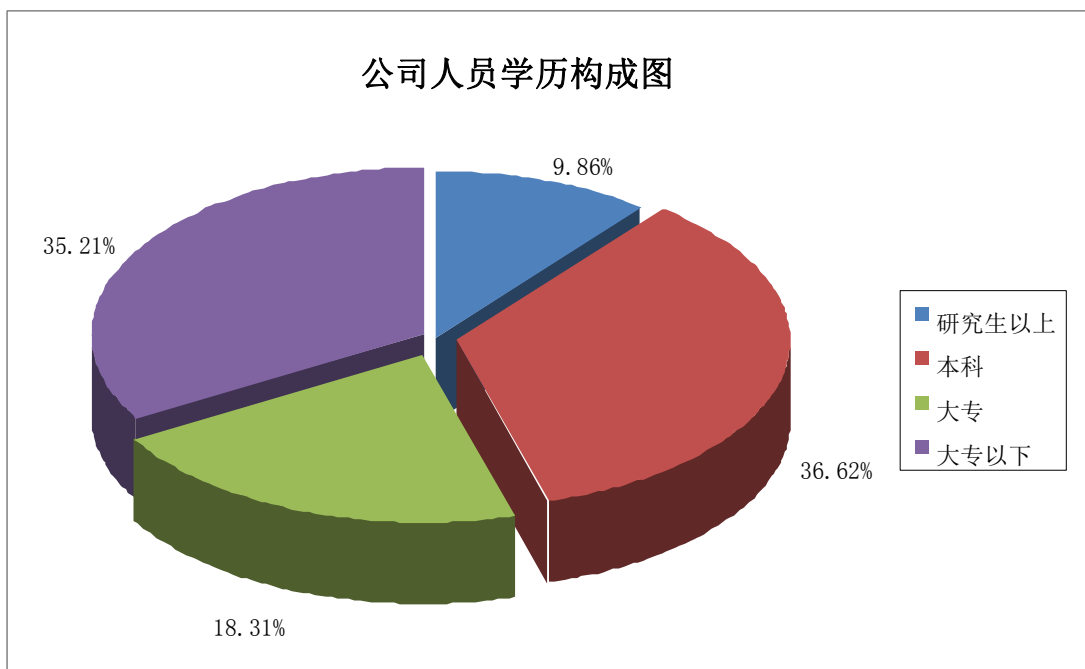
除上述情况外，公司前十大股东之间无其他关联方关系。

四、员工情况

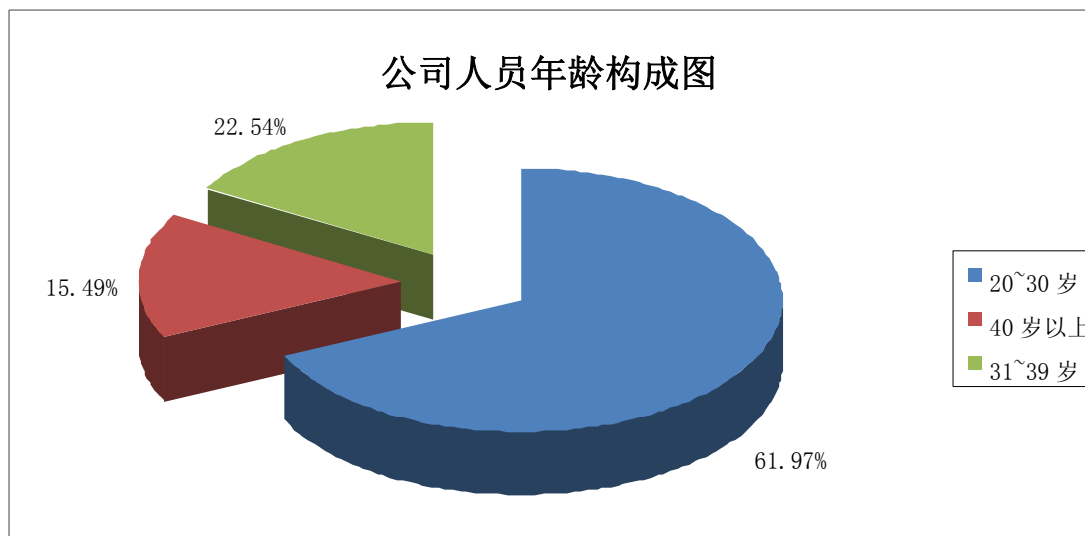
- 1、截止 2011 年 5 月 31 日，本公司人员总人数为 71 人。
- 2、按专业划分，技术人员 52 人，占比为 73.24%；行政财务人员 14 人，占比为 19.72%；营销人员 5 人，占比为 7.04%。



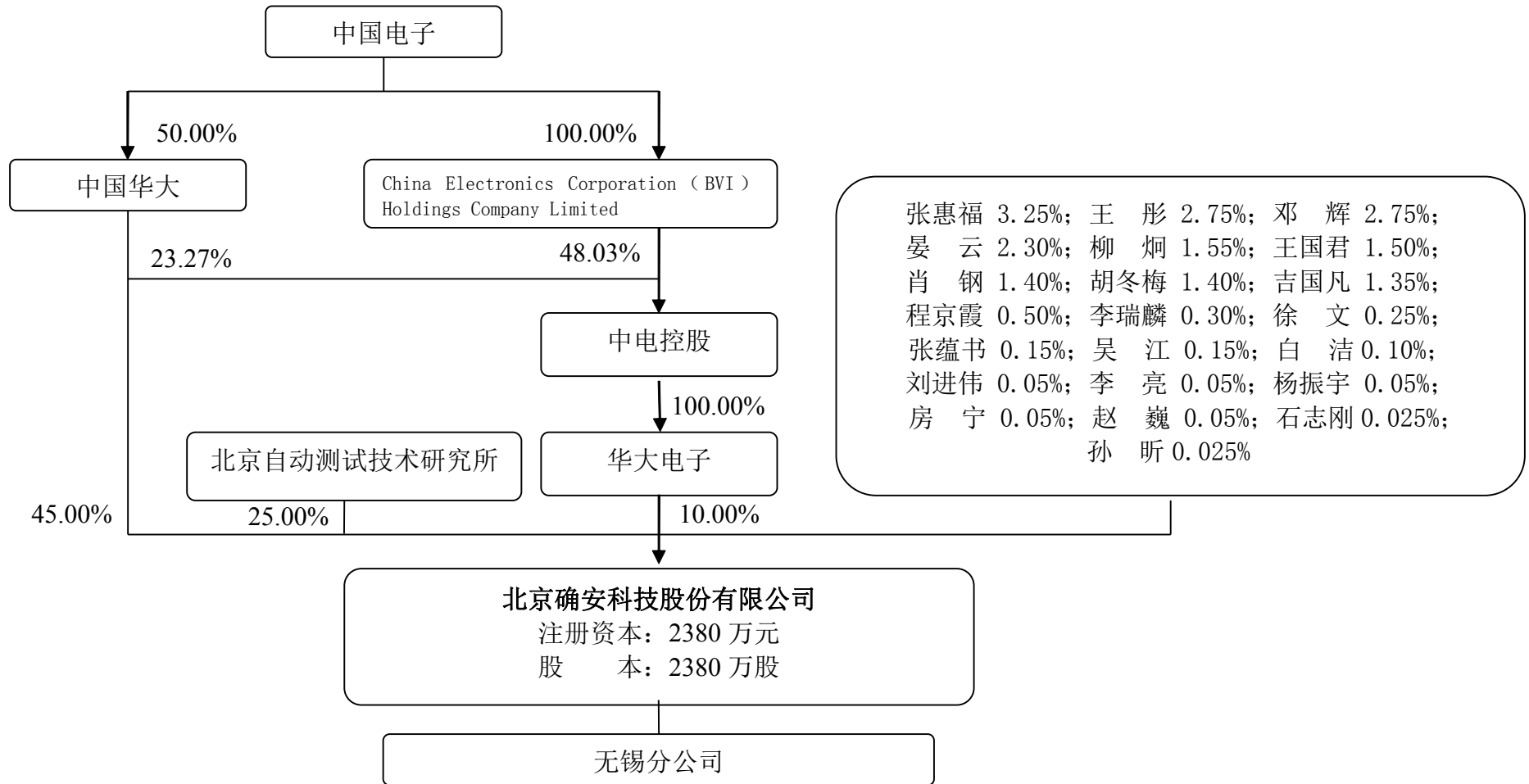
- 3、按教育程度划分，研究生以上学历 7 人，占比为 9.86%；本科学历 26 人，占比为 36.62%；大专学历 13 人，占 18.31%；大专以下 25 人，占比 35.21%。



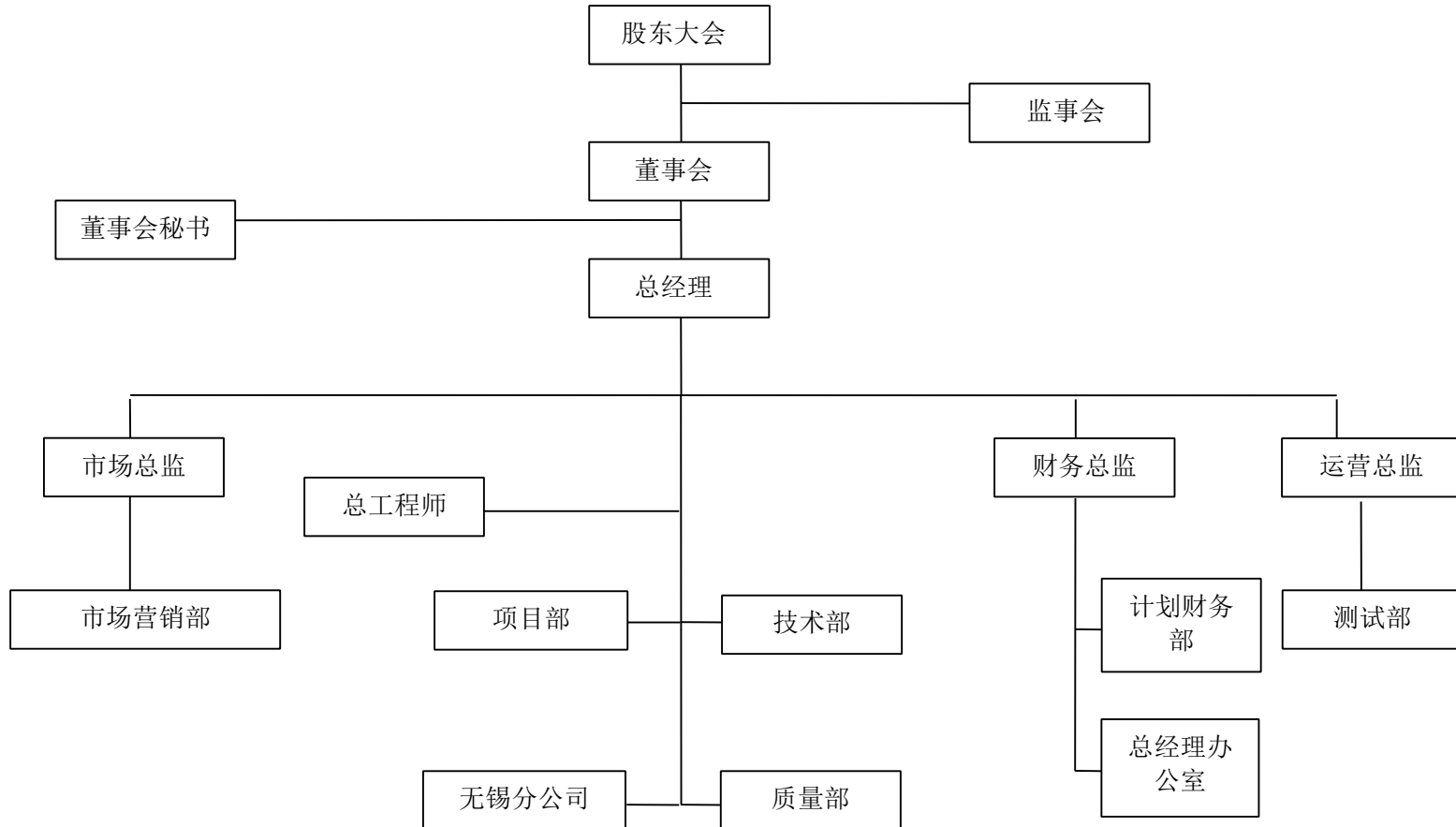
4、按年龄划分，20-30 岁 44 人，占比为 61.97%；31 岁至 39 岁 16 人，占比为 22.54%；40 岁以上 11 人，占比为 15.49%。



五、股权结构图



六、内部组织结构图



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

(一) 公司董事基本情况

1、董事长：刘晋平，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业学院无线电工程专业，本科学历。1994年7月至2002年4月，任国投电子公司副总经理；2002年5月至2002年9月，任国投高科技创业公司总经理；2002年10月至2003年10月，任国投创业投资有限公司总经理；2003年至今担任中国华大集成电路设计集团有限公司总经理。现兼任公司董事长，任期至本届董事会任期届满；同时兼任国民技术股份有限公司董事长。

2、董事：张东，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业，研究生学历，高级工程师。1997年9月至今任北京自动测试技术研究所所长；兼任北京泰思特测控技术公司总经理；1997年10月至今兼任北京集成电路检测中心主任；2000年11月至今兼任北京硅普芯片企业孵化器有限公司董事长；2001年2月至今兼任《电子测试》杂志社社长兼总编辑；现任公司董事，任期至本届董事会任期届满。

3、董事：王彤，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加利福尼亚州州立大学工商管理专业（金融方向），研究生学历。曾先后任职于国家物资部、物华置业股份有限公司、美国加州州立大学北京EMBA项目办公室、广东发展银行北京王府井支行、北京天地融科技有限公司；2006年10月加入公司，任公司副总经理职务，2010年3月至今任公司总经理，负责公司全面工作，分管技术部、项目部、质量部、无锡分公司和人力资源工作；现任公司董事、总经理，任期至本届董事会任期届满。

4、董事：姜世平，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学物理系无线电专业，本科学历。1982年2月至1990年11月，任杭州电子科技大学教师；1990年12月至2002年6月，任中国华大集成电路设计中心高级工程师；2002年6月至今任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理，现任公司董事，任期至本届董事会任期届满。

5、董事：宋鑫林，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工商管理专业，研究生学历，工程师。1994年8月至1998年4月任航天部23所工艺工程师；1998年4月至1999年3月任三伍电子系统有限公司设备工程师；1999年3月至2002年2月任大唐电信微电子股份有限公司技术主管、项目经理；2002年3月至2003年11月任清华大学微电子学研究所北京华兴微电子股份有限公司项目经理；2003年12月至今任中国华大集成电路设计集团有限公司企业管理部经理、监事，现任公司董事，任期至本届董事会任期届满。

（二）公司监事基本情况

1、监事会主席：蔡艳玲，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生学历。1997年8月至2001年6月，任辽宁中惠会计师事务所税务部、审计部税务师、审计师；2001年6月至2003年5月，任东软集团-东软网络服务有限公司计划财务部会计主管、财务经理；2003年5月至2004年7月任TOM.COM互联网事业集团财务部会计主管；2004年至今任中国华大集成电路设计集团有限公司计划财务部部门经理；现任公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

2、监事：张志杰，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于北空306支队、北京电线厂、北京电线总厂，1987年7月至1989年12月，任职北京自动测试技术研究所财务办公室会计、出纳；1989年12月至今任北京自动测试技术研究所财务办公室主任；1992年至今兼任北京泰思特测控技术公司、集成电路测试技术中心财务部经理。现任公司监事，任期至本届监事会任期届满。

3、职工代表监事：程京霞，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京市委党校民商法专业，研究生学历。曾先后任职于北京北辰实业集团有限公司北京国际会议中心、中国国际跨国公司研究会。2004年7月加入公司，现任公司人力资源部经理、办公室主任、工会分会主席，2010年11月，经职工代表大会民主选举为职工代表监事，任期至本届监事会任期届满。

（三）公司高级管理人员基本情况

1、总经理：王彤，详见本说明书本节之“（一）公司董事基本情况”相关内容；

2、财务总监、董事会秘书：晏云，男，1972年生，中国国籍，无境外永久

居留权，毕业于武汉汽车工业大学管理科学与工程专业，研究生学历，注册税务师、高级会计师、国际注册特许财务策划师。1995年7月至2003年1月任职于中国汽车工业总公司财务部；2003年2月至2006年8月任职北京科技园置业股份有限公司派驻重庆万里蓄电池股份有限公司副总会计师兼财务审计部部长、总会计师；2006年8月加入公司，现任财务总监兼董事会秘书。

（四）核心技术人员基本情况

1、肖钢，男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院研究生院微电子学专业，研究生学历，高级工程师。1987年至1993年德国夫朗和费基金会微电子学系统研究所访问学者；1993年至1995年任中国科学院半导体研究所高级工程师、课题组长；1995年至2004年任中国华大集成电路设计中心测试部经理；2004年加入公司，历任公司总经理、副总经理，现任公司总工程师，协助总经理管理技术、重大项目和无锡分公司工作。

2、侯政嘉，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学自动化工程学院检测技术与自动化装置专业，研究生学历，工程师。2005年至今担任公司测试工程师。

3、石志刚，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学电子科学与技术（微电子）专业，本科学历。北京工业大学集成电路测试方向在读工程硕士。2005年2月至2005年8月加入公司实习，历任公司测试工程师，现任公司技术部副经理。

4、吉国凡，女，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学半导体器件与物理专业，高级工程师。1982年8月至2005年任职于中电科技集团第47研究所，2006年加入公司担任公司技术部高级工程师。

5、张琳，女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电学院半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师。1990年4月至2004年5月任北京自动测试技术研究所测试部测试工程师；2004年5月加入公司，现任公司技术部项目经理。

二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议

公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同，均在公司专职工作，均在公司领取薪金，公司高级管理人员与核心技术人员没有在股东单位

兼职。

公司没有聘请独立董事，截止本股份报价转让说明书披露日，公司没有董事、监事津贴。

公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有其他协议安排（包括但不限于借款、担保等协议）。

三、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施

为稳定上述人员，公司已采取的措施包括：主要管理层成员由股东单位委派，主要管理层成员、核心技术人员持有公司股份，持股情况参见本章“四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况”。公司还提供较为合理的薪酬体系以稳定管理层及核心技术人员。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

股 东	职 务	持股数量 (万股)	比例 (%)	备注
刘晋平	董事长	0.000	0.000	中国华大委派
张 东	董事	0.000	0.000	北京自动测试技术研究所委派
王 彤	董事、总经理	65.450	2.750	——
姜世平	董事	0.000	0.000	华大电子委派
宋鑫林	董事	0.000	0.000	中国华大委派
蔡艳玲	监事会主席	0.000	0.000	中国华大委派
张志杰	监事	0.000	0.000	北京自动测试技术研究所委派
程京霞	职工代表监事	11.900	0.500	——
晏 云	财务总监、董事会秘书	54.740	2.300	——
肖 钢	总工程师、核心技术人员	33.320	1.400	——
侯政嘉	工程师、核心技术人员	0.000	0.000	——
石志刚	工程师、核心技术人员	0.595	0.025	——
吉国凡	高级工程师、核心技术人员	32.130	1.350	——
张 琳	高级工程师、核心技术人员	0.000	0.000	——
合 计	-	198.135	8.325	

第七章 公司业务和技术情况

一、业务情况

（一）公司的经营范围

公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发；货物进出口。（法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的、不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动。）

（二）公司的主营业务

确安科技是京津环渤海地区第一家专业的、中立的集成电路测试公司，主要向集成电路设计、制造及封装等集成电路企业提供第三方集成电路测试服务。公司宗旨是立足北京，面向全国，放眼世界，把公司建设成为国际一流的半导体专业测试验证企业，打造成一个有实力、有影响的世界知名企业。

1、集成电路设计验证

确安科技作为专业的集成电路测试公司按照客户提供的测试需求，帮助设计公司完善产品功能，发现、定位所设计芯片存在的问题，大大节省了客户从芯片设计到产业化的周期，在业界建立了良好的信誉。公司服务内容涵盖：测试程序开发、仿真向量转换导入、测试适配器设计加工、协助客户对产品的缺陷进行定位和分析提供测试报告、为客户产品小批量提供成品率分析报告、确保测试程序及硬件可以顺利应用到客户产品的量产测试中。服务项目覆盖领域包括：ID卡、消费类电子、信息安全芯片、电力电子器件、通讯电路芯片、大规模 SoC 芯片等。

2、集成电路晶圆测试（中测）

晶圆级产业化测试是指对晶圆厂加工出来的晶圆进行产业化测试。公司目前可以测试 6 寸晶圆、8 寸晶圆、模拟芯片晶圆、混合芯片晶圆，提供晶圆测试

数据、mapping 图分 BIN 定义功能。

确安科技自成立以来，已承接了包括二代身份证专用芯片和中石化加油卡专用芯片在内的多项测试服务，累计完成测试业务超过 60000 圆片，芯片类型涉及多个领域。覆盖的产品包括：CPU、SoC、MCU、FPGA、CPLD、SMARTCard、MixSignal、HDTV 芯片等。其中具有代表性的芯片有：中科院计算所的龙芯一号 CPU 芯片，北大众志 CPU 芯片，弦驰 CPU 芯片，九方中实的 HDTV 解码芯片，北京中电华大的 Wlan802.11G 芯片和二代身份证专用芯片，芬兰地太科特模拟开关芯片，Vimicro 的星光系列芯片，以及多个军用 SoC 芯片。

3、集成电路成品测试（IC 成品测试）

集成电路成品测试是指对封装后的成品电路进行产业化测试。近年来公司投资建设了集成电路成品测试平台，并与世界第二大封装厂美国安靠（Amkor）公司合作，通过了其成品测试质量标准认证，成为 Amkor 公司在大陆的成品测试合作伙伴，建成了完整的产业化成品测试线及标准测试流程和规范，目前可以测试的集成电路成本包括：SOP/HSOP/MSOP 系列（引脚 8-48PIN）、QFP/PLCC/QFN 系列（引脚 32-128PIN）、TSSOP/SSOP 系列（引脚 8-54PIN）提供 QFN 系列元器件编带服。

4、测试适配器设计加工

确安科技拥有测试适配器的自主设计、建模和国内加工的能力。不仅保证高速、高精度、高可靠的测试连接，而且大大降低开发成本，加快测试开发周期。公司设计的测试适配器已得到众多测试设备供应商的国内授权和采购订单。

5、提供整体测试解决方案

包括测试流程设计、测试技术研究、测试人才培养、测试系统软、硬件开发和配套、测试设备、测试应用、可靠性试验以及全部后道生产工艺的总承包等。

（三）公司经营模式

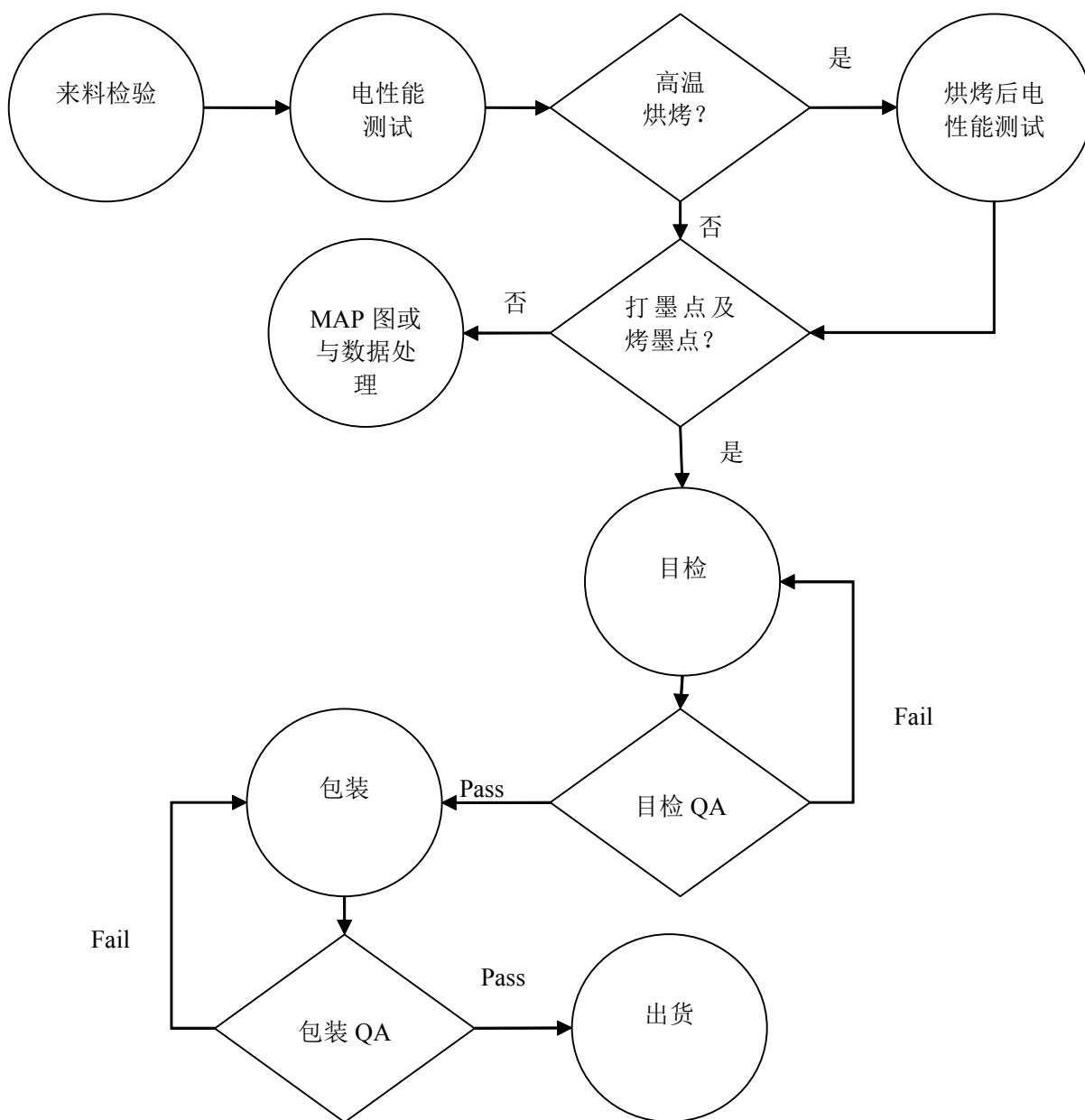
1、商业模式

公司作为京津环渤海地区第一家也是国内较大的第三方集成电路测试企业，依托自有的独到技术、现代化测试设备及高标准环境，向集成电路从业者提供优质的各类集成电路测试服务，公司提供的测试服务涵盖了设计验证、集成电路晶圆和成品测试、测试适配设计加工并能够提供整体测试解决方案。公司所从事的集成电路测试属于科技含量高、资金密集、人才密集的高科技现代服务业，

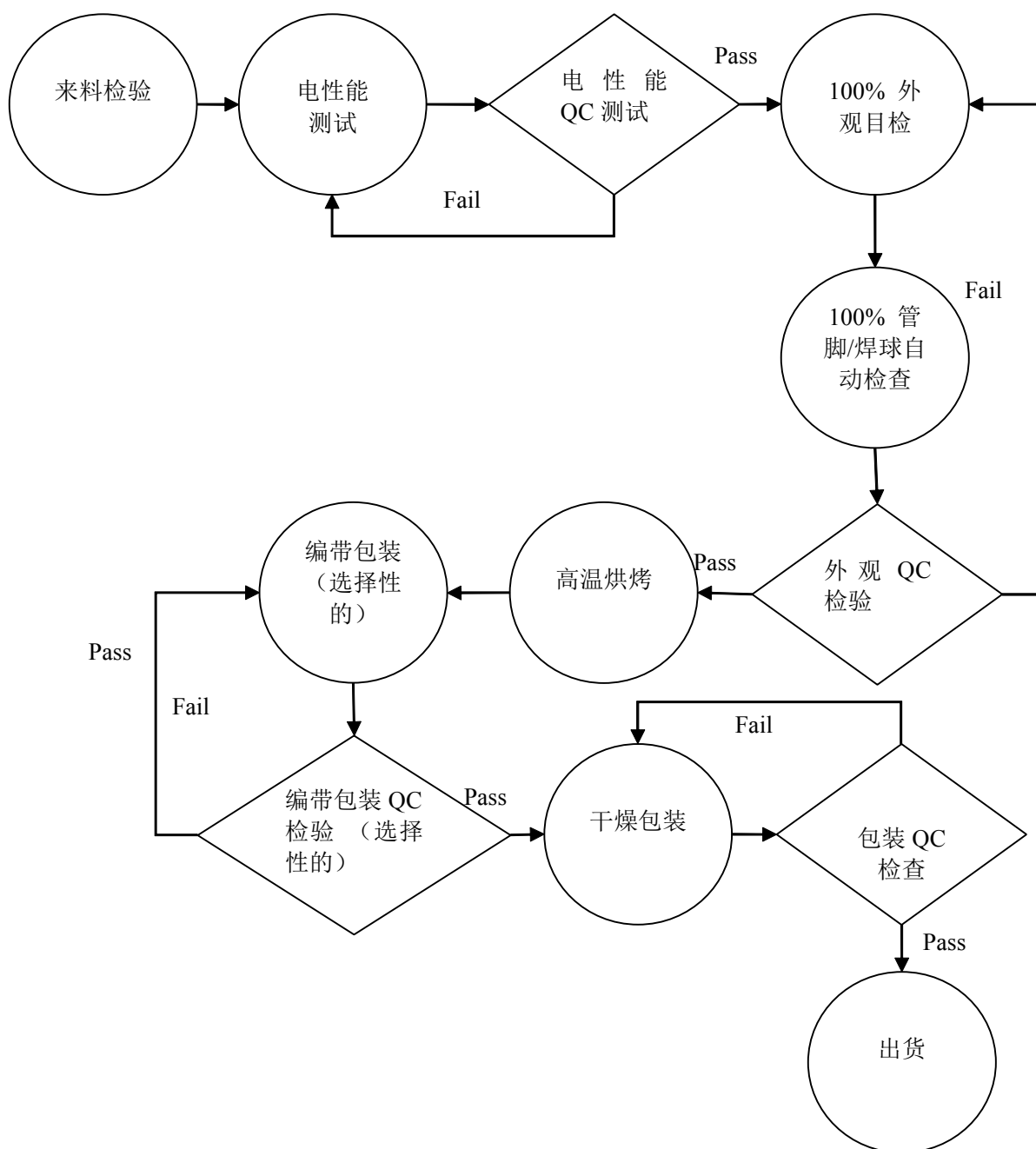
公司完全按照符合集成电路产业特点并根据现代企业制度要求设立并运行,通过不断提升自身技术水平和服务能力,增加市场份额、压缩生产成本获得收入和利润。

公司经过多年持续投入和建设,目前拥有一流的集成电路测试设备和配套设施:超过 100 台套的测试设备(其中主流中高端测试机泰瑞达 J750 系列 6 台);约 1000 平米标准净化测试车间(包括无锡分公司)。公司目前具备了每月 8000 片 8 英寸、每月 3000 片 4~6 英寸的集成电路晶圆测试能力,测试能力涵盖了中、高、低端等不同层次;公司通过了美国第二大封装厂 Amkor 公司的成品测试质量标准认证,成为其成品测试合作伙伴,产业化成品测试线达到了每月 1000 万颗集成电路成品的测试能力。

公司主营业务中集成电路晶圆标准测试流程如下图所示:



公司主营业务中集成电路成品标准测试流程如下图所示：

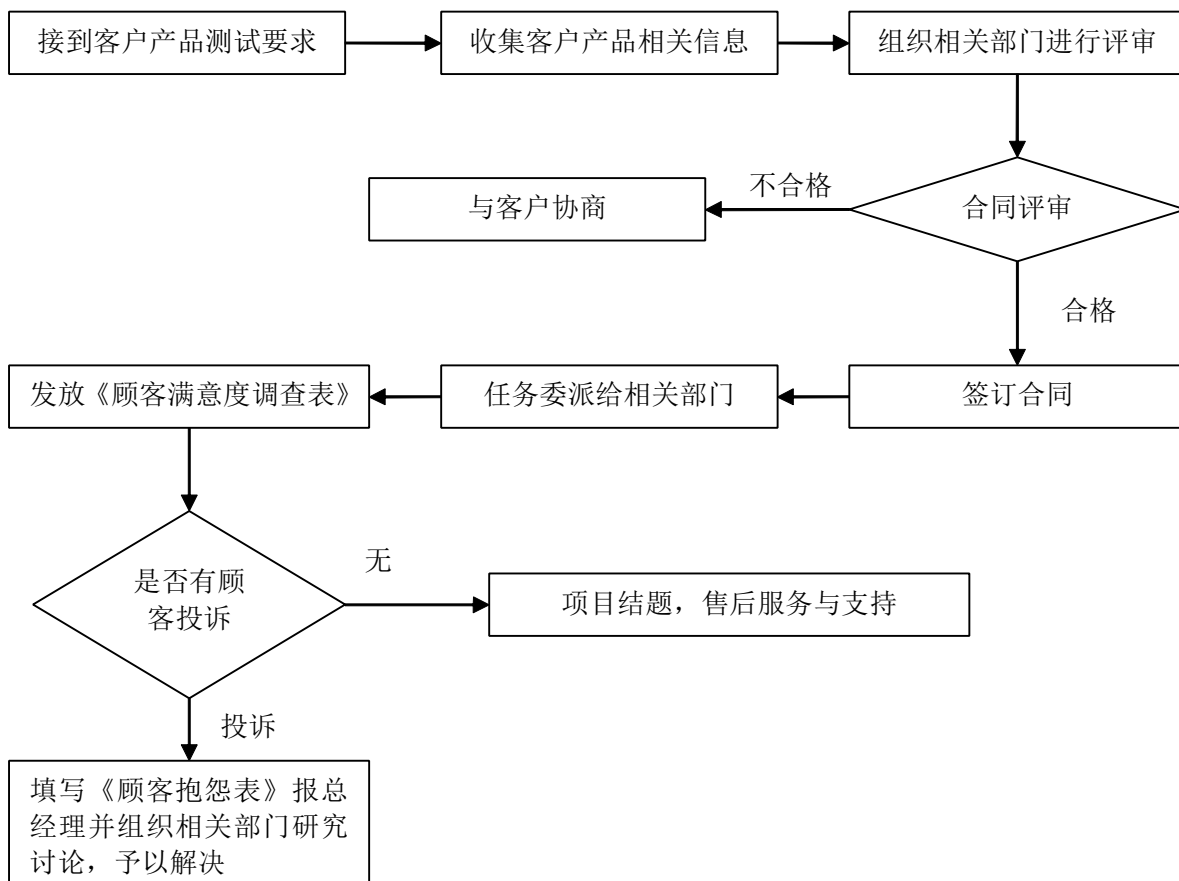


2、销售模式

公司的销售对象是集成电路全行业的各类公司，包括集成电路设计公司、晶圆厂以及封装测试厂。目前设计公司占据了公司客户中的大部分，公司地处的环渤海经济圈集中了中国大量的集成电路设计公司，根据不完全统计目前仅在北京地区能够使用公司测试环境的设计公司至少有 100 家，公司与其中约 80% 的企业进行过接触。同时公司也开始开发集成电路制造和封装企业这类客户，2008

年公司获得了世界第二大封装厂美国安靠（Amkor）公司的认证，建立了合作关系。

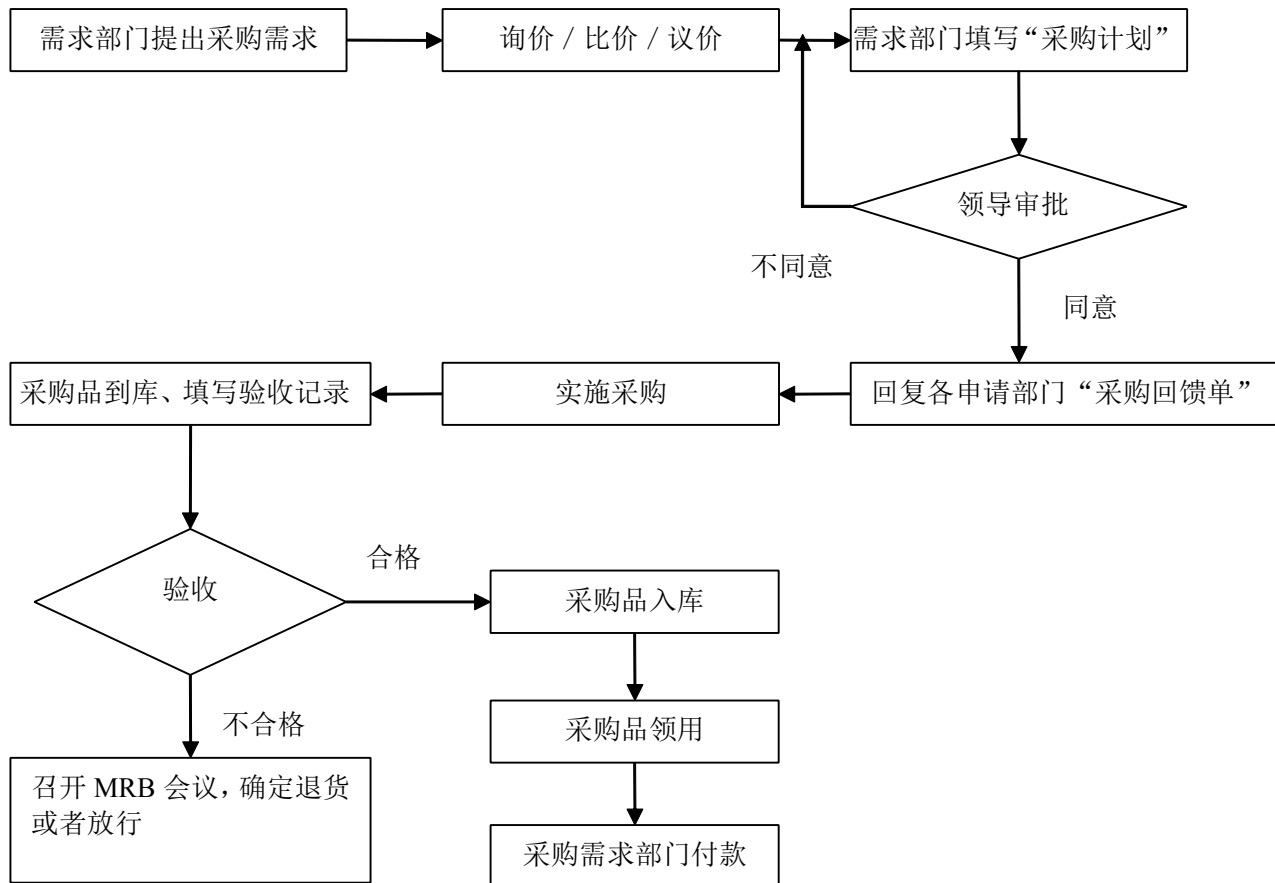
公司采用直销模式，销售部门是市场营销部，市场营销部的主要职责是根据公司的发展战略制定销售战略，收集各类市场信息，根据公司的经营目标制定具体的营销方案并实施，对外业务的洽谈与市场开拓等。市场营销部设经理（即市场总监），其他销售人员包括销售及项目经理、客户管理专员和物流专员。销售及项目经理负责新老客户的开发、组织项目实施、客户维护等；客户管理专业主要负责合同文件管理、跟踪项目实施、客户回款管理、收集和汇总客户意见等；物流专员负责与生产服务有关的发货及运输管理以及办理海关进出口手续等。公司销售流程如下图所示：



3、采购模式

公司各职能部门承担自身部门生产科研材料、产品、配件等物料采购职能，制定采购计划，提出采购申请；公司总经理办公室承担公司办公用品采购职能。一般物品采购由采购需求部门负责执行采购作业。生产和科研技术用大额固定资

产（主要为大型设备等）的采购由采购需求部门提出计划和申请，由大额固定资产采购小组负责实施。公司采购流程如下图所示：



二、主要产品的技术含量、可替代性

（一）公司主要产品的技术含量

公司自成立以来，共申请专利 2 项，完成软件著作权登记超过 80 项（详见下文“五、知识产权和非专利技术”），发表论文 7 篇，在高端芯片的测试技术研究中积累了丰富的经验，如 CPU、SoC、FPGA、网络芯片，数字电视芯片、信息安全芯片、高速 USB 接口芯片等，已经完成了 200MHz 时钟的芯片测试，测试适配器的设计，实现了 200MHz 高可靠链接，开发出了多个高端芯片的测试程序。

公司先后承担了 10 多项国家重点科技建设项目，主要包括：

- 第二代居民身份证卡芯片并行测试技术研究
- 集成电路设计验证与测试服务平台研发
- 北京集成电路测试技术公共服务平台

- 集成电路测试程序库研发服务平台
- 集成电路公共服务专业化测试
- 二代身份证芯片产业化测试软件开发
- 智能卡专用测试设备及测试服务项目
- 百万门级 SoC 测试包研发
- 军用集成电路 SoC 设计与测试研究
- 中关村 SoC 测试服务平台研发
- WLAN 基带处理器芯片测试技术研发
- LCD CONTROLER 芯片产业化测试
- 信息安全芯片测试图形实时生成技术研发及其产业化应用

其中正在执行的“北京集成电路测试技术公共服务平台”电子发展基金项目将建成服务于北京的集成电路测试平台。

公司在产品上从 CPU、DSP、FPGA 等高端芯片到低端电源管理芯片都有测试服务的开发和提供能力，覆盖面广，在芯片量产测试的工程化能力和工艺管理方面拥有丰富经验，特别在京津环渤海地区拥有较高的技术含量，具有较强的竞争力。

（二）公司主要产品的可替代性

集成电路产业内具备测试能力和技术的企业较多，例如部分大型设计企业、晶圆制造企业和封装企业，此外部分高校、科研院所也具备一定的测试能力，测试技术具备一定的通用性，因此彼此之间具备一定的可替代性。

公司作为国内较大的一家具备量产测试能力的独立测试企业，自成立以来积累了雄厚的技术力量和独立测试企业运营经验，形成了一定品牌效应，公司在提供规模化的、专业化和公正性的第三方集成电路测试服务方面具有一定的不可替代性。公司产品中的第二代身份证、加油卡等产品具有独特测试技术，很难被取代，例如：第二代身份证芯片的测试环境，测试设备，测试方法，测试数据等是通过原信息产业部和公安部组织的验收后获得生产许可的，无法转移到其它公司进行。

三、所处行业基本情况

（一）行业概况

主要从事集成电路设计验证、集成电路晶圆测试（中测）、集成电路成品测试（成测）、测试适配器设计加工以及集成电路整体测试解决方案提供等业务，属于集成电路产业四大主业（设计、制造、封装及测试）中的测试子行业，集成电路产业是国家重点鼓励发展的产业。

集成电路测试产业是集成电路产业链中不可或缺的重要组成部分，其贯穿于从集成电路设计、芯片制造、封装及集成电路应用的全过程，通过对产品进行严格的测试及筛选，以提供符合用户要求、质量合格的产品。

集成电路测试业在以往被合并于制造业或封装业中，但随着人们对集成电路品质的重视、产业化分工的不断深入，再加上技术、成本和知识产权保护等诸多因素，测试业已经由过去作为单个集成电路制造企业生产中的一个工序渐渐分离成为半导体产业链中的独立一环。

1、行业管理体制

行业行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为工业行业和信息化产业的监督管理，针对集成电路产业负责制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

行业协会是中国半导体行业协会，中国半导体行业协会由从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织，是中国集成电路行业的行业自律管理机构。协会在工信部的指导和管理下，负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。协会下设：集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会以及半导体支撑业分会。公司是半导体行业协会会员、集成电路设计分会理事单位。

工业和信息化部和中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

2、行业政策

集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家给予了高度重视和大力支持，为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了优良的政策环境，促进集成电路产业十年的快速发展。

2000年6月，国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号），该政策作为集成电路产业发展的核心政策在税收优惠、生产性原材料进口、集成电路技术和成套生产设备进口、设备折旧、知识产权保护等方面对集成电路产业进行大力扶持。

2000年9月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），制定了鼓励集成电路产业发展的若干税收政策。

2002年10月，财政部、国家税务总局发布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2002]70号），出台了针对集成电路产业更多的税收优惠政策。

2005年3月，财政部、信息产业部、国家发改委发布《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》（财建[2005]132号），由国家设立集成电路产业研究与开发专项资金，鼓励集成电路企业加强研究与开发活动。

2005年10月，国家发改委、信息产业部、税务总局、海关总署发布《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法（试行）》（发改高技[2005]2136号），规范国家鼓励的集成电路企业认定工作，进一步贯彻落实国务院有关政策及其配套优惠政策。

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，纲要提出发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键，并将“突破制约信息产业发展的核心技术，掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术，提高自主开发能力和整体技术水平”作为信息产业重要的发展思路。同时纲要将“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”（01专项）、极大规模集成电路制造技术及成套工艺（02专项）作为16个重大专项的前两位，并在科技投入、税收优惠、金融支持、知识产权保护等方面提出了政策和措施。

2006年3月，国务院制订的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，提出了集成电路、软件和新型元器件是“十一五”期间重点发展的基础性核心产业。

2006年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《2006-2020年国家信息化发展战略》，提出了提高信息产业竞争力，加强政府引导，突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈，提高在全球产业链中的地位，逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。此外，发展战略提出了“在集成电路（特别是中央处理器芯片）、系统软件、关键应用软件、自主可控关键装备等涉及自主发展能力的关键领域，瞄准国际创新前沿，加大投入，重点突破，逐步掌握产业发展的主动权”的关键信息技术自主创新计划。

2006年8月，信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，提出了“在集成电路、软件和关键元器件、电子专用设备仪器和电子材料的研发和生产方面取得阶段性突破，掌握一批关键技术，拥有一批核心专利与标准。集成电路自给率显著提高”的发展目标，并将集成电路作为未来5~15年的重点发展产业。

2007年1月，国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，明确将集成电路列入当前优先发展的高技术产业（第十三项）。

2008年1月，原信息产业部编制并颁布了《集成电路产业“十一五”专项规划》，制定了“十一五”期间集成电路产业的发展思路与目标、重点任务以及相应的政策措施。

2008年2月，财政部和国家税务总局发布了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），进一步制定了针对集成电路企业所享受的所得税优惠政策。

2009年4月，国务院通过《电子信息产业调整和振兴规划》，提出了“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”的任务目标，并在集成电路产业的产业体系完善、自主创新、产业升级等方面提出优惠措施，加大投入力度及鼓励软件和集成电路产业发展政策的实施力度。

2010年10月，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

(国发[2010]32号),提出了“着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业”,集成电路产业作为新一代信息技术产业的重要组成部分,是国家未来重点发展的战略新兴产业。

2011年1月国务院出台了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号),再次提出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础,分别从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策七个方面鼓励软件和集成电路发展,并明确提出将继续实施软件增值税优惠政策。

3、行业基本情况

集成电路业(Integrated Circuit)是指单片集成电路、混合式集成电路和组装好的电子模压组件、微型组件或类似组件的制造,包括半导体集成电路、膜集成电路、集成电路芯片、微型组件、集成电路及微型组件的零件。

集成电路作为信息产业的基础和核心,是国民经济的关键基础行业,在国民经济中占据着十分重要的战略地位。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备,是计算机、家用电器、数码电子、自动化、通信、航天等诸多产业发展的基础,是现代工业的生命线,也是改造和提升传统产业的核心技术。同时集成电路行业的推动作用强,倍增效应大,在推动经济发展上发挥着重要作用。集成电路行业在整个国民经济中的基础性、战略性地位越来越突出,各国对该行业都极为重视,发达国家和许多新兴工业化国家和地区竞相发展,使得这一行业的竞争非常激烈,激烈的竞争也使得集成电路技术得以不断更新。

集成电路技术进步遵循摩尔定律,即集成电路芯片上的晶体管数目,约每18个月增加1倍,性能也提升1倍,而价格降低一半。芯片特征尺寸的缩小使得单位面积的晶圆上能集成的电路数越多,而晶圆尺寸越大在相同加工工艺条件下,单个晶圆上集成的电路数会越多。

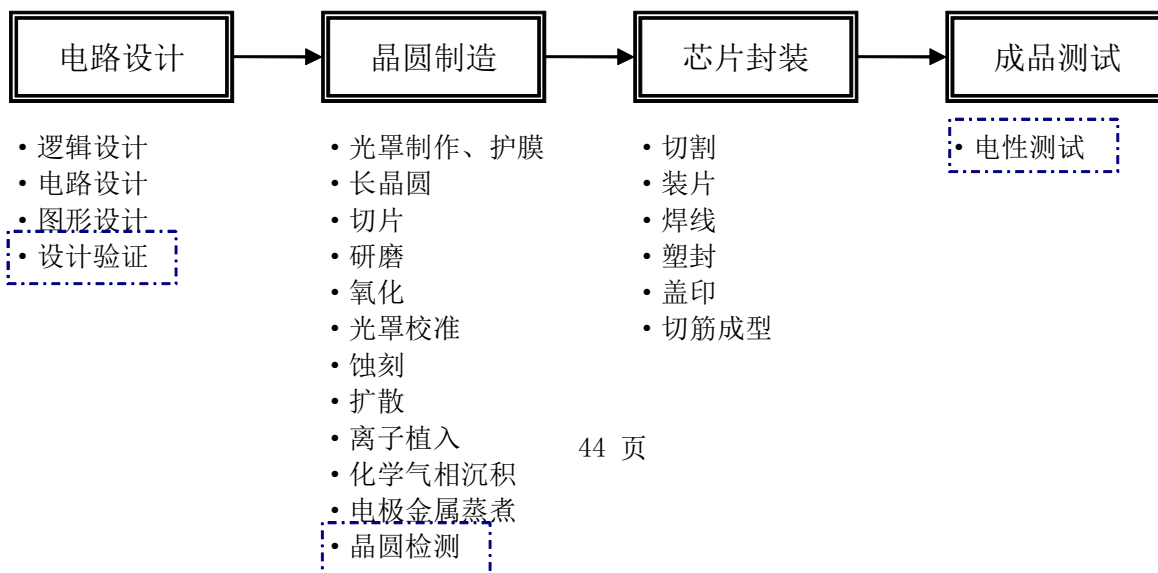
集成电路行业属于典型的资本密集型、技术密集型和人才密集型产业,并且规模经济特征明显。集成电路行业是需要不断投入巨额资金、大量人力的产业,设备费用和研发费用都非常大。随着集成电路技术的深化,以及电路结构的越来越复杂,加工工艺也将越来越复杂。新一代生产线所需的投资额成倍甚至数十倍的增加。自集成电路发明以来,芯片产量和性能成千万倍提高,而芯片平均售价

却不断下调，所以只有依靠大规模生产，实现规模经济，才能降低单位成本，实现盈利。

集成电路产业链分为电路设计、晶圆制造、芯片封装以及测试等环节（如下图所示），早期的集成电路企业以 IDM（Integrated Device Manufacturing）模式为主，IDM 模式也成为垂直集成模式，IC 制造商（IDM）自行设计，并由自己的生产线加工、封装，测试后的成品芯片自行销售的模式，如早期的 Intel、东芝等公司均采用这些模式。IDM 模式的优点在于 IDM 厂商可以根据市场特点制定综合发展战略，可以更加精细的对设计、制造、封装每个环节进行质量控制。同时，IDM 不需要外包，利润较高。发展 IDM 模式的劣势在于，投资额较大，风险较高，要有优势产品做保证。目前，国际上最大的半导体公司多为 IDM 企业，例如世界前 5 名半导体公司英特尔、三星、德州仪器、东芝和意法半导体都是典型的 IDM 企业。

随着加工技术的日益成熟和标准化程度的不断提高，集成电路产业专业分工越来越细，逐步形成了独立的 IC 设计公司（Design House）、晶圆制造企业（Foundry）、封装测试企业（Package & Testing House），并形成了新的产业模式——Foundry 模式，即垂直分工模式，在该模式下设计公司将所设计芯片最终的物理版图交给 Foundry，也就是委外代工厂加工制造，封装测试也委托专业厂家完成，最后的成品芯片作为 IC 设计公司的产品而自行销售。

由于集成电路测试贯穿于整个集成电路产业链（如下图所示），自设计开始至芯片出厂前的全过程均需要测试，同时日益复杂的芯片功能也需要测试技术和能力与之相配套，在垂直分工模式下，测试逐步从晶圆制造和封装测试环节中分离，形成了独立的测试公司（Testing House），测试作为独立的一环成为集成电



路产业链中不可或缺的重要组成部分。半导体测试业在整个产业链中处于服务的位置，它同时服务于集成电路设计企业、制造企业和封装企业，从芯片设计和生产的过程来看如果没有测试，这个产业链是不完整的甚至是断裂的，由此可见测试产业链中的重要性。

测试既是集成电路产业链中的一环，也是集成电路产品验证出厂的关键，集成电路测试具有技术含量高、知识密集的特点，而测试时间和测试效能是制约集成电路产业发展的两个重要因素。与近年来发展迅速的集成电路设计、制造和封装行业相比，我国测试业的发展却相对滞后，是集成电路产业链中最薄弱的一环。目前能够独立承担专业测试服务的公司寥寥无几，无法满足众多 IC 设计公司的验证分析和产业化测试需求，国内相当一部分高端集成电路产品，主要还是送到国外去测试，这已日益成为我国集成电路产业发展的一个瓶颈。国内的测试能力远远满足不了市场的需求。

随着集成电路产业的发展，特别是产品进入高性能 CPU、DSP 和 Soc 时代以高端产品在测试验证和生产费用越来越高，集成电路产品在测试上的花费接近产品总成本的三成，市场对独立的、专业的测试服务机构的需求会越来越迫切，为集成电路测试业带来巨大发展原动力和商机。

（二）行业竞争格局

从全球竞争角度而言，美国、欧盟以及日本作为传统的半导体行业领先地位拥有绝对的优势地位，其测试理念、测试设备以及测试技术均处于国际领先地位。我国台湾地区作为 Foundry 模式的优势地区，其独立测试企业无论在数量、企业规模上也具备一定的优势。

从国内竞争角度而言，目前测试产能主要集中在制造及封装企业中，此外部分大型设计公司、高校、科研院所也具备一定测试能力，其中尤其封装企业拥有国内大部分的集成电路测试产能。但是上述测试能力主要服务于自身的测试需求，一般不向外部企业和客户提供测试服务。

国内集成电路测试起步较晚，最早的独立测试企业成立至今也不过十余年，目前可以规模化生产的专业集成电路测试企业在十家左右。由于国内集成电路测试行业在规模、装备和技术方面与国际水平存在一定的差距，目前国内约 60%以上的高端芯片必须交由大陆以外的企业完成。

就目前而言，独立测试占整个集成电路产业规模的比例仍然较小，独立测试企业的规模也比较小，行业竞争并非十分激烈，但是随着集成电路行业尤其是国内集成电路行业的发展，国内对于集成电路测试的需求将不断扩大，同时随着国家对独立测试行业的认可和重视，集成电路测试行业将有着广阔的发展空间。

（三）行业内的主要企业及其市场份额

由于集成电路测试属于集成电路的细分子行业，国内目前尚未有上市的独立测试企业，因此无法获得权威的行业统计数据，也无法获得行业主要企业的市场份额。目前集成电路独立测试行业中具有代表性的企业有京元电子股份有限公司、上海华岭集成电路技术股份有限公司、华润赛美科微电子（深圳）有限公司、无锡泰思特测试有限责任公司，通过公开资料，相关企业的产能数据等情况如下表所示：

名称	测试能力			行业地位
	场地规模	晶圆测试能力	成品测试能力	
京元电子股份有限公司（台湾）	约 12 万平米测试车间	30 万片/月	3 亿颗/月	全球最大的独立集成电路测试企业
上海华岭集成电路技术股份有限公司	2000 平米	2 万片 / 月 (6-12 英寸)	4000 万颗/月	南方地区最大的独立集成电路测试企业
华润赛美科微电子（深圳）有限公司	数百平米	3 万片/月（4 英寸） 1 万片/月（6 英寸） 2000 片（8 英寸）	5000 万颗/月	珠三角地区最大的独立集成电路测试企业
无锡泰思特测试有限责任公司	500 平米	8000 片 / 月 (3-8 英寸)	-	大陆地区最早设立的独立集成电路测试企业
北京确安科技股份有限公司	1000 平米	8000 片/月(8 英寸) 3000 片 / 月 (4~5 英寸)	1000 万颗/月	国内较大的独立集成电路测试企业

注：以上数据均来源于各公司网站等公开资料，其中：京元电子股份有限公司为 <http://www.kyec.com.tw>、上海华岭集成电路技术股份有限公司为

<http://www.sinoictest.com.cn>、华润赛美科微电子（深圳）有限公司为 <http://www.crmsz.com>、无锡泰思特测试有限责任公司为 <http://www.wxtest.cn>，并不保证数据的准确性。

公司是国内较大的集成电路独立测试企业，在同行业公司中测试能力和技术名列前茅，但是相比整个集成电路产业中的企业而言，公司仍属于中小型企业。

（四）进入本行业的主要障碍

集成电路测试行业进入壁垒主要表现在以下几个方面：

1、技术壁垒

集成电路测试行业属于技术密集型行业，集成电路行业作为高科技行业遵循摩尔定律保持持续高速发展，作为与之配套的集成电路测试行业同样需要保持能够满足新产品、新技术的测试需求，这就需要测试企业必须保持长时间、大规模和同步的研发，如果无法跟上集成电路的发展步伐将会被市场所淘汰。

2、资本壁垒

集成电路测试行业也属于资本密集型行业，先进的测试设备大部分都需要从国外进口，单台测试设备的采购价格往往在几十万甚至上百万美金，为了保持产能和测试能力的先进性，就需要不断投入，对资本的需求非常大。

3、人才壁垒

集成电路测试行业同时也是人才密集型行业，集成电路行业属于高科技产业，技术往往掌握在人才手中，集成电路测试技术对人才的要求极高，由于测试覆盖了从设计到制造以及封装的整个过程，因此也要求集成电路测试工程师不仅需要掌握测试技术，同时需要掌握芯片设计、制造及封装知识，而我国测试工程师的培养相对比较薄弱，能够掌握专业技术的人才有限，目前还很难满足行业的整体需求。

4、行业经验壁垒

集成电路测试是一个需要丰富的测试经验积累，测试产品的类型越多，测试企业能够积累的经验也就更丰富，对于新产品的响应速度也将更快、可靠性也会更高，对客户的吸引力也往往更强，有助于测试企业获得良好口碑，获得长期的合作机会。

5、认证壁垒

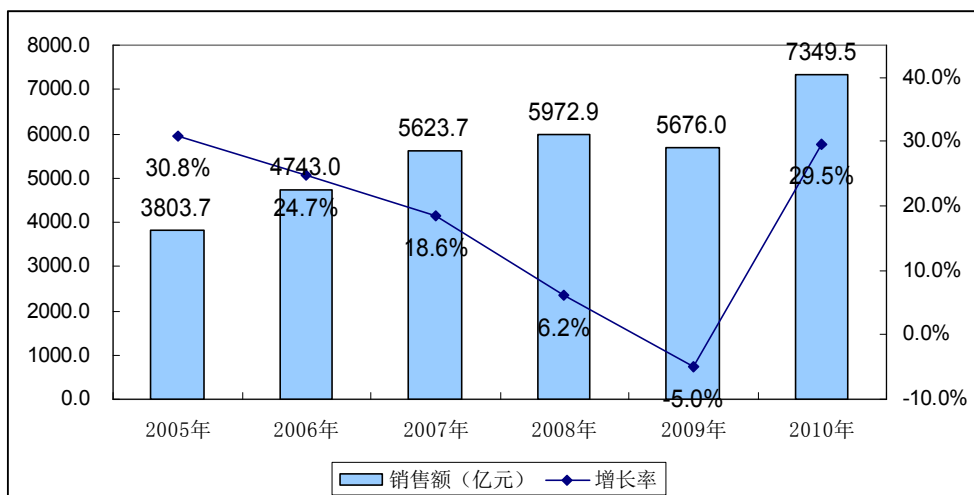
由于集成电路行业具有单个晶圆价值高、技术含量高等特点，企业在与上

下游企业合作前往往需要对其进行严格的认证，例如企业技术水平、测试能力、质量管理体系以及可靠性等，这类认证过程往往要求高、时间长，并且一旦认证后就会锁定合作关系，增加了新进企业获得订单的难度。

（五）市场供求状况及变动原因

根据中国半导体行业协会的数据显示，2005—2009年4年间全球半导体市场复合增长率为-0.1%，全球半导体产业增速明显放缓，尤其受到2008年国际金融危机的影响，2008年全球半导体市场规模较上年分别下滑2.8%，至2009年全球半导体市场规模2263亿美元，同比下滑9.0%，增长率是近年来的新低，市场发展连续多年处于低迷期。2010年，全球半导体市场强劲反弹，市场规模达到2983亿美元，同比增长720亿美元，市场增速达31.8%，是继2000年以来市场增速最快的一年，结束了连续多年来的低迷发展态势。

相对于国际市场，中国集成电路市场在2005至2008年保持持续增长，但是增速持续降低（如下图所示）2009年中国集成电路市场首次出现了负增长，2005年至2009年复合增长率为11.88%。导致市场规模下滑的主要因素有以下两个方面：一方面是下游产品对上游集成电路产品需求量下降，中国下游整机产量增速连续放缓，直接影响对集成电路产品的需求；另一方面就是集成电路产品价格的下降，近年来，集成电路产品价格一直以来都呈下降趋势，而2009年由于金融危机影响，价格下滑更加明显，2009年芯片均价与2008年相比下滑幅度超过10%。2010年，得益于全球经济的复苏，市场对下游整机电子产品的需求旺盛，从而带动对上游集成电路产品的需求；同时，由于2010年下游市场对芯片需求强劲，因此整体上使得芯片价格相对往年较为坚挺，在某些产品领域甚至出现芯片价格上涨的现象。由于上述原因，中国集成电路市场同全球市场一样结束了连续多年来增速连续下降的趋势，2010年市场增速达29.5%，实现销售额7349.5亿元，是继2006年以来市场增速最快的一年。



2005年-2010年中国集成电路市场销售情况

数据来源：中国半导体行业协会

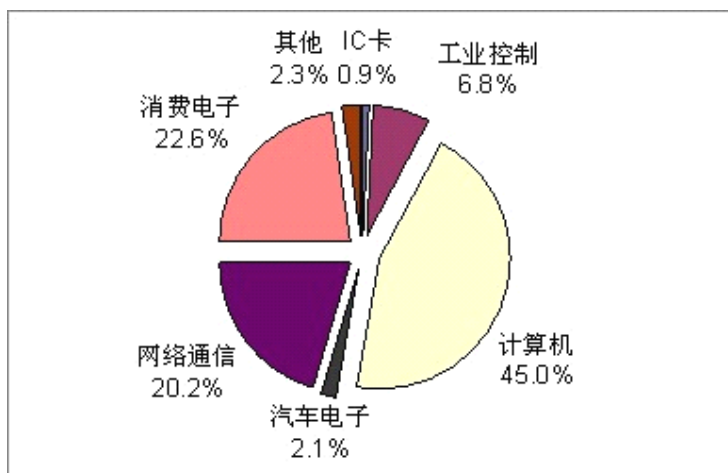
从应用结构上看，计算机类、消费类、网络通信类三大领域为中国集成电路市场的主要应用领域，上述三个领域的应用规模占整体规模的比重接近90%。

计算机类应用对半导体的需求主要来自PC、笔记本电脑、打印机、显示器、键盘及鼠标等电子信息产品在国内的OEM制造。

消费类的需求主要来自传统黑白家电、数码相机、MP3、MP4等新兴数字消费类产品。

网络通信的需求主要是手机等个人通信设备、3G网络通信产品等网络通信整机产品。

此外，中国汽车市场的快速发展以及二代身份证、交通卡、社保卡的推广使得汽车电子和IC卡类的消费份额不断提升。



2010年中国集成电路应用结构

数据来源：中国半导体行业协会

2010年，中国计算机类集成电路市场依然是中国集成电路市场最大的应用

领域，全年市场份额达到 45%，但是由于 2010 年中国笔记本电脑相对于其他主要的电子整机产品产量增速稍缓，因此计算机领域集成电路市场的份额较 2009 年的 45.8%也稍有所下滑；消费电子和网络通信领域则分别受到手机以及家电产品产量大幅增长的带动，其市场增速都保持在 30%以上，消费电子由 2009 年的 22.4% 市场份额上升至 2010 年的 22.6%，网络通讯市场份额由 2009 年的 19.9% 上升至 20.2%；2009 年中国已经成为全球汽车产销量第一的国家，汽车电子类集成电路市场近年来保持了持续增长的势头，2010 年增速达到 36.8%，市场份额略有上升，占整体规模的 2.1%；IC 卡应用方面由于中国多地社保卡的发放在保持了较快的发展速度，市场份额由 2009 年的 0.8% 上升至 2010 年 0.9%；工业控制领域应用摆脱了金融危机的影响，2010 年恢复了增长的态势，市场份额为 6.8% 与 2009 年持平。整体来看，个人电脑和手机仍然主宰集成电路市场的发展，二者所消耗的集成电路产品超过集成电路整体市场的一半，然而随着其它各类产品应用的增加，这两类下游产品所占的市场份额将缓慢缩小，但未来几年，这两类产品仍然将是集成电路消耗市场的主导产品。

在产品结构方面，受益于市场整体保持快速增长，几乎每种集成电路产品都保持了较快的增速，其中存储器（Memory）受到来自各个应用领域的带动，增速最快，增速超过 40%，市场份额达 24.1%，依然是中国集成电路市场份额最大的产品。中央处理器（CPU）和计算机外围器件则受到笔记本产量增速相对稍缓的影响，市场份额有所下滑。

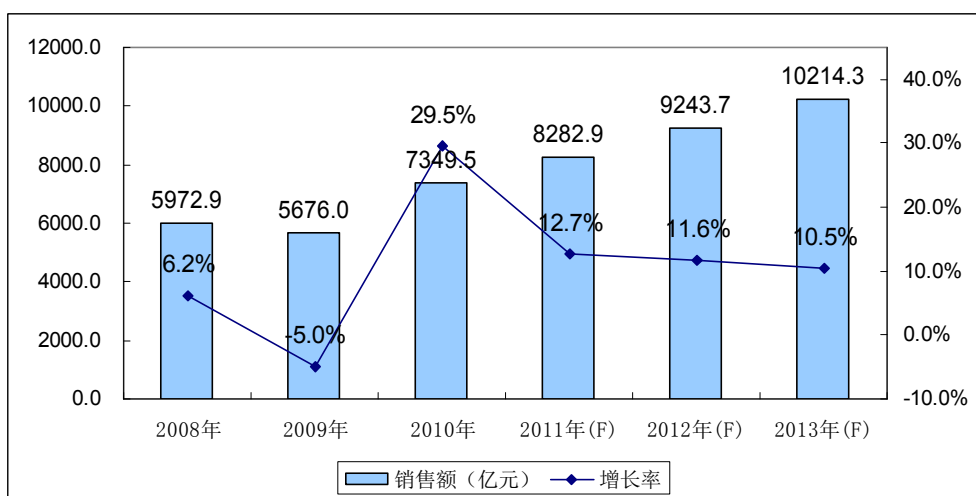
在品牌结构方面，2010 年虽然较之前稍有改变，但是中国集成电路市场基本保持了之前的态势，欧美日韩厂商依然占据了明显优势，前 10 大厂商中有 4 个美国厂商，欧洲、韩国和日本各有 2 个厂商。英特尔和三星仍然稳固地占据着中国集成电路市场前两名的位置，英特尔第一的地位暂时还没有厂商能够撼动，但是三星与英特尔的差距逐年减小。

在经历了 2009 年的衰退和 2010 年的高速增长之后，半导体芯片库存水平恢复到往年正常水平，无论是全球市场还是中国市场，市场将会进入平稳发展的阶段。

美国半导体行业协会（SIA）预测 2011 年全球半导体行业市场规模将增长 6%，而市场研究机构美国数据公司（IDC）的预测增长 8~9%。

国内市场而言，市场发展的主要驱动力仍然主要来自 PC、手机、液晶电视

已经其它产量较大的电子产品。此外，未来新兴应用成为市场增长的推动因素之一，平板电脑（xPad）等新兴电子产品市场的发展也在一定程度上推动了半导体市场的发展，随着医疗电子、安防电子以及各个行业的信息化建设的持续深入，应用于这些行业的集成电路产品所占的市场比重将会越来越多。整体来看，平稳的增长方式将是未来几年中国集成电路市场的发展趋势。根据中国半导体行业协会的预测，2011年至2013年三年中国集成电路市场的增长幅度将分别达到12.7%、11.6%和10.5%，中国集成电路市场规模在2012年将有望突破9000亿元人民币，到2013年将有望突破1万亿元人民币。



2011-2013年中国集成电路产业规模及增长预测

数据来源：中国半导体行业协会

分领域来看，未来3年，汽车电子的增速将会明显放缓，但依然将明显高于整体集成电路市场的增长。计算机领域的增速也将会有所放缓，但是3C（计算机、网络通信和消费电子）领域仍然是中国集成电路产品主要的应用领域，三者的市场份额将一直保持在整体市场的85%以上。IC卡领域随着社保卡发卡量的增加将继续保持高速增长。

虽然受到计算机领域增速放缓直接影响到存储器市场和中央处理器（CPU）市场的发展，但是存储器仍将是中国集成电路市场上份额最大的产品，其市场份额将会保持在20%以上，中央处理器（CPU）的市场份额仍将保持在15%以上。未来几年，用于IC卡领域的微处理器（MCU）产品将会受到IC卡应用带动保持较快的增长态势，而且随着MCU应用范围的拓宽，中国MCU的增速将明显快于整体

集成电路市场。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

公司所处行业为国家行业政策鼓励和重点支持发展的行业，近几年，国家已出台了一系列政策，对该行业进行支持，这些政策促成了国内电子信息产业及集成电路产业的快速发展，详细情况请参考本节前文“二、所处行业的基本情况”。根据国家发展规划，预期未来国家还将出台更多针对集成电路产业的优惠，这将有力地推动我国集成电路产业的健康稳步发展。

（2）集成电路产业持续向中国转移

近年来，笔记本电脑、数码相机、通讯产品等信息产品的生产基地都大规模向中国转移，中国已经成为世界电子信息产品最大最重要的生产基地之一。而我国人才、土地、劳动力成本等优势依然明显，越来越多的国际集成电路企业扩大在中国的生产规模。集成电路产业持续向国内转移，带动了国内集成电路产业的整体产业规模和技术水平。在国内垂直代工模式下，集成电路设计、制造和封装企业无论从规模还是数量上都保持快速增长的态势，这将大幅带动国内集成电路测试行业的快速发展。

（3）市场需求带动集成电路产业发展

集成电路是信息产业的核心，计算机、通信、消费电子等电子信息产品的市场需求驱动了集成电路产业的发展，尽管在 2009 年我国集成电路产业出现了衰退，但是可以预计的未来几年我国信息产业仍将保持高速增长态势，这将拉动集成电路产业的发展。

2、不利因素

（1）集成电路测试行业规模仍然较小

虽然独立测试行业和企业逐步被市场所接受，由于国内独立测试企业数量、规模还不能够满足行业需求，大量的测试仍在制造和封装企业中完成，而高端新品中超过 60% 还需送往海外测试。相对于国内的集成电路设计、制造和封装企业而言，测试企业规模较小，独立测试行业相对于设计、制造和封装行业规模也非常小，行业规模和企业规模的弱小在一定程度上会制约行业的发展。

（2）技术水平仍与国际先进水平存在一定差距

尽管集成电路产业已经成为我国的支柱产业之一，但是集成电路行业尤其是测试行业的技术水平与国际先进水平还存在一定的差距。目前，在集成电路行业中的高端技术和高端产品的市场份额仍然由行业国际巨头所占据，其中集成电路测试行业国内企业仍以中低端测试为主，无论从技术水平、测试规模和测试装备上发达国家企业均具有一定的优势，这些均对行业的发展造成了一定的负面影响。

（3）集成电路装备制造产业较为薄弱

支撑我国半导体产业的集成电路装备制造业规模小、技术水平落后、创新能力不足，尚不具备为集成电路制造、封装以及测试产业提供充分配套的能力。

国产集成电路测试设备主要集中在低端和半商业化应用领域。而高端的测试设备主要依赖于国际主流的测试设备厂商，例如泰瑞达、惠瑞捷（测试机）以及东京精密、东京电子、美国 EG 公司（探针台），装备过于依赖于进口在一定程度上会限制国内集成电路测试行业的发展。

（七）行业周期性、季节性、区域性特征等

1、周期性

最近 30 年，全球集成电路产业一直保持周期性的上升与下降，受“摩尔定律”等芯片发展规律的影响，集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，人们称这种周期性的变化为“硅周期”，通常一个“硅周期”为 4-5 年。集成电路的发展不仅对电子设备有强烈的影响和渗透性，而且还对其有强烈的依赖性，电子设备市场的繁荣与衰退都将直接影响到集成电路市场。此外，集成电路的发展对社会经济状况也有强烈的依赖性，全球经济状况强烈影响着集成电路产业的周期变化，例如七十年代初的石油危机，八十年代中的日元升值，九十年代末的东南亚金融危机都导致世界集成电路市场的衰退。根据中国半导体行业协会的数据显示，2008 年出现的全球范围的金融危机也影响了集成电路产业，2008、2009 年全球半导体市场增速分别为-2.8%、-9.0%，而中国集成电路市场 2008 年脱离了连续多年的两位数增长降为 6.2%，并于 2009 年出现了近十年来的首次负增长，增长率为-5.0%。目前全球集成电路行业已经摆脱国际金融危机影响，凸现了市场周期性复苏迹象，2010 年全球半导体行业实现 31.8% 的增长，而中国集成电路市场也在 2010 年实现了 29.5% 的增长，随着智能手机、笔

记本电脑、液晶电视，电子书、监控和医疗电子产品等将可能成为推动集成电路市场发展的热点产品，包括中国集成电路市场在内的全球半导体市场已经步入一轮新的成长期。

2、季节性

集成电路产业具有一定的季节性特征，由于消费类电子产品是集成电路重要的应用产品，其销售情况具有一定的季节性特征，受到圣诞节、新年以及春节电子产品消费需求拉动，通常三、四季度消费电子产品厂商要求的出货量较高，因此这期间通常为集成电路行业销售旺季，而相对于其他时间一季度为行业淡季。但近年来行业的季节性特征有所减弱，全年销售呈逐渐平滑的趋势。

3、区域性

集成电路产业具有明显的区域性特征，在我国，在高速发展过程中地区群聚效应也日益凸现，长江三角洲、京津环渤海以及珠江三角洲地区已经成为国内集成电路产业集中分布的地区。全国集成电路产业 95%以上的销售收入集中于以上三个地区。

长三角地区是国内最主要的集成电路制造基地，在国内集成电路产业中占有重要地位，全国 55%的集成电路制造企业、80%的封装测试企业以及近 50%的集成电路设计企业集中在该地区。2010 年该地区集成电路产业销售收入占全国的 67.9%。目前，长江三角洲地区已初步形成了包括研究开发、设计、芯片制造、封装测试及支撑业在内的较为完整的集成电路产业链。

京津环渤海湾地区也是国内重要的集成电路研发、设计和制造基地，该地区已初步形成了从设计、制造、封装、测试到设备、材料的较为完整的集成电路产业链，具备了相互支撑、协作发展的条件。该地区 2010 年的集成电路产业销售收入，占国内产业总销售收入的 18.8%。

珠江三角洲地区作为国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路市场，该地区依托发达的电子整机制造业，近年来其集成电路设计业发展较快。该地区 2010 年的集成电路产业销售收入，占国内产业总销售收入的 8.4%

除以上三大区域外，近几年西安、成都、武汉等中西部地区的集成电路产业发展也很快并已经开始形成规模。

四、公司面临的主要竞争情况

（一）公司在行业中的竞争地位

公司是国内较大的独立集成电路测试企业，是国家第一批鼓励的集成电路企业，也是高新技术企业。

公司所从事的独立测试服务是一个方兴未艾的新领域，从业者不多。在传统上集成电路产业划分为设计、制造、封装几个重要环节，而各个环节都有测试，因此许多测试机构作为附属部门依附于以上各个环节，独立测试是标准的第三方服务，可以为客户提供公正、专业、快捷的服务。公司客户范围遍布以上三个环节，以设计公司为主，主要针对那些没有自己测试能力，因各种原因不能在制造、封装环节内部解决需要外包测试服务的客户需求。公司在这样的行业背景下应运而生，作为提供第三方测试服务的独立测试公司，公司具备了多种产品的设计验证和量产中测、成测能力。公司服务对象主要面对集成电路设计公司（缺乏测试能力），同时为制造、封装环节的测试提供补充。公司是为数不多的针对集成电路外包测试服务市场的独立测试企业。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》确定了未来15年力争取得突破的16个重大科技专项，包括：核心电子器件、高端通用芯片及基础软件，极大规模集成电路制造技术及成套工艺，新一代宽带无线移动通信等。集成电路测试领域归属在“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”（简称“02专项”）中的“极大规模集成电路测试技术研究及产业化应用”，该项目执行期3年，总投资近8000万元。2009年，经有关部门和专家组评审，公司与上海华岭集成电路技术股份有限公司作为中国集成电路测试领域综合实力较强的两家公司同承担了该项目。

公司的测试服务水平获得了行业内的普遍认可。公司具有国内领先的测试技术，拥有专利和计算机软件著作权130余项，具备了测试数字、模拟、数模混合集成电路的能力。公司成功完成了龙芯1号CPU芯片和方舟CPU芯片等国产高端芯片的测试任务，同时还是我国二代居民身份证、社保卡和中石化加油卡等芯片的指定测试单位。公司先后开发出了二代居民身份证芯片16site、32site测试技术，累计完成4亿颗二代居民身份证芯片、1亿颗社保卡芯片、1亿颗中石化加油卡芯片的测试。公司自成立以来已经累计为国内外60多家集成电路设计

企业提供过测试服务。

公司在业务规模上在独立测试行业中排名前列；在京津环渤海地区，公司同时挂牌“中关村集成电路测试中心”，并且是承担极大规模集成电路制造装备与成套工艺专项（02 专项）——极大规模集成电路生产测试技术课题的两家企业之一，公司在行业中是领军企业之一；在产业布局上，是国家实现整个集成电路产业独立、自主、可控的重要环节。

（二）自身的竞争优势及劣势

1、自身的竞争优势：

相对本土其他测试企业，公司具有明显的优势，主要表现在以下几个方面：

（1）技术服务优势

公司具有国内领先的测试技术，拥有一支具备丰富测试经验，在国外受过培训的工程师团队。多年来，为国内外六十多家集成电路设计企业提供了优质的芯片设计验证与测试服务。目前已完成了中科院计算所“龙芯 1 号”CPU、北大众志 CPU 系列和国内自主研发的多款 SoC 芯片、DSP 芯片和 FPGA 芯片的设计验证，在高端通用芯片测试领域积累了丰富的经验。

（2）测试设备集群优势

公司具有一流的集成电路测试设备和配套设施；引进了多台套国外的高级集成电路测试设备和各种国产集成电路测试设备，已经形成了低、中、高的测试设备集群，具备了每月 8000 片 8 英寸、每月 3000 片 4~6 英寸集成电路晶圆和每月 1000 万颗产业化成品测试能力。

（3）量产服务优势

公司已累计完成第二代居民身份证、加油卡、HDTV 解码芯片、模拟开关芯片、Wlan802.11G 芯片和星光系列芯片等各类芯片将近 60000 片晶圆的测试，在规模化测试服务上积累了大量的经验。

（4）门类齐全的测试服务优势

从集成电路设计验证、测试程序开发、测试分析、晶圆中测、成品测试、可靠性实验、适配器设计加工到整体测试解决方案提供，公司具备门类齐全的集成电路测试服务能力。公司与世界第二大封装厂美国安靠（Amkor）公司合作，通过了其成品测试质量标准认证，成为 Amkor 公司在大陆的成品测试合作伙伴。目前已建成完整的产业化成品测试线，建立了标准测试流程和规范。

（5）国企背景优势

公司作为国内规模较大的国有独立集成电路测试企业，拥有良好股东背景和政府关系，对本土战略性保护性垄断性产品相对外企和民营企业有市场优势，得到了国家产业振兴的支持，能够更多的获得国家级政府项目支持。

2、自身的竞争劣势：

（1）规模劣势

公司虽然是国内最大的独立集成电路测试企业之一，但是相对于集成电路行业内设计、制造和封装企业而言，公司无论在资本规模、业务规模还是设备规模上都存在较大的劣势，这导致公司相对成本较高，在于这些企业竞争过程中存在一定的差距。

（2）区域产业结构劣势

公司所处的京津环渤海湾地区虽然是国内集成电路产业较为集中的地区，但是相对于长三角地区公司所处区域产业规模仍然较小，同时该地区设计企业多，但是制造和封装企业少，集成电路产业链还不是很完善。公司远离产业链的制造和封装端，高昂的物流成本使公司在于长三角地区和珠三角地区同行业公司的竞争中处于劣势地位。

（3）产能劣势

公司作为集团内唯一的独立测试企业，测试能力必须首先满足集团成员企业的测试需求，这部分需求占据了公司绝大部分产能，从而导致公司其他客户的测试需求很难得到满足，影响了公司市场和客户开拓工作。

（三）采取的竞争策略和应对措施

公司采取的竞争策略：

围绕“为客户提供专业、公正的集成电路测试验证解决方案及服务，帮助客户在最短时间内拿出最好产品”公司宗旨，深化客户导向，以技术和服务双轮驱动，持续加大技术研发创新投入，保持技术领先地位，提高服务质量和能力；在自主发展基础上，借助外部资源，积累题材，建设融资渠道，在短期内实现快速增长，扩大规模并占据市场。

公司采取的应对措施：

1、通过承担国家 02 重大专项“极大规模集成电路测试技术研究及产业化应用”（执行期 2009-2011），实现设备、技术的升级，具备高端芯片包括 CPU、

DSO、FPGA 的测试能力。

2、在产品及服务覆盖比较全面基础上，公司提出加强与产业链上下游联系合作，为客户提供整体测试解决方案，如 Turnkey 业务（集成电路整包服务），代理客户流片后的中测、封装、成测所有后道环节。

3、在无锡设立分公司，将公司触角延伸至产业链的最前端，利用无锡分公司在长三角地区探寻市场机会、挖掘市场潜力。

五、知识产权和非专利技术

（一）专利技术

类型	专利号	专利名称	使用情况	纠纷情况	保护截止期
实用新型	ZL 2005 2 0114517.X	集成电路并行测试适配器	正常使用	无纠纷	截至 2015 年 9 月 23 日
发明专利	ZL 2007 1 0175583.1	一种自动下载集成电路序列号码的方法	正常使用	无纠纷	截至 2030 年 6 月 2 日
发明专利	ZL 2007 1 0120008.1	面向集成电路测试的测试数据转换方法	正常使用	无纠纷	截至 2030 年 6 月 23 日

公司的专利技术均为自主研发原始取得。

自专利申请授予后，公司均按时缴纳专利维持年费，该专利处于有效状态。

公司专利证书的权利人为股份公司。

（二）软件著作权

序号	名称	取得方式	取得时间	权属	使用情况	纠纷情况	保护状况	剩余保护期
1	华大泰思特第二代居民身份证卡芯片 CIU92R04 单 Site SN 自动下载软件 V1.0	原始取得	2005. 11. 01	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2054 年 12 月 31 日

2	华大泰思特第二代居民身份证专用芯片 CIU92R04 SN 四管芯并行自动下载软件 V1.0	原始取得	2005.12.08	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2054 年 12 月 31 日
3	华大泰思特第二代居民身份证专用芯片 CIU92R04 四管芯并行测试软件 V1.0	原始取得	2005.12.16	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2054 年 12 月 31 日
4	华大泰思特第二代居民身份证专用芯片 CIU92R04 单管芯测试软件 V1.0	原始取得	2005.12.30	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2054 年 12 月 31 日
5	华大泰思特 CIU92S32F 芯片单管芯 SN 自动下载软件 V1.0	原始取得	2006.01.09	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2054 年 12 月 31 日
6	华大泰思特 CIU92S32F 芯片单管芯测试软件 V1.0	原始取得	2006.01.09	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2054 年 12 月 31 日
7	华大泰思特 CIU92S32F 芯片双管芯 SN 并行自动下载软件 V1.0	原始取得	2006.01.16	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2054 年 12 月 31 日
8	第二代居民身份证芯片专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.06.14	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日

9	高安全 SOC 芯片 Zi1221 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.01	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
10	DPS0201 测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.01	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
11	IP 电话芯片 C079 测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.01	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
12	带有 DAC 混合芯片 (MXIC-C072) 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.01	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
13	加密算法安全芯片 (SSX30B) 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.01	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
14	网络芯片 QQ80-802 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.05	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
15	华大 CIU92R04B2 测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.15	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
16	打印机专用芯片 (HED0407) 测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.29	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
17	电能表芯片 HMLW0503 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.29	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
18	非接触智能卡芯片 (0405) 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.29	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
19	高安全 SOC 芯片 ZI1222 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.29	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日

20	CT机专用控制电路 (PHOENIX) 测试软件 V1.0	原始取得	2006.09.29	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
21	双界面智能卡芯片 HED0401 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.10.13	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
22	双总线结构安全芯片 (SSX30C) 测试软件 V1.0	原始取得	2006.10.13	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
23	高速数据传输芯片 SSX30A 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.10.18	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
24	低功耗 200MSPS 的模数转换器 (PTR3101) 测试软件 V1.0	原始取得	2006.10.18	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
25	高速可编程滤波器 (KW0501) 测试软件 V1.0	原始取得	2006.10.23	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
26	多功能密码安全芯片 SSX14 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.10.23	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
27	高速可编程滤波器 KW0312 测试软件 V1.0	原始取得	2006.10.30	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
28	DSP 信号处理器 (DSP0301) 测试软件 V1.0	原始取得	2006.10.30	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
29	HDTV 高清晰度电视芯片 JUPITER 测试软件 V1.0	原始取得	2006.11.15	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日

30	基于 DSP 的雷达控制芯片 (SUPERV) 测试软件 V1.0	原始取得	2006. 11. 15	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
31	高质量安全芯片 HED0410 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006. 11. 15	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
32	接触智能卡芯片 (HED0205) 测试软件 V1.0	原始取得	2006. 11. 15	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
33	双界面智能卡芯片 (HED0208) 测试软件 V1.0	原始取得	2006. 11. 15	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
34	开玄系列安全芯片 SSXB01 测试软件 V1.0	原始取得	2006. 11. 15	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
35	无线通信基带部分芯片 WLAN-G 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006. 11. 21	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
36	高安全智能卡芯片 HED0303 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006. 12. 05	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
37	北大众志 863CPU 系统芯片专用测试软件 V1.0	原始取得	2006. 12. 05	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
38	WLAN 无线通信基带芯片 (WLAN-B) 测试软件 V1.0	原始取得	2006. 12. 05	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
39	交换机专用芯片 (QQ80-801) 测试软件 V1.0	原始取得	2006. 12. 05	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日

40	集成电路测试系统 GPIB 应用软件 V1.0	原始取得	2006.12.05	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
41	产业化测试海量数据处理软件 V1.0	原始取得	2006.12.05	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
42	Thusram 芯片测试软件 V1.0	原始取得	2006.12.18	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
43	CPLD 芯片 (HWD1472) 测试软件 V1.0	原始取得	2006.12.18	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
44	数字电视解调解码芯片 (Venus-1) 测试软件 V1.0	原始取得	2006.12.18	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
45	LongTium R2 芯片专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.12.18	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
46	CMOS 闪速存储器芯片 28F010 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.12.18	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2055 年 12 月 31 日
47	B1801 模/数转换器芯片测试软件 V1.0	原始取得	2006.12.18	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
48	建设系统三表专用芯片 JX0101 专用测试软件 V1.0	原始取得	2006.12.18	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 12 月 31 日
49	集成电路测试管理软件 V1.0	原始取得	2007.06.20	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
50	DSP 信号处理器 (DSP0401) 测试软件 V1.0	原始取得	2007.06.20	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日

51	高性能安全芯片 (HMPW0607B) 测试软件 V1.0	原始取得	2007.06.20	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
52	华大 CIU92R04B2 测试软件 V2.0	原始取得	2007.07.03	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
53	TPM 安全芯片 SSX35B2 测试软件 V1.0	原始取得	2007.07.03	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
54	HD-LIPRO-1 集成电路测试软件 V1.0	原始取得	2008.07.21	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
55	WAPI 协议算法芯片 (IWN0401) 专用测试软件 V1.0	原始取得	2007.09.30	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
56	可编程定时/计数器芯片 (82C54) 专用测试软件 V1.0	原始取得	2007.09.30	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
57	可编程外围接口芯片 (82C55A) 专用测试软件 V1.0	原始取得	2007.09.30	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
58	医疗器械 SOC 芯片 (Ctype) 测试软件 V1.0	原始取得	2007.09.30	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
59	CD74HC 系列芯片专用测试软件 V1.0	原始取得	2007.09.30	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
60	SoC 芯片 KOSSU 测试软件 V1.0	原始取得	2007.10.08	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日
61	汽车仪表控制计算 SoC 芯片专用测试软件 V1.0	原始取得	2007.10.08	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 12 月 31 日


62	Sim 卡 芯 片 (CIU5164) 专用 测试软件 V1.0	原始 取得	2007.10.08	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2057 年 12 月 31 日
63	8 位 信号 微 控 制 器 芯 片 (IC80C51) 专用 测试软件 V1.0	原始 取得	2007.10.08	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2057 年 12 月 31 日
64	安全芯片 (HS14) 测试软件 V1.0	原始 取得	2007.10.08	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2057 年 12 月 31 日
65	DS12887 实时时 钟芯片专用测试 软件 V1.0	原始 取得	2007.11.26	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2057 年 12 月 31 日
66	高性能电流模式 控制器 UC3842A 测试软件 V1.0	原始 取得	2007.11.26	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2057 年 12 月 31 日
67	12 位 A/D 转换器 AD574 测试软件 V1.0	原始 取得	2007.11.26	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2057 年 12 月 31 日
68	单 片 机 芯 片 (ATmega161) 专 用测试软件 V1.0	原始 取得	2007.11.26	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2057 年 12 月 31 日
69	无线通信基带芯 片 WLAN-STAU 测 试软件 V1.0	原始 取得	2007.11.26	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2057 年 12 月 31 日
70	触摸屏控制器 UH7843 测试软件 V1.0	原始 取得	2008.07.21	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2058 年 12 月 31 日
71	白光 LED 驱动电 路芯片 (UH7662) 专用测试软件 V1.0	原始 取得	2008.09.08	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2058 年 12 月 31 日

72	HT32A256 信息安全芯片测试软件 V1.0	原始取得	2008.10.10	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2058 年 12 月 31 日
73	FM 发射芯片 KT0801 测试软件 V1.0	原始取得	2008.10.10	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2058 年 12 月 31 日
74	SYN102 卫星导航定位通用基带芯片测试软件 V1.0	原始取得	2009.01.09	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2058 年 12 月 31 日
75	DTV101 移动数字电视芯片测试软件 V1.0	原始取得	2009.07.10	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2059 年 12 月 31 日
76	高安全智能卡芯片 CID0701 专用测试软件 V1.0	原始取得	2009.03.09	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2059 年 12 月 31 日
77	高安全智能卡芯片 HED0303 专用测试软件 V2.0	原始取得	2009.03.16	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2059 年 12 月 31 日
78	接触智能卡芯片 (HED0205) 测试软件 V2.0	原始取得	2009.03.16	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2058 年 12 月 31 日
79	高速数字信号处理器芯片 DSP0501 专用测试软件 V1.0	原始取得	2009.11.17	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2059 年 12 月 31 日
80	TCM 安全芯片 Zi1208 专用测试软件 V1.0	原始取得	2009.11.17	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2059 年 12 月 31 日
81	CID0905 测试程序 V1.0	原始取得	2010.01.05	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2059 年 12 月 31 日

82	华大泰思特 CIU92S32F 芯片 双管芯并行测试 软件 V1.0	原始 取得	2006.02.09	全部 权利	正常使 用	无纠纷	在保护 期	截止 2054 年 12 月 31 日
----	---	----------	------------	----------	----------	-----	----------	------------------------

公司软件著作权证书的权利人为股份公司。

(三) 商标

商标名称	商标注册号	核定使用的商品	使用 情况	纠纷 情况	保护 状况	有效期限
	第 4751872 号	第 42 类： 质量 检测；质量评估； 质量体系认证； 质量控制（截止）	正常 使用	无纠 纷	在保 护期	2009.3.28-2019.3.27

公司商标权权利人为股份公司。

六、核心技术情况

(一) 核心技术来源和取得方式

公司拥有自己的研发体系，每年都会投入大量的人力、物力和财力用于研发工作，以取保公司在自身领域内技术领先性和行业内的竞争力，公司所有测试程序及测试服务所需的技术均为自主开发获得。（详见下文“七、研发情况”）

(二) 自主技术占核心技术比重

公司所有技术均为自主研发取得，核心技术全部是自主技术。

(三) 核心技术的先进性

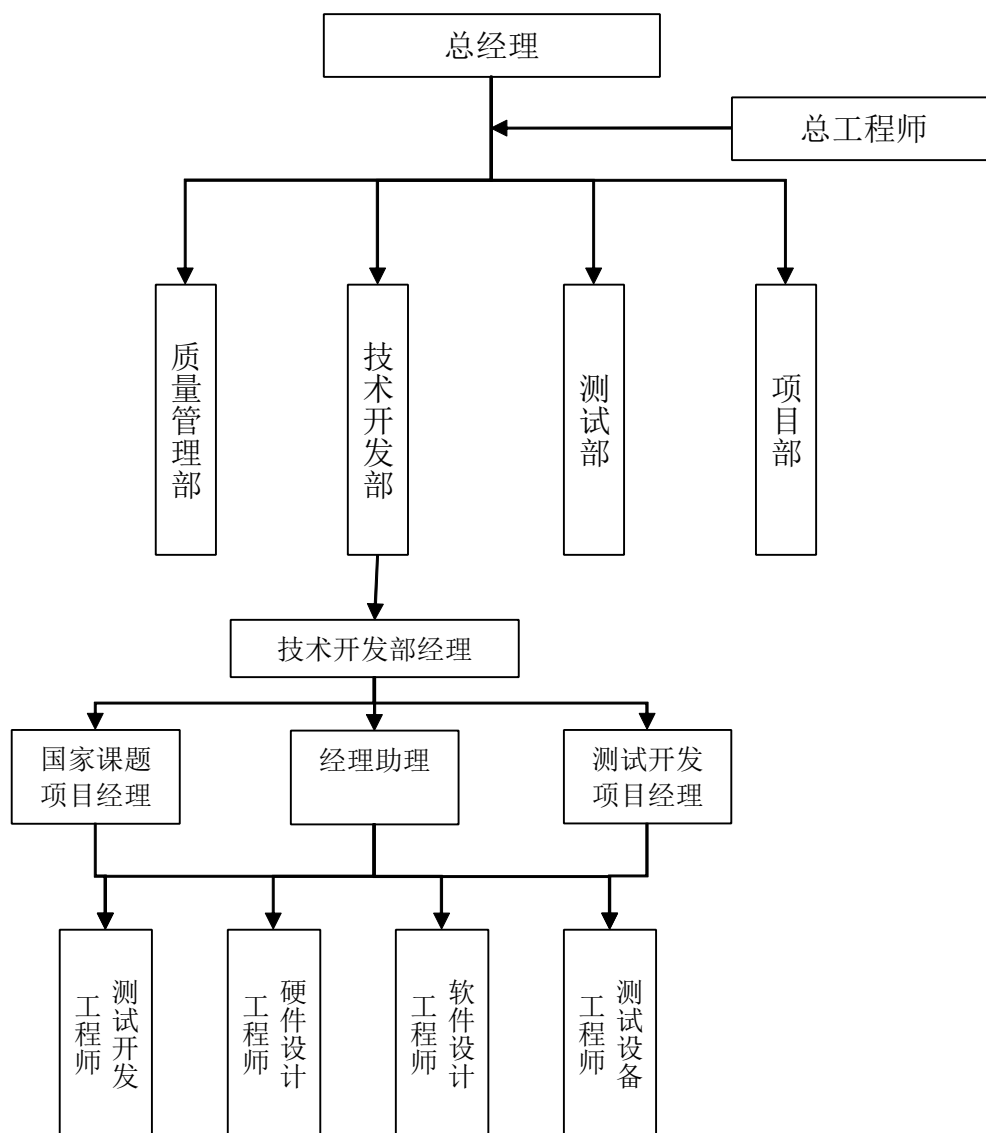
公司核心技术具有一定技术含量，在国内同类产品中具有有一定的先进性（详见上文“二、主要产品的技术含量、可替代性”）。

七、研发情况

(一) 研究开发机构设置

公司的研发体系由技术开发部、测试部、项目部和质量管理部构成，其中核心研究开发机构为公司技术开发部，公司研发体系由公司总经理领导并由总工程

师负责核心技术的开发和指导工作。公司研发体系如下图所示：



技术开发部是公司专门从事为用户提供设计验证服务、新产品设计开发、关键测试技术研究、承担国家重大项目和重大课题研究、技术培训等技术研究工作的职能部门，此外还承担了测试程序的开发、测试板开发以及部分检测设备的维护等工作。

测试部负责集成电路产品测试、新产品量化导入、设备量化应用以及设备维护等研发工作。

项目部负责国家重大专项及课题的申请工作同时负责研发项目从立项到验收全过程的组织工作，以及后续的技术文档管理和知识产权申报等工作。

质量管理部负责产品质量控制、监控生产过程的管理，确保公司交付的产品质量，并对研发工作、测试工作过程控制中相关问题提出改进意见。

公司拥有一支技术经验十分丰富的研发团队，可以独立完成测试程序开发、测试向量转换、测试适配器开发、生产自动化软件开发、数据处理软件开发等研发工作；公司具有高中低全面覆盖的测试设备机群，还有各种试验分析仪器多台，形成了技术全面研发能力强、独立性强的测试开发平台。因此，公司完全具有独立研发能力，目前所有测试程序及测试服务所需的技术均为自主开发获得。

公司投入了大量人才和研发经费，历经多年自主开发，围绕集成电路测试及其相关领域的新技术，如：SoC 芯片测试技术、设计验证核心技术、适配器设计、设计测试自动链接技术、晶圆级数据或算法下载技术、全并行测试技术、精确对接技术以及整体解决方案等等，公司累计申请专利 2 项、软件著作权 80 多项，确保了公司在业内的竞争优势，在市场上取得了较好的收益，同时也得到了各级政府的政策和资金支持。

（二）公司研发人员构成

公司拥有技术人员 46 人，专职从事研发工作的人员 19 人，所有专职从事研发工作的人员都有五年以上本专业经验，其中高级职称 3 人、中级职称 5 人、初级职称 11 人。

公司主要研发人员情况：

肖钢，简历见本说明书第六章“一、基本情况：（四）核心技术人员基本情况 1；

侯政嘉，简历见本说明书第六章“一、基本情况：（四）核心技术人员基本情况 2；

石志刚，简历见本说明书第六章“一、基本情况：（四）核心技术人员基本情况 3；

吉国凡，简历见本说明书第六章“一、基本情况：（四）核心技术人员基本情况 4；

张琳，简历见本说明书第六章“一、基本情况：（四）核心技术人员基本情况 5。

（三）研发费用投入情况

2008 年、2009 年以及 2010 年公司研发投入情况见下表：

年度	研发投入总额（元）			占主营业务收入 比重（%）
	研发总投入	自筹部分	政府补助	

2008年	金额	4,292,316.56	1,824,779.30	2,467,537.26	26.62%
	占比	100%	42.51%	57.49%	
2009年	金额	3,938,659.65	731,515.07	3,207,144.58	29.60%
	占比	100%	18.57%	81.43%	
2010年	金额	5,602,124.27	1,512,683.35	4,089,440.92	32.09%
	占比	100%	27.00%	73.00%	

集成电路产业是一个飞速发展的产业，作为集成电路设计、制造和封装的配套服务产业，测试技术必须满足其要求，为了保证公司在领域内技术领先性和行业内的竞争力，公司高度重视研发工作，每年都会投入大量的人力、物力和财力，公司历年来研发投入一般占主营业务收入的30%左右，2008年公司投入研发资金约430万元，占主营业务收入的26.62%；2009年投入约394万元，占主营业务收入29.60%；2010年投入超过560万元，占主营业务收入32.09%。

八、供应商及前五名客户情况

（一）主要供应商情况

2008年、2009年以及2010年前五名供应商统计如下：

2008年度供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	豪勉科技股份有限公司	1,279,848.61	26.18%
2	VisDynamics Research Sdn. Bhd.	815,227.17	16.67%
3	中国华大集成电路设计集团有限公司	300,000.00	6.14%
4	Alcotec PRECISION En	183,485.83	3.75%
5	上海芯玮半导体材料科技有限公司	140,005.48	2.86%
合计		2,718,567.09	55.60%

2009年度供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	美博科技（苏州）有限公司	778,759.20	33.36%
2	中国华大集成电路设计集团有限公司	300,000.00	12.85%
3	北京沙河胜开技术研发中心	132,140.00	5.66%
4	深圳市牧泰莱电路技术有限公司	104,077.35	4.46%

5	旺杰芯微电子（上海）有限公司	101,726.82	4.36%
合计		1,416,703.37	60.69%

2010年度供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	上海录德集成电路有限公司	1,110,000.00	25.33%
2	天津捷瑞超净工程技术有限公司	878,566.27	20.05%
3	德律泰电子贸易(上海)有限公司	750,000.00	17.11%
4	中国华大集成电路设计集团有限公司	300,000.00	6.85%
5	泰瑞达（上海）有限公司	238,943.47	5.45%
合计		3,277,509.74	74.79%

公司采购主要集中在材料、设备与维护等方面，其中设备与维护方面比重较高，因集成电路测试属于专用领域，供应商数量不多相对集中。虽然选择余地不是很大，一般有3-5家，但其技术水平，性能差别不大，不会形成垄断局面。从上表也可以看出2008年至今公司供应商中没有当年采购超过50%的情况发生，公司不存在对某一个或者某几个供应商过度依赖。

上述供应商中中国华大集成电路设计集团有限公司为公司控股股东，公司向控股股东租赁测试设备，租赁费用为每年30万元。除此此外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

(二) 主要客户情况

公司2008年、2009年以及2010年销售客户前五名统计如下：

2008年度销售客户前五名

序号	单位名称	年销售额(元)	占年度销售比例
1	北京中电华大电子设计有限责任公司	12,538,446.97	77.75%
2	Amkor Assembly & Test(shanghai)Co. Ltd	811,809.52	5.03%
3	北京奥贝克电子信息技术有限公司	530,769.22	3.29%
4	中星微电子有限公司	468,964.05	2.91%
5	南京微盟电子有限公司	370,136.78	2.30%
合计		14,720,126.54	91.28%

2009年度销售客户前五名

序号	单位名称	年销售额(元)	占年度销售比例
1	北京中电华大电子设计有限责任公司	10,133,465.01	76.17%
2	南京微盟电子有限公司	811,632.45	6.10%
3	北京芯技佳易微电子科技有限公司	313,666.66	2.36%
4	Amkor Assembly & Test (shanghai) Co. Ltd	248,684.98	1.87%
5	中星微电子有限公司	217,347.07	1.63%
合计		11,724,796.17	88.13%

2010年度销售客户前五名

序号	单位名称	年销售额(元)	占年度销售比例
1	北京中电华大电子设计有限责任公司	13,241,670.49	75.85%
2	南京微盟电子有限公司	1,669,410.26	9.56%
3	中国科学院计算机研究所	450,000.00	2.58%
4	北京地太科特信息技术有限公司	341,811.98	1.96%
5	威讯联合半导体(北京)有限公司	276,516.90	1.58%
合计		15,979,409.63	91.53%

公司主要销售对象是集成电路设计公司、部分封装厂和晶圆制造厂，其中以设计公司为主。公司最大的客户是北京中电华大电子设计有限责任公司，是公司关联方，2008年至今每年销售额占公司收入均超过75%。产生单一客户占比很高的主要原因有两个方面：首先，公司是华大集团内唯一的一家专业化集成电路测试企业，因此公司在设立之初就主要是优先满足集团内企业的测试需求；其次，北京中电华大电子设计有限责任公司其主要产品是第二代身份证和加油卡，最近几年是第二代身份证的换发高峰，公司作为第二代身份证芯片的指定测试服务商必须优先满足二代身份证芯片的测试需求。

公司关联方销售收入占比较高是历史原因造成的，公司产能规模相对较小，作为集团内唯一的一家专业化集成电路测试企业，产能在同等条件下优先满足集团成员企业的需求；公司（包括前身华大泰思特）自成立以来一直主要为华大电子及其他关联企业提供测试服务，主要测试的产品是国家第二代居民身份证卡芯片及加油卡、社保卡芯片。由于近几年来，以上产品需求旺盛，对测试产能的需求较大，公司测试设备一直基本处于满负荷运行，公司已经累计完成4亿颗二代

居民身份证芯片、1 亿颗社保卡芯片、1 亿颗中石化加油卡芯片的测试，由此导致公司为其他客户提供服务的产能有限，形成业务长期集中于关联方客户的局面，因此公司前三年关联交易比例较高。

公司的测试技术在国内具有一定的领先性，测试价格在行业内也有一定的市场竞争能力，即使集团企业不再需要公司提供集成电路测试服务，公司测试产也能够被市场快速消化。因此，公司并不对其产生依赖。

公司没有指定专门针对集团内部企业及公司其他关联方的优惠价格策略，关联交易定价采用市场化定价方式，主要依据测试复杂程度、占用机时长短和测试规模来确定，关联交易定价公允。股份公司设立后，公司制定了关联交易制度等配套制度，未来管理交易公司将严格按照相应的规章制度履行审批程序。

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

第八章 公司业务发展目标及其风险因素

一、未来两年发展计划

（一）未来两年总体发展目标

围绕“为客户提供专业、公正的集成电路测试验证解决方案及服务，帮助客户在最短时间内拿出最好产品”这一宗旨，公司制订了总体发展目标：深化客户导向，以技术和服务双轮驱动，持续加大技术研发创新投入，提高服务质量和能力。在自主发展基础上，借助外部资源，在短期内实现快速增长，扩大规模、占据市场。在两年内将确安科技打造成国际一流，国内领先的专业集成电路测试服务企业。收入、利润、资产规模等各项主要经营指标实现 30%以上增长。

（二）经营计划及单元战略要点

为达成以上目标，公司要保持并突出在技术、市场上的优势，继续提高管理水平和服务质量，大力加强产业内上下游及同业间合作，抓住市场机遇，结合融资平台建设实现快速发展。测试业务要从产品品种覆盖、客户分布、服务种类全方位扩大服务领域，打造品种齐全、功能齐备、质量上乘、技术一流的服务体系。

1、技术战略

- ² 利用在卡类测试多年技术、经验、人才积累基础，深入研究，持续创新，强化这一领域的绝对优势。
- ² 借助 02 专项实施，突破 32-90 纳米高端通用芯片测试技术及产业化应用，实现对 CPU、DSP、FPGA 及高端 RF 等国内主流芯片测试服务的全面覆盖。在高端设备使用上形成自主核心技术。
- ² 保障产业化测试同时，通过多 SITE 并测技术及国产设备应用提高测试效率，为客户提供低成本解决方案。
- ² 健全知识产权保护体系，完善内部管理制度，保障技术领先优势。
- ² 建立预研制度，对前瞻性课题、技术进行跟踪研究，持续投入，保持技术进步和未来优势。

2、市场营销及品牌战略

- 在卡类市场继续发掘新品种和客户，保持市场绝对优势。
- 借助 02 专项实施，开拓高端通用芯片领域新业务，在高技术要求，高附加值的业务上有较大发展。
- 加强与制造、封装领域的沟通合作，整合产业链资源，为客户提供整体解决方案，推进 TURNKEY 业务发展。
- 依托 02 专项及中关村集成电路测试中心，打造“中国芯测试中心”，为高端自主芯片设计、发展助力，提升品牌技术含量及知名度，使公司产品成为业内一面旗帜。

3、财务战略

- 继续落实成本控制管理，使各项费用水平成逐年下降趋势。
- 严格内控机制，规范操作，科学管理，防范财务风险。
- 结合资本平台建设，搭建多渠道融资路径，加强企业信用建设，为公司新增项目及快速发展做好资金准备。

4、人力资源战略

- 继续完善公司薪酬及考核制度，充分发挥激励机制，使员工更主动参与经营活动。
- 大力加强现代管理知识和专业技能培训力度，提高公司整体素质，为快速发展做好人才准备。
- 营造吸引高端人才的良好软硬件环境，引进外部人才促进公司快速发展。

5、发展战略

- 继续加强政府科研项目工作，在提高技术水平同时也能提升公司在业内重要位置，成为政府信任的合作者。
- 选择合适上下游企业建立战略伙伴、同盟关系，强化综合竞争优势。
- 借助外部资源，快速发展，如通过合作、联盟、参股、合资和并购等方式。
- 在地域上，以北方为基础，占据绝对市场优势，同时根据无锡分公司的运营情况考虑在长三角及其他地区开辟新市场的潜力。

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及应对措施

（一）政策风险

1、行业政策风险

集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家给予了高度重视和大力支持，国家出台的一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了优良的政策环境，促进集成电路产业十年的快速发展。由此可见国家对于集成电路产业政策扶持对产业发展起到了至关重要的作用，若政策一旦发生变化将对集成电路产业未来能否持续、快速发展产生一定的影响，从而影响公司主营业务的发展。

2、税收政策风险

公司目前主要享受的税收优惠包括所得税优惠和软件产品增值税优惠。

（1）所得税优惠

公司 2004 年经认定取得高新技术企业证书，并于 2008 年再次认证通过该称号。公司按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税，同时享受三免三减半的税收优惠政策，2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日处于免税期，2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日处于减税期，按 15% 的优惠税率减半缴纳企业所得税，2011 年 1 月 1 日起，公司按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

（2）增值税优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）和北京市国家税务局《转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》（京国税〔2000〕187 号）文件，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。2011 年 1 月国务院出台了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）明确了继续实施软件增值税优惠政策。

公司 2011 年起所得税率由 7.5% 调整为 15%，该调整将对公司利润产生一定的负面影响。此外，国家如果取消对高新技术企业的所得税优惠政策和软件增值税优惠政策，则将对公司利润产生进一步的负面影响。

公司认为集成电路产业作为战略新兴产业仍是国家未来重点培育和发展的对象，短期内国家对于产业的扶持态度和支持力度不会发生重大变化，出现行业政策风险的可能性不大。同时，针对政策风险，公司未来将继续加大研发力度、提升自身产能、保持和提高市场占有率，增强公司自身盈利能力，降低产业政策和税收政策风险对公司的影响。

（二）技术研发风险

集成电路产业技术和产品更新换代速度日趋加快，产品生命周期也越来越短，集成电路测试行业作为整个产业的配套服务业其水平必须与整个产业水平保持同步。因此，持续的研发和创新才能保证公司在行业中的竞争力。公司测试技术研发落后于行业技术水平、无法满足市场需求，将使公司面临风险。

针对技术研发风险，公司将充分利用国家产业政策，通过承担国家各类重大项目，尤其是 02 专项，突破 32-90 纳米高端通用芯片测试技术及产业化应用，实现对 CPU、DSP、FPGA 及高端 RF 等国内主流芯片测试服务的全面覆盖，并在高端设备使用上形成自主核心技术。同时，公司将建立预研制度，对前瞻性课题、技术进行跟踪研究，持续投入，保持技术进步和未来优势。

（三）行业波动风险

从过去 30 年来看，全球集成电路行业呈现出市场呈周期性波动的特点，行业的发展与社会经济发展存在较强的关联性，全球经济状况强烈影响着集成电路产业的周期变化，经济的衰退一般同时带来集成电路市场的衰退。公司作为集成电路产业中的一员，行业波动对公司经营会产生一定的影响。

公司认为随着持续不断的产业转移，国内集成电路产业仍然处于快速发展周期之中，同时随着经济开始复苏，未来几年市场仍然将保持增长态势。公司未来将开拓集成电路整包服务（Turnkey 业务），加强与产业链上下游联系合作，并借助国家重大专项的实施还将投入资金添置测试设备，从业务结构和产能上进一步提升公司的竞争实力，降低行业波动给公司带来的风向。

（四）人才流失风险

集成电路产业技术进步快、产品更新频率高，测试技术必须跟上产业的发

展，因此优秀的技术人才和较强的研发能力对公司持续发展至关重要，一旦出现核心技术人员大量流失，将对公司持续经营能力产生较大的负面影响。

对此，公司已经通过主要经营管理人员和核心技术人员持股，增强相关人员对公司的归属感；完善公司薪酬及考核制度，充分发挥激励机制，大力加强现代管理知识和专业技能培训力度，提高公司整体素质；营造吸引高端人才的良好软硬件环境，引进外部人才促进公司快速发展。公司认为通过上述手段，可以在一定程度上降低了人才流失风险。

（五）核心技术泄密风险

公司核心技术主要是围绕集成电路测试及其相关领域的新技术，公司核心技术在行业内具备一定的先进性，是公司核心竞争力的重要组成部分，对公司经营和发展起着重要作用。核心技术一旦泄密将会给公司带来不利影响。

公司通过申报专利、软件著作权登记等方式在法律上保护核心机密，同时制订了知识产权保护的相关规章制度，所有测试程序软件也专门保管，尽可能降低核心技术泄密的可能性。

（六）关联交易的风险

2008年、2009年和2010年公司向关联方销售金额分别为1290.86万元、1099.35万元和1496.50万元，分别占当年销售收入的80.05%、82.63%以及85.72%；公司向关联方中国华大租赁测试设备，租赁价格为每年30万元，分别占2008年、2009年和2010年采购的金额是6.14%、12.85%和6.85%。公司与关联方存在大量的关联交易，主要包括向华大电子、南京微盟、国民技术等集团成员企业提供测试服务，以及向公司大股东中国华大租赁测试设备。如果上述关联交易偏离市场化和公允性原则或者未能履行相关决策和程序，可能会给公司生产经营带来负面影响，进而损害公司以及股东的利益。此外，华大电子也是公司最大的客户，2008年至今每年销售额占公司收入均超过75%，若该客户测试业务大幅度下降，则可能会在短期内造成公司收入减少。

公司作为集团内唯一的专业化独立测试公司，在同等条件下产能优先满足集团企业的需求，公司（包括前身华大泰思特）自成立以来一直主要为华大电子及其他关联企业提供测试服务，主要测试的产品是国家第二代居民身份证卡芯片

及加油卡、社保卡芯片。由于近几年来，以上产品需求旺盛，对测试产能的需求较大，公司测试设备一直基本处于满负荷运行，公司已经累计完成 4 亿颗二代居民身份证芯片、1 亿颗社保卡芯片、1 亿颗中石化加油卡芯片的测试，由此导致公司为其他客户提供服务的产能有限，形成业务长期集中于关联方客户的局面，因此公司前三年关联交易比例较高。

公司预计关联交易在未来仍将持续发生，为此公司制定了《关联交易决策制度》，公司关联交易均签订了业务合同并进行了合同审批手续。公司没有指定专门针对集团内部企业及公司其他关联方的优惠价格策略，关联交易定价采用市场化定价方式，主要依据测试复杂程度、占用机时长短和测试规模来确定，因此，关联交易均以市场价格或者公允价格为基础，不存在损害公司以及股东利益的情况。

针对客户尤其是关联方客户较为集中可能带来的风险，公司认为：

公司测试技术水平在国内具有领先性，测试价格也具备市场竞争力，即便没有上述客户业务，公司测试产能也能够迅速被市场接纳和消化。因此，虽然客户较为集中并且单一客户占比很高，但是公司并不对其产生依赖。

公司历经 7 年的发展，组建起了一支具备雄厚测试技术力量的工程师团队和具备丰富的集成电路产业化测试管理经验的管理团队，积累了扎实的技术基础，建立起了全面的测试服务质量管理体系，具备了为客户提供全面服务的能力。

公司通过 02 专项的实施，引进了国内领先的测试系统 T2000(数字通道 1024 个，高速模块测试速率 6Gbps，RF 测试模块频率 12GHz，可实现 128 site 并行测试)和 12 吋探针台，可为国内任何高端芯片提供测试服务。目前确安科技除了为龙芯 CPU 芯片和北大众志 CPU 芯片等国产高端芯片提供测试服务外，与北京君正、中天联科和海尔等企业就多款高端芯片的测试合作也正在积极进展中。公司 2011 年以来已经购置了多台国产测试设备，可为中低端芯片提供高效低成本的测试服务，原有中高端测试设备释放出的产能有助于为北京双竞科技和首钢 NEC 提供中高端芯片测试服务。随着产能的扩大，公司已具备服务门类齐全，覆盖高、中、低端芯片的测试能力。

公司已经在无锡设立分公司，将触角延伸至产业链发达地区的最前端，利用地理位置优势在长三角地区探寻市场机会、挖掘市场潜力。

此外，从外部产业环境看，一方面北京中芯国际宣布近期每月产能从 2 万

片扩大到 4.5 万片，公司已与其就配套测试服务达成初步合作意向，这将为公司带来极好的发展机遇。另一方面，作为环渤海经济圈的龙头北京市出台《北京市调整和振兴电子信息产业实施方案》，电子信息产业将重点发展六大领域，其中第五项就是完善集成电路产业链。“稳步提升集成电路设计和制造水平，着力完善集成电路设计服务支撑体系。积极对接国家重大科技专项，在设计、装备、工艺和材料等领域实现关键技术突破。推进骨干企业工艺升级。鼓励封装和测试企业研发新技术，提升产业配套能力。形成集设计、制造、封装、测试、装备、材料于一体的完整产业链。”随着政策以及相关保障措施的出台，北京市集成电路产业链的建设与完善日趋加快，将加速推动设计、制造、封装和测试各环节协调发展，共同进步。未来公司的客户范围越来越广，产业环境愈发适合公司的发展。

公司目前内部的技术、产能、人员等因素以及外部环境都具备了快速发展条件，公司将抓住机遇，通过扩充产能、加大市场开拓力度、开发费关联客户、拓展业务品种，实现收入高速增长，从而逐步降低关联客户业务所占比例，降低经营风险和关联交易风险，提升公司持续经营能力。

（七）实际控制人没有出具避免同业竞争承诺函的风险

公司控股股东是中国华大集成电路设计集团有限公司，公司实际控制人是中国电子信息产业集团有限公司。

中国华大作为公司控股股东已经出具了《避免同业竞争承诺函》，表示中国华大目前未从事或参与、未来也不从事或参与与公司存在同业竞争的业务。

中国电子是国务院国资委直接管理的国内从事电子信息产业研发、制造、销售和服务的特大型国有独资集团公司，是经国务院批准的国家授权投资的机构。中国电子旗下拥有 39 家成员企业和 15 家控股上市公司，员工总数近 10 万人。中国电子主要产业分布在集成电路与关键元器件、软件与服务、高新电子、专用整机及核心零部件、新型平板显示、现代商贸与园区服务等国家战略性、基础性电子信息产业领域。中国电子作为国家对电子信息产业进行布局和管理的战略平台，肩负着对集成电路及其子行业投资和管理的使命。

虽然确安科技目前是中国电子旗下唯一一家专业第三方集成电路测试企业，由于集成电路测试业务贯穿于集成电路行业的各环节，为严谨起见，公司实际控制人中国电子未能出具《避免同业竞争的承诺函》。

针对实际控制人未能出具《避免同业竞争的承诺函》可能带来的风险，公司认为作为中国电子下属唯一一家独立的提供第三方测试服务的企业，公司具有较高的行业地位，目前集团也未在该行业内设立其他同类型的企业。同时，为进一步发展集成电路测试产业，中国华大也表示将继续加大力度支持公司的发展。公司是中国大陆最大的集成电路独立测试内资企业之一，也是国家在集成电路测试行业规划布局的重点企业，是京津环渤海地区唯一一个承担集成电路测试领域国家科技重大专项的企业，在同行业公司中测试技术和能力名列前茅，具有相当的发展潜力。虽然公司实际控制人未能出具《避免同业竞争的承诺函》，并不会对公司的行业地位、持续经营和发展能力产生负面影响。同时，公司将把握国家重点发展扶持集成电路及其子行业的契机，通过国家和集团的支持以及自身的努力，不断增强持续经营和发展的能力，降低可能带来的风险。

（八）公司生产场所实际租赁期限超过二十年的风险

2005年公司向北科永丰购买了位于北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号孵化楼A楼二层202号的房屋，作为公司办公、生产场地，双方于2005年11月1日签订了《房屋买卖合同》。合同签订后，公司向北科永丰一次性支付了全部购房款共计9,712,720.00元。由于北科永丰方面的原因，房屋权属转让登记手续无法办理，经友好协商，双方同意将房屋产权转让关系变为房产租赁关系，北科永丰将上述房屋分为三期租赁给公司。经公司董事会和股东会批准，公司与北科永丰于2009年12月21日签订了三份房屋租赁协议：《房屋租赁合同（2005年11月21日至2024年5月20日）》、《房屋租赁合同（2024年5月21日至2044年5月20日）》、《房屋租赁合同（2044年5月21日至2054年5月20日）》，共计48.5年。

根据《合同法》第214条“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。”的规定，由于公司生产场地实际租赁期限超过二十年，超过二十年部分的《房屋租赁合同》可能会被认定无效。若北科永丰与公司因房屋租赁合同发生纠纷向人民法院提起诉讼，公司可能会因房屋实际租赁期限超过二十年而败诉。

针对上述风险，公司在签订《房屋租赁合同》时通过合理方法充分保障自身权益。就房屋改买为租事宜，公司与北科永丰分别签订了三份独立的房屋租赁

协议：《房屋租赁合同（2005年11月21日至2024年5月20日）》（以下简称“合同一”）、《房屋租赁合同（2024年5月21日至2044年5月20日）》（以下简称“合同二”）、《房屋租赁合同（2044年5月21日至2054年5月20日）》（以下简称“合同三”）。其中，合同一成立并生效，合同亦在实际履行，合同二、合同三自双方签字盖章之日成立，待合同履行期到来之日生效。三份房屋租赁合同互相独立。双方在合同一、合同二、合同三中明确规定了本合同系附期限生效的合同。由于合同二、合同三的合同履行期尚未到来，合同二、合同三尚未生效，因此房屋实际履行的租赁期限并未突破二十年。同时，租赁合同也约定了较高的违约金以保证合同顺利履行。若北科永丰违反任何一份房屋租赁合同，北科永丰将向公司支付相当于合同总金额40%的违约金。

第九章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会制度，公司同时建立了董事会秘书制度，公司尚未建立独立董事制度和内部审计制度。

2010年11月12日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》。

2010年11月12日，公司董事会审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

2010年11月29日，公司股东大会审议通过了《对外投资及担保管理办法》。

1、股东大会制度的建立健全及运行情况

公司已建立股东大会制度，制定了《股东大会议事规则》等文件。

公司按照《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，股东大会履行职责情况良好。

2、董事会制度的建立健全及运行情况

公司已建立董事会制度，制定了《董事会议事规则》等文件。

公司董事会按照《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定召开会议，审议董事会职权范围内的事项，董事会履行职责情况良好。

3、监事会制度的建立健全及运行情况

公司已建立监事会制度，制定了《监事会议事规则》等文件。

有限公司阶段监事会履行职责情况不佳，管理层深刻认识到监事会对完善公司治理机制，防范公司风险有重大意义，管理层在未来会提高监事会工作积极性和效率，充分发挥监事会的监督作用。

4、董事会秘书制度

公司制定了《董事会秘书工作细则》，董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：筹备公司董事会和股东大会，负责公司信息披露，负责公司投资者关系管理以及董事会交办的其他事务。

公司董事会秘书按照《章程》、《董事会秘书工作细则》等相关规定开展工作，较好地履行了《章程》、《董事会秘书工作细则》规定的相关职责。

5、总经理办公会制度

公司制定了《总经理工作细则》，公司实行董事会领导下的总经理负责制。

公司能够定期召开总经理办公会，对公司生产、经营、管理、发展的重要事项进行审议。总经理办公会制度执行良好。

6、公司管理层对公司治理制度的评估意见

公司已经结合实际制定了必要的治理文件体系，公司章程、三会议事规则及公司相关内部治理制度对公司治理机制的执行做出了明确的规定，公司股东大会、董事会、监事会、总经理权责分明。

公司能够按照公司治理的要求，及时召开三会，公司三会能够正常发挥作用，但有限公司阶段，监事会履行职责情况不佳。公司聘请了董事会秘书负责公司董事会、股东大会的筹备和投资者关系的管理。公司没有建立独立董事制度，没有聘请独立董事；公司建立了总经理办公会制度，执行良好；公司尚未设立内部审计制度。

公司管理层深刻认识到规范的公司治理是公司运作的基石。公司管理层将在公司发展壮大的过程中逐步完善公司的激励与约束机制，进一步做好信息披露工作，加强投资者关系，不断提高公司治理水平，切实构建公司治理的长效机制，进一步提高公司核心竞争力，以促进公司的规范运作与持续发展。目前公司的治理机制是健全的、有效地。

(二) 关于股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

1、股东大会及相关人员履行职责情况说明

公司股东大会审议的事项均属其职权范围内的事项，股东也积极行使公司

章程及股东大会议事规则赋予的权利和履行应尽的义务，股东大会及相关人员履行职责情况良好。

2、董事会及相关人员履行职责情况说明

公司董事会审议的事项均属其职权范围内的事项，董事也积极行使公司章程及董事会议事规则赋予的权利和履行应尽的义务，董事会及相关人员履行职责情况良好。

3、监事会及相关人员履行职责情况说明

有限公司阶段，监事会审议的事项均属其职权范围内的事项，但监事会开会审议公司经营管理事务次数较少，履行职责情况不佳。

股份公司监事会审议的事项均属其职权范围内的事项，监事也积极行使公司章程及监事会议事规则赋予的权利和履行应尽的义务，董事会及相关人员履行职责情况良好。

（三）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明

公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况，公司也未为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保。

（四）公司治理的不足及改进措施

公司是成长中的中小企业，公司的治理机制的设计主要考虑决策的效率、决策的成本和权利的制衡。由于公司董事在公司出任总经理，公司的总经理办公会制度执行良好，公司董事会审议事项较少。

公司管理层深刻认识到内部审计制度与独立董事制度对完善公司内部控制，控制公司业务风险具有重要意义。公司将在发展壮大的过程中逐步完善公司治理机制。同时也深刻认识到监事会对完善公司治理机制，防范公司风险有重大积极作用，公司在未来将提高监事会工作积极性和效率，充分发挥监事会的监督作用。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）对外担保、对外投资的决策和实际执行情况

报告期内公司未发生对外担保、委托理财事宜。

股份公司成立后，公司制定了《对外投资及担保管理办法》，并将严格按照该办法的规定进行对外担保事项的决策。

（二）重大投资、对外投资的决策和实际执行情况

报告期内公司未发生的重大投资、对外投资事宜。

股份公司成立后，公司制定了《重大投资决策管理办法》，并将严格按照该办法的规定进行重大投资、对外投资事项的决策。

（三）委托理财的决策和实际执行情况

自有限公司成立至今，未发生过委托理财事宜。公司未制定委托理财的专项制度。

公司将在发展壮大的过程中逐步完善委托理财方面的制度。

（四）关联交易的决策和实际执行情况

报告期内公司发生的关联交易如下：

（1）关联方交易

①销售商品

关联方名称	2010年		2009年	
	金额	占年度同类交易比例%	金额	占年度同类交易比例%
北京中电华大电子设计有限责任公司	13,241,670.49	75.85	10,133,465.01	76.17
国民技术股份有限公司	53,901.54	0.31	48,371.95	0.36
南京微盟电子有限公司	1,669,410.26	9.56	811,632.45	6.10
合计	14,964,982.29	85.72	10,993,469.41	82.63

②2009年度营业收入中收取北京中电华大电子设计有限责任公司设备租赁费384,500.00元，2010年度收取设备租赁费475,784.00元。

③2009 年度支付给中国华大集成电路设计集团有限公司设备租赁费 300,000.00 元，2010 年租赁费 300,000.00 元。

(2) 关联方应收应付款项余额

企业名称	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额	百分比%	金额	百分比%
应收账款:				
北京中电华大电子设计有限责任公司	3,421,040.20	88.53	3,877,120.80	80.26
成都华微电子系统有限公司	25,000.00	0.65	25,000.00	0.52
南京微盟电子有限公司	218,160.00	5.65	371,150.00	7.68
合计	3,664,200.20	94.83	4,273,270.80	88.46%
其他应收款:				
中国华大集成电路设计集团有限公司	6,300.00	9.54	6,300.00	2.48
合计	6,300.00	9.54	6,300.00	2.48
应付账款:				
中国华大集成电路设计集团有限公司	--	--	150,000.00	17.99
合计	--	--	150,000.00	17.99
其他应付款:				
成都华微电子科技有限公司	606.00	0.25	--	--
合计	606.00	0.25	--	--

公司目前存在大量关联交易。主要关联方为中国华大、华大电子、南京微盟、国民技术等。一方面公司主要关联方都是集成电路领域内的领先企业，产能巨大，对集成电路测试服务有着极大的需求。另一方面，公司是国内为数不多的专门提供集成电路测试服务的企业，面临着集成电路测试服务供不应求的局面，市场需求极大。但公司同时亦是成长中的中小公司产能有限。作为集团内唯一的一家独立测试企业，公司在同等条件下优先向集团成员企业提供测试服务，但是目前公司产能仅能满足其部分需求。因此公司会产生大量的关联交易。

有限公司阶段公司没有制定关联交易的相关制度。但公司关联交易均签订了业务合同并进行了合同审批手续，关联交易定价公允。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策管理办法》，并将严格按照该办法的规定进行关联交易事项的决策。

三、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争的情况

1、公司控股股东控制的其他企业

公司控股股东为中国华大集成电路设计集团有限公司，其控制的其他企业情况如下：

- （1）南京微盟电子有限公司；
- （2）北京华大九天软件有限公司；
- （3）成都华微电子系统有限公司；
- （4）华大智宝电子系统有限责任公司；
- （5）国民技术股份有限公司；

2、公司实际控制人控制的其他企业

公司的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，其控制的其他企业情况如下：

- （1）北京中电华大电子设计有限责任公司；
- （2）中国电子进出口总公司；
- （3）中国电子器材总公司；
- （4）中国瑞达系统装备有限公司；
- （5）华北计算机系统工程研究所；
- （6）中国电子产业开发公司；
- （7）武汉中原电子集团有限公司；
- （8）深圳桑达电子集团有限公司；
- （9）中国电子工业上海公司；
- （10）中国电子物资总公司；
- （11）中国电子系统工程总公司；
- （12）北京华利计算机公司；
- （13）长城开拓投资管理有限公司；
- （14）深圳市爱华电子有限公司；

- (15) 国营长海机器厂；
- (16) 中国电子科技开发有限公司；
- (17) 烟台科信房地产开发有限公司；
- (18) 北京中电昌盛投资管理有限公司；
- (19) 中国电子集团控股有限公司；
- (20) 南京中电熊猫信息产业集团有限公司；
- (21) 北京长城高腾信息产品有限公司；
- (22) 金峰通信有限责任公司；
- (23) 长城科技股份有限公司；
- (24) 上海华虹（集团）有限公司；
- (25) 中电广通股份有限公司；
- (26) 中国软件与技术服务股份有限公司；
- (27) 中电新视界技术有限公司；
- (28) 夏新电子有限公司；
- (29) 中电华清微电子工程中心有限公司；
- (30) 中国电子财务有限责任公司；
- (31) 中国电子为华实业发展有限公司；
- (32) 信息产业电子第十一设计研究院有限公司；
- (33) 建设综合勘查研究设计院；
- (34) 上海浦东软件园股份有限公司；
- (35) 长城信息产业股份有限公司

3、公司与控股股东、实际控制人控制其他企业同业竞争情况

本公司与控股股东中国华大及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

本公司与实际控制人中国电子及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东中国华大出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与本公司存在同业竞争的行为。为避免与本公司产生新的或潜在的同业竞

争，中国华大承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成同业竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对本公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与本公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

中国电子为国务院国资委直接管理的特大型国有独资企业，对中国华大履行出资人的职责，同时也是本公司的实际控制人。本公司的具体业务规划及管理均由中国华大负责实施。中国电子是国务院国资委直接管理的国内从事电子信息产业研发、制造、销售和服务的特大型国有独资集团公司，是经国务院批准的国家授权投资的机构。中国电子旗下拥有 39 家成员企业和 15 家控股上市公司，员工总数近 10 万人。主要产业分布在集成电路与关键元器件、软件与服务、高新电子、专用整机及核心零部件、新型平板显示、现代商贸与园区服务等国家战略性、基础性电子信息产业领域。集成电路产业是电子信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，主要可分为设计、制造、封装及测试四大主业。集成电路测试产业是集成电路产业链中不可或缺的重要环节，其贯穿于从集成电路设计、芯片制造、封装及集成电路应用的全过程。中国电子作为国家对电子信息产业进行布局和管理的战略平台，肩负着对集成电路及其子行业投资和管理的使命。虽然本公司目前是中国电子旗下唯一一家专业集成电路测试公司，由于集成电路测试业务贯穿于集成电路行业的各环节，为严谨起见，本公司实际控制人未能出具《避免同业竞争的承诺函》。

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

2008 年 3 月 31 日，北京中关村海关向有限公司出具编号为：京关中缉告字[2008]0003 号《行政处罚告知单》。根据《行政处罚告知单》，公司曾委托中国电子进出口总公司从日本 VTT 株式会社购进集成电路逻辑测试系统（V777-128-4M）一套，并依法以鼓励项目名义申请办理了免税进口手续，该套设备价值美元 62,000 元。由于设备验收数据不符合公司标准，公司在办理退货时，未经海关许可将该设备交付给日本 VTT 株式会社上海代表处，并运离北京，

已构成《中华人民共和国海关法》（以下简称“《海关法》”）第八十六条第（十）项所指之未经海关许可擅自交付海关监管货物的违法行为。据此，中关村海关对公司处以罚款人民币 54,000 元的行政处罚，公司已全额缴纳了罚款。

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，除上述海关处罚外，不存在其他违法违规行为，且公司近两年来也不存在被相关主管机关其他处罚的情况。

五、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近二年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

第十章 公司财务会计信息

一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

(一) 公司报告期的审计意见

公司 2008 年至 2010 年 1-3 月的财务会计报告、2010 年的财务会计报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计，利安达会计师事务所有限责任公司分别出具了利安达审字【2010】第 1237 号、利安达审字【2011】第 1174 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 首次执行新企业会计准则的差异调节

公司于 2008 年 1 月 1 日开始执行新企业会计准则，首次执行日对年初所有者权益无调整，具体情况如下所述：

项 目	调整前	调整后
股本	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	3,921,031.89	3,921,031.89
盈余公积	1,371,014.86	1,371,014.86
未分配利润	10,778,198.22	10,778,198.22
合 计	36,070,244.97	36,070,244.97

(三) 公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

1、资产负债表

资产负债表

(单位：元)

资 产	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	27,517,735.77	8,684,265.54	7,570,658.36
交易性金融资产		111,810.00	
应收票据	160,000.00		
应收账款	3,829,064.12	4,810,601.65	4,741,506.82
预付款项	77,484.00	209,779.50	
应收利息			

应收股利			
其他应收款	66,022.56	254,192.92	859,227.47
存货	9,560,494.38	7,200,721.45	8,297,056.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	244,947.19	193,569.68	450,689.58
流动资产合计	41,455,748.02	21,464,940.74	21,919,138.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	12,544,630.11	14,294,940.95	16,490,793.30
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	52,869.83	105,205.03	158,813.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,404,106.24	9,427,177.87	9,901,882.14
递延所得税资产	45,762.56	40,022.56	103,137.02
其他非流动资产			
非流动资产合计	22,047,368.74	23,867,346.41	26,654,626.05
资产总计	63,503,116.76	45,332,287.15	48,573,764.42

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：晏云

会计机构负责人：刘进伟

资产负债表续

(单位：元)

负债和所有者权益（或股东权益）	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款	839,680.64	833,672.95	842,052.93
预收款项			
应付职工薪酬	1,150,596.78	883,481.62	1,900,295.29
应交税费	373,178.52	181,073.03	150,597.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款	242,046.41	390,620.77	275,600.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	21,278,849.95	8,025,976.89	8,929,615.84
流动负债合计	23,884,352.30	10,314,825.26	12,098,162.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	23,884,352.30	10,314,825.26	12,098,162.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23,800,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	11,860,688.15	3,921,031.89	3,921,031.89
减：库存股			
盈余公积	395,807.63	1,465,736.54	1,411,550.57
未分配利润	3,562,268.68	9,630,693.46	11,143,019.67
所有者权益（或股东权益）合计	39,618,764.46	35,017,461.89	36,475,602.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,503,116.76	45,332,287.15	48,573,764.42

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：晏云

会计机构负责人：刘进伟

2、利润表

利润表

(单位：元)

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	17,458,344.17	13,304,319.31	16,127,133.51
减：营业成本	6,475,574.32	8,434,117.80	7,855,748.61
营业税金及附加	369,009.90	293,062.59	290,057.81
销售费用	763,841.64	618,076.98	1,421,936.93
管理费用	7,850,920.24	7,124,767.07	7,671,682.83
财务费用	-2,915.12	-26,902.74	3,774.32
资产减值损失	15,276.74	5,331.44	4,931.18
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	577,531.23	234,988.21	71,716.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,564,167.68	-2,909,145.62	-1,049,282.10
加：营业外收入	2,606,167.47	3,529,583.89	1,407,341.91
减：营业外支出	1,437.55	45.00	69,513.41
其中：非流动资产处置损失			11,442.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,168,897.60	620,393.27	288,546.40
减：所得税费用	567,595.03	78,533.51	50,704.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,601,302.57	541,859.76	237,841.88
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.22	0.03	0.01
(二) 稀释每股收益	0.18	0.01	0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	4,601,302.57	541,859.76	237,841.88

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：晏云

会计机构负责人：刘进伟

3、现金流量表

现金流量表

(单位：元)

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	20,775,462.35	15,061,959.34	19,911,329.50
收到的税费返还	787,638.12	461,741.92	664,794.92
收到其他与经营活动有关的现金	7,120,567.74	3,746,721.14	2,417,074.81
经营活动现金流入小计	28,683,668.21	19,270,422.40	22,993,199.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,240,657.29	1,236,893.49	3,593,003.03
支付给职工以及为职工支付的现金	5,914,357.43	5,910,978.87	6,361,335.37
支付的各项税费	3,239,142.57	2,274,927.45	2,774,201.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,723,230.64	5,374,284.33	6,898,968.80
经营活动现金流出小计	20,117,387.93	14,797,084.14	19,627,509.01
经营活动产生的现金流量净额	8,566,280.28	4,473,338.26	3,365,690.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	111,810.00		
取得投资收益收到的现金	577,531.23	234,988.21	71,716.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	11,350,000.00		
投资活动现金流入小计	12,039,341.23	234,988.21	71,716.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,772,151.28	1,562,909.29	2,283,201.92
投资支付的现金		111,810.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,772,151.28	1,674,719.29	2,283,201.92
投资活动产生的现金流量净额	10,267,189.95	-1,439,731.08	-2,211,485.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,920,000.00	109,395.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	1,920,000.00	5,109,395.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,920,000.00	-5,109,395.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	18,833,470.23	1,113,607.18	-3,955,190.63

加：期初现金及现金等价物余额	8,684,265.54	7,570,658.36	11,525,848.99
六、期末现金及现金等价物余额	27,517,735.77	8,684,265.54	7,570,658.36

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：晏云

会计机构负责人：刘进伟

现金流量表续

(单位：元)

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	2010年	2009年	2008年
净利润	4,601,302.57	541,859.76	237,841.88
加：资产减值准备	15,276.74	5,331.44	4,931.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,533,423.80	3,515,754.06	3,249,284.97
无形资产摊销	56,753.34	55,008.56	55,420.22
长期待摊费用摊销	626,411.44	474,704.27	474,704.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--	11,442.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	--	--	14,025.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-577,531.23	-234,988.21	-71,716.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,740.00	63,114.46	-103,137.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,090,896.24	1,096,334.69	-1,347,432.48

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,090,625.88	320,828.78	1,537,561.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	316,653.98	-1,364,609.55	-697,235.97
其他	==	==	==
经营活动产生的现金流量净额	8,566,280.28	4,473,338.26	3,365,690.22
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
(3) 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的年末余额	27,517,735.77	8,684,265.54	7,570,658.36
减：现金的期初余额	8,684,265.54	7,570,658.36	11,525,848.99
加：现金等价物的年末余额	--	--	--
减：现金等价物的期初余额	==	==	==
现金及现金等价物净增加额	18,833,470.23	1,113,607.18	-3,955,190.63

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：晏云

会计机构负责人：刘进伟

4、所有者权益变动表

2010年所有者权益变动表

(单位：元)

项目	本金额					
	实收资本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	3,921,031.89		1,469,576.81	9,665,255.80	35,055,864.50
加： 1. 会计政策变更						-
2. 前期差错更正				-3,840.27	-34,562.34	-38,402.61
3. 其他						
二、本年年初余额	20,000,000.00	3,921,031.89	-	1,465,736.54	9,630,693.46	35,017,461.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,800,000.00	7,939,656.26	-	-1,069,928.91	-6,068,424.78	4,601,302.57
(一) 本年净利润					4,601,302.57	4,601,302.57
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	4,601,302.57	4,601,302.57
(三) 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者本期投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 本年利润分配	-	-	-	460,130.25	-460,130.25	-
1. 提取盈余公积				460,130.25	-460,130.25	-
2. 提取一般风险准备						

3. 对所有者（或股东）的分配						-
4. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	3,800,000.00	7,939,656.26	-	-1,530,059.16	-10,209,597.10	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	3,800,000.00	-3,800,000.00				-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他		11,739,656.26		-1,530,059.16	-10,209,597.10	-
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年年末余额	23,800,000.00	11,860,688.15	-	395,807.63	3,562,268.68	39,618,764.46

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：晏云

会计机构负责人：刘进伟

2009年所有者权益变动表

(单位：元)

项目	本金额					
	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	3,921,031.89		1,386,142.42	10,914,346.29	36,221,520.60
加： 1. 会计政策变更						-
2. 前期差错更正				25,408.15	228,673.38	254,081.53
3. 其他						

二、本年年初余额	20,000,000.00	3,921,031.89	-	1,411,550.57	11,143,019.67	36,475,602.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	54,185.97	-1,512,326.21	-1,458,140.24
(一) 本年净利润					541,859.76	541,859.76
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	541,859.76	541,859.76
(三) 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者本期投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 本年利润分配	-	-	-	54,185.97	-2,054,185.97	-2,000,000.00
1. 提取盈余公积				54,185.97	-54,185.97	-
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配					-2,000,000.00	-2,000,000.00
4. 其他						-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备						

1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年年末余额	20,000,000.00	3,921,031.89	-	1,465,736.54	9,630,693.46	35,017,461.89

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：晏云

会计机构负责人：刘进伟

2008年所有者权益变动表

(单位：元)

项目	本金额					
	实收资本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	3,921,031.89		1,371,014.86	10,778,198.22	36,070,244.97
加： 1. 会计政策变更						-
2. 前期差错更正				16,751.52	150,763.76	167,515.28
3. 其他						
二、本年年初余额	20,000,000.00	3,921,031.89	-	1,387,766.38	10,928,961.98	36,237,760.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	23,784.19	214,057.69	237,841.88
(一) 本年净利润					237,841.88	237,841.88
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	237,841.88	237,841.88
(三) 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者本期投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-

3. 其他						-
(四) 本年利润分配	-	-	-	23,784.19	-23,784.19	-
1. 提取盈余公积				23,784.19	-23,784.19	-
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配						-
4. 其他						-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年年末余额	20,000,000.00	3,921,031.89	-	1,411,550.57	11,143,019.67	36,475,602.13

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：晏云

会计机构负责人：刘进伟

二、公司报告期的主要财务指标

财务指标		2010 年度	2009 年度	2008 年度
毛利率		62.91%	36.61%	51.29%
净资产收益率	全面摊薄	11.61%	1.55%	0.65%
	加权平均	12.33%	1.52%	0.66%
净资产收益率 (扣除非经常损益)	全面摊薄	9.55%	0.33%	0.64%
	加权平均	10.14%	0.33%	0.65%
每股收益 (元/股)	基本	0.22	0.03	0.01
	稀释	0.22	0.03	0.01
每股收益 (元/股) (扣除非经常损益)	基本	0.18	0.01	0.01
	稀释	0.18	0.01	0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		0.36	0.22	0.17
应收账款周转率 (次/年)		3.96	2.77	0.81
存货周转率 (次/年)		0.77	1.09	1.03
财务指标		2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
每股净资产 (元/股)		1.66	1.75	1.82
资产负债率		37.61%	22.75%	24.91%
流动比率		1.74	2.08	1.81
速动比率		1.33	1.36	1.13

注①：主要财务指标分析详见本章之“十、管理层对公司股改时的审计报告以及 2010 年度的审计报告的财务状况、经营成果分析”内容。

注②：计算过程说明如下：

$$(1) \text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

$$(2) \text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 为营业利润或归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$(3) \text{基本每股收益} = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 稀释每股收益

公司报告期无稀释性潜在普通股。

三、公司报告期利润形成的有关情况

(一) 主营业务收入的主要构成情况

公司报告期主营业务收入的主要构成情况如下：

(单位：元)

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中测产品收入	13,406,009.52	76.79%	10,779,892.58	81.02%	13,999,717.33	86.81%
成测产品收入	1,700,818.55	9.74%	923,751.39	6.94%	1,408,670.87	8.74%
其他测试收入	1,017,321.20	5.83%	151,033.37	1.14%	189,191.11	1.17%
其他业务收入	1,334,194.90	7.64%	1,449,641.97	10.90%	529,554.20	3.28%
合计	17,458,344.17	100%	13,304,319.31	100%	16,127,133.51	100%

中测产品收入：公司开展的中测业务主要是利用测试机和探针台连接，并且借助探针卡对未经减薄划片的晶圆进行测试。公司目前形成了以国外主流中高端测试设备泰瑞达 J750 为主的测试机设备群，配有先进的 EG 探针台，能够测试频率在 100M 以内，引脚数在 256 根以下的中高端纯数字电路、模拟电路及数模混合电路，可以完成从 6 英寸到 12 英寸晶圆的常温测试和高温测试，年测试产能约为 5 千万颗芯片。报告期内，中测产品收入约占营业收入总额的约 80%。

成测产品收入：公司开展的成测业务主要是利用测试机和全自动挑选机连接，并且通过配有芯片测试连接器 (Socket) 和连接备件完成封装后芯片的测试。公司目前形成了以国外主流中高端测试设备泰瑞达 J750 为主的测试机设备群，配有先进的日本 Epson 全自动挑选机，配置了全自动管脚检测和全自动编带包装的设备，具备了完成整套成测工艺流程的设备能力。能够测试中高端纯数字电路、模拟电路及数模混合电路，可以完成从单 Site 到 4site 的常温温测试和高温测试，年测试产能在 2 千万颗芯片以上。报告期内，公司成测产品收入约占营业收

入的 8%。

其他测试收入：其他测试里主要是进行可靠性试验获取的收入，公司拥有先进的可靠性设备，能够为客户提供电子产品的寿命试验、环境试验和应力试验等可靠性试验，以帮助客户测试、评价、考核、分析和提高电子产品的可靠性水平。报告期内，公司其他测试收入约占营业收入的 1%。

其他业务收入：其他业务收入分为两部分，包括场租费收入以及机时租赁收入，该部分主要是为了提高公司场地利用率及机时使用率所产生。报告期内，公司其他业务收入约占营业收入的 3%。

（二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期主营业务收入和利润总额及变动情况如下：

（单位：元）

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度	2010 年比上年增长比率
营业收入	17,458,344.17	13,304,319.31	16,127,133.51	31.22%
营业成本	6,475,574.32	8,434,117.80	7,855,748.61	-23.22%
毛利	10,982,769.85	4,870,201.51	8,271,384.90	125.51%
营业利润	2,564,167.68	-2,909,145.62	-1,049,282.10	-
利润总额	5,168,897.60	620,393.27	288,546.40	733.16%
净利润	4,601,302.57	541,859.76	237,841.88	749.17%

2009 年公司营业收入比 2008 年下降了 17.50%，主要有以下两个原因：第一，2009 年全球金融危机爆发，半导体行业受到较强的冲击，由于公司上游企业业务量的减少，公司作为独立的半导体检测企业，在一定程度上受到了上游企业业务减少影响；第二，为保证市场占有率，公司采取适当降价的措施，因此导致营业收入的减少。2009 年公司毛利比 2008 年减少了 41.12%，主要原因如下：第一，公司作为国内指定的四家二代身份证专用芯片检测机构之一，每年的市场份额约占 30%，由于二代证业务的规模化效应以及成熟的技术，平均毛利率约在 60%左右；随着身份证换领工作的结束，2009 年二代证业务量急剧萎缩，二代证业务现在主要为常规的维护及更新，该业务总量下降后，毛利率也因无规模效应而下降，这就导致公司整体毛利率的降低；第二，2009 年受金融风暴影响，公司为

应对半导体行业所受到的冲击，采取了适当降价的措施，这也导致 2009 年度公司毛利率以及毛利均比上一年度降低。

2010 年公司进行技术革新，各种产品测试能力增强；在销售方面，公司加大营销力度，与客户合作加深，改变了单一产品结构的现象，市场份额得到较大提高，公司议价能力加强，公司测试产品价格 2010 年度基本保持不变。2010 年公司中测业务的出货量比上一年度增长 33%，且中测业务的毛利率较上一年度提高；成测业务是公司毛利率较高的业务，2010 年成测业务出货量增长 106%，公司通过与华大信安的网银 USB key 产品实现了大规模成测量产，改变了过去的小批量多品种的格局，规模效益得以体现。由于上述原因使得公司销售量增加，固定性测试费用相对节约，单位产品分摊的固定性测试费用降低，单位产品生产成本减少，所以 2010 年公司在销售量增加，营业收入增长的同时主营业务成本节约，毛利率大幅上升。

报告期内公司营业利润偏低的主要原因为管理费用占比较大。公司作为高新技术企业，为应对技术进步和保持核心竞争力，公司每年投入大量的研发费用，这些投入均费用化进入当期管理费用；上述研发费用由企业自筹和政府补贴两个部分组成，期末未形成资产时在此环节作为研发费用进入企业管理费用，公司在获得政府补贴时计入递延收益，期末也根据管理费用中研发费用的发生额相应从递延收益中转出，确认营业外收入。这也是报告期公司利润总额大于营业利润的原因。

公司 2009 年净利润与 2008 年相比增加了 127.82%，主要原因是 2009 年公司营业外收入比上一年度增长 150%，导致营业外收入增长的原因如下：公司作为半导体测试行业领先企业，2009 年政府补贴研发立项所形成的营业外收入较上一年度大幅增长。公司 2010 年净利润与 2009 年相比增加了 749.17%，主要原因是 2010 年收入较 2009 年增长了超过 30%，于此同时公司较好的控制了营业成本，在收入增加的同时 2010 年公司营业成本较 2009 年下降了 23.22%，公司 2010 年营业利润较 2009 年增加了近 550 万元，虽然 2010 年由政府补贴形成的营业外收入有所下降，公司仍然实现了净利润增长超过 450 万元。

（三）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

(单位：元)

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度	2010 年比上年增长比率
营业收入	17,458,344.17	13,304,319.31	16,127,133.51	-17.50%
销售费用	763,841.64	618,076.98	1,421,936.93	-56.53%
管理费用	7,850,920.24	7,124,767.07	7,671,682.83	-7.13%
财务费用	-2,915.12	-26,902.74	3,774.32	-812.78%
期间费用合计	8,611,846.76	7,715,941.31	9,097,394.08	-15.19%
销售费用/营业收入	4.38%	4.65%	8.82%	-47.28%
管理费用/主营收入	44.97%	53.55%	47.57%	12.57%
财务费用/营业收入	-0.02%	-0.32%	0.05%	-740%
期间费用/营业收入	49.33%	58.00%	56.41%	2.82

公司销售费用 2009 年比 2008 年有所减少的原因有三：一是，销售费用与营业收入的变动趋势较为一致，2009 年由于金融危机的影响公司整体业务受到一定的冲击，营业收入的下降相应减少了销售费用；第二，公司 2009 年将市场部和采购物流部进行合并组成新的市场部，精简了机构和人员，销售费用有所减少；第三，公司 2009 年减少了来料加工测试业务，来料加工业务需在完成后空运至客户并由本公司承担相应运费，该业务的减少相应导致销售费用有所降低。

2009 年，公司管理费用占营业收入的比例较上一年度增加了 5.98%，主要由于公司为了提高公司自身核心技术能力，即便受金融风暴影响而导致营业收入核毛利均下降的情形下，公司仍然加大研发投入；2008 年、2009 年公司研发费用支出在分别为 246.4 万元和 357.85 万元，2009 年公司研发费用支出较上一年度增长 45.23%。

2010 年公司的销售费用、管理费用发生额较上一年度略有增加，但两项费用及期间费用用占公司当年的营业收入分别为 4.38%、44.97%和 49.33%，比 2009 年相对节约，主要是由于公司营业收入增长的缘故。

公司在报告期内仅由于在 2007 年 1 月 16 日为补充流动资金需要向北京银行上地支行借入为期一年，本金为 500 万的短期借款，年息 6.732%，公司已经于 2008 年 1 月 16 日归还了该笔借款，相应产生少量的利息支出。除此以外财务费用中主要为活期存款产生的利息收入、少量的外币汇兑损益以及

手续费，财务费用的绝对金额不高，对营业收入的比例也很低。

（四）非经常性损益情况

公司非经常性损益的构成如下：

（单位：元）

序号	项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
1	非流动资产处置损益	-	-	11,442.49
2	计入当期损益的政府补助	-1,812,683.35	-2,851,981.47	-639,186.92
3	持有交易性金融资产取得的投资收益	-577,531.23	-234,988.21	-71,716.07
4	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,408.45	-220,315.00	56,590.92
5	其他符合非经营性损益定义的损益项目	1,512,683.35	2,846,981.47	639,186.92
	小计	-881,939.68	-460,303.21	-3,682.66
	减：所得税影响数	-66,145.48	-34,522.74	-276.20
	合计	-815,794.20	-425,780.47	-3,406.46

公司的主要非经常性损益项目为交易性金融资产产生的投资收益、固定资产报废和出售损失以及政府非经常性补助收入。

1、非流动资产处置损益：2008年，公司对一批使用年限已满、已全额计提折旧，并且预期很难再给公司带来预期收益的部分固定资产进行了一次性报废，该批固定资产主要为计算机。

2、计入当期损益的政府补助：2008年后政府补贴立项的研发项目，报告期末与形成收入有关的递延收益的转入金额。

3、持有交易性金融资产取得的投资收益：报告期内，公司利用闲置资金，按照企业内部管理制度以及内部控制的要求，谨慎地参与一级市场新股认购获得的投资收益。

4、其他营业外收入和支出有：

①2008年为公司的罚款支出。事由如下：2008年公司从日本VTT株式会社购进集成电路逻辑测试系统一套，公司验收设备后发现不符合要求，遂将该免税设备运离北京交付给VTT株式会社上海代表处，公司因不熟悉海关管理有关条例，导致该免税设备脱离海关监管，被处以54,000.00元的罚款。公司已接受处罚，并对该过失引以为戒。

②2009 年为公司获得的一项债务减免；减免事由为：2006 年公司与北京晶川电子技术发展有限公司签署了一份设备租赁协议，由于使用中设备故障，影响检测质量，2009 年双方经协商并达成租金免除协议，免除公司已提未付的设备租金 22 万元。

5、其他符合非经营性损益定义的损益项目：2008 年后政府补贴立项的研发项目，报告期末形成资产计入管理费用的研发费。

（五）税项及享受的主要财政税收优惠政策

本公司税项及享受的主要财政税收优惠政策列示如下：

1、增值税

本公司为增值税一般纳税人，按照销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为应税营业收入的 17%。

根据北京市国家税务局京国税[2000]187 号文件，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2011 年 1 月，国务院出台了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）提出继续实施软件增值税优惠政策，公司将继续享受该增值税优惠政策。

2、营业税

本公司营业税税率为应税营业收入的 5%。

3、城市维护建设税

本公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7%计缴。

4、教育费附加

本公司教育费附加按实际缴纳流转税额的 3%缴纳。

5、企业所得税

公司 2008 年经认定再次取得高新技术企业证书，减按 15%的优惠税率缴纳企业所得税，同时享受三免三减半的税收优惠政策，2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日处于免税期，2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日处于减税期，按 7.5%的优惠税率缴纳企业所得税。2011 年 1 月 1 日起公司按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

四、公司报告期主要资产情况

（一）货币资金

公司报告期的货币资金情况如下：

（单位：元）

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
库存现金	13,807.27	6,343.48	15,855.10
银行存款	27,486,806.14	3,103,634.32	7,534,262.23
其他货币资金	17,122.36	5,574,287.74	20,541.03
合 计	27,517,735.77	8,684,265.54	7,570,658.36

公司报告期的其他货币资金情况如下：

单位：元

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2010年12月31日
证券资金账户余额	-	5,551,690.58	-
商务信用卡余额	20,541.03	22,597.16	17,122.36
合 计	20,541.03	5,574,287.74	17,122.36

注：2009年末证券资金账户余额为公司新股申购资金返回后未及时转回公司银行存款基本户的金额。

（二）交易性金融资产

（单位：元）

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
交易性权益工具投资	--	111,810.00	--

关于公司交易性金融资产，公司规定只能利用闲置资金申购新股，申购股票上市后立即择机出售，为一年以内的短期股票投资；股票投资时申购资金总额不能超过500万元；投资理财操作程序和风险控制机制如下：财务总监根据资本市场产品，综合考虑风险、收益及流动性等因素，选择适合公司资金特点的产品进行新股申购并将所需资金通知财务人员；计划财务部负责按时将资金准备到位。财务总监和计划财务部负责新股申购的具体操作；新股申购中签后，财务总监和计划财务部应及时卖出所持有的投资理财产品；财务总监要及时监控公司投资理财的盈亏情况，当公司持有的投资理财产品出现亏损时，要及时采取适当的措施

以防止亏损程度超出公司可承受的范围。

(三) 应收票据

(单位: 元)

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
商业承兑汇票	160,000.00	--	--

(四) 应收账款

公司报告期的应收账款情况如下:

(单位: 元)

账 龄	2010年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	3,745,300.20	96.92	122.71	3,745,300.20
1-2年	72,193.72	1.87	14,438.74	57,754.98
2-3年	25,000.00	0.65	--	25,000.00
3-4年	--	--	--	--
4-5年	10,089.45	0.26	9,080.51	1,008.94
5年以上	11,560.00	0.30	11,560.00	--
合计	3,864,143.37	100.00	35,079.25	3,829,064.12
账 龄	2009年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	4,783,754.71	99.03	--	4,783,754.71
1-2年	25,000.00	0.52	--	25,000.00
2-3年	--	--	--	--
3-4年	10,089.45	0.21	9,080.51	1,008.94
4-5年	8,380.00	0.17	7,542.00	838.00
5年以上	3,180.00	0.07	3,180.00	--
合计	4,830,404.16	100.00	19,802.51	4,810,601.65
账 龄	2008年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	4,734,328.44	99.55	31.29	4,734,297.15
1-2年	--	--	--	--
2-3年	10,089.45	0.21	4,035.78	6,053.67
3-4年	8,380.00	0.18	7,542.00	838.00

4-5年	3,180.00	0.06	2,862.00	318.00
5年以上	--	--	--	--
合计	4,755,977.89	100.00	14,471.07	4,741,506.82

公司应收账款较为稳定，对主营业务收入的比例也不高，公司90%以上的应收账款的账龄在1年之内，总体回收情况良好，总体周转情况良好，主要原因是公司的客户信誉度较高以及公司对应收账款的催收和管理效果显著。

截止2010年12月31日，应收账款欠款金额前五名的情况如下：

(单位：元)

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	北京中电华大电子设计有限责任公司	3,421,040.20	1年以内
2	南京微盟电子有限公司	218,160.00	1年以内
3	安靠封装测试(上海)有限公司	72,195.90	1-2年
4	无锡至诚微电子有限公司	37,880.00	1年以内
5	厦门芯阳科技有限公司	25,390.00	1年以内

报告期内，北京中电华大电子设计有限责任公司为公司股东之一，持有公司10%的股份；南京微盟电子有限公司、成都华微电子系统有限公司的股份被公司的控股股东中国华大集团电路设计集团有限公司分别持有45%和61.428%；上述三家公司均为公司的关联方，与公司发生关联交易并形成关联方应收款。

公司不存在以应收债权融资或出售应收债权的情形。

(五) 其他应收款

公司最近两年一期的其他应收款账龄情况及坏账准备计提情况如下表：

(单位：元)

账龄	2010年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	3,090.00	4.68	--	3,090.00
一年至二年	1,240.56	1.88	--	1,240.56
二年至三年	--	--	--	--
三年至四年	--	--	--	--
四年以上	61,692.00	93.44	--	61,692.00
合计	66,022.56	100.00	--	66,022.56
账龄	2009年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额

一年以内	192,260.92	75.64	--	192,260.92
一年至二年	--	--	--	--
二年至三年	--	--	--	--
三年至四年	61,932.00	24.36	--	61,932.00
四年以上	--	--	--	--
合计	254,192.92	100.00	--	254,192.92
账 龄	2008年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	247,039.65	28.75	--	247,039.65
一年至二年	550,255.82	64.04	--	550,255.82
二年至三年	61,932.00	7.21	--	61,932.00
三年至四年	--	--	--	--
四年以上	--	--	--	--
合计	859,227.47	100.00	--	859,227.47

其他应收款余额的性质均为保证金、押金及个人借款，属于可回收性质的款项，故不予计提坏账准备；大部分其他应收款账龄在一年之内，公司其他应收款回收可能性很大，公司未提提取坏账准备。

截至2010年12月31日，公司其他应收款中的前五名客户名单如下：

（单位：元）

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	北京北科永丰公司	55,392.00	4-5年
2	中国华大集成电路设计集团有限公司	6,300.00	4-5年
3	孙洁云	3,000.00	1年以内
4	ELECTROGLAS. INC	1,240.56	1-2年
5	北京德成永兴餐饮有限公司	90.00	1年以内

报告期内，公司应收持公司5%以上表决权股份的股东款项为：公司向中国华大集成电路设计集团有限公司预交的团费6,300元。

（六）预付账款

公司报告期的预付账款情况如下：

（单位：元）

账 龄	2010年12月31日	比例%	2009年12月31日	比例%	2008年12月31日	比例%
1年以内	2,484.00	3.21	209,779.50	100	--	--
1-2年	75,000.00	96.79	--	--	--	--

合计	77,484.00	100	209,779.50	100	--	--
----	-----------	-----	------------	-----	----	----

预付账款 2010 年比 2009 年下降了 63.06%，主要原因是 2009 年预付款项大部分已经转换为商品或者服务。

截至 2010 年 12 月 31 日，金额较大的预付账款（占年末预付账款总额的 30% 及以上）

（单位：元）

欠款人名称	金额	性质或内容
北京东英泰思特测试技术有限责任公司	75,000.00	设备预付款

截至 2010 年 12 月 31 日，无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（七）存货

公司报告期的存货情况如下：

（单位：元）

项目 \ 时间	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
原材料	2,735.04	2,735.04	14,700.54
在产品	8,154,673.95	6,907,722.68	6,515,811.79
库存商品	1,199,208.08	113,710.03	1,570,079.35
周转材料	203,877.31	176,553.70	196,464.46
合计	9,560,494.38	7,200,721.45	8,297,056.14

存货取得时按照实际发生成本入账，发出计价采用的是全月一次加权平均法；低值易耗品领用后采用一次摊销法进入当期损益。

2008 年末，公司的存货余额为 8,297,056.14 元，2009 年末存货余额为 7,200,721.45 元，比上一年度下降了 13.21%，2010 年 12 月 31 日存货余额为 9,560,494.38 元。公司的主要产品及劳务是为集成电路产品提供测试服务，是一个提供专业测试服务为主的公司，库存商品以及原材料所占比重较低，且周转较快。存货中在产品金额较大，主要是由于存货的在产品项目中包括了科技开发成本。2008 年公司开始实行新的会计准则，公司采用新老划断的方式，将在 2008 年 1 月 1 日前立项的研发项目，研发过程中发生的与该课题有关的费用均记入“科技开发成本”账户核算。对于 2008 年 1 月 1 日起政府拨付专项研发资金立项的新项目的核算严格执行新准则，不再记入“科技开发成本”。因此，此处在产品

项下的科技开发成本均为 2008 年 1 月 1 日前所立项的和政府补贴有关的项目所发生的研发费用。2008 年科技开发成本结存金额为 6,348,159.19 元；2009 年末科技开发成本结存金额为 6,697,730.77 元，2010 年 12 月 31 日科技开发成本结存金额为 7,757,412.62 元。上述子产品项下的科技开发成本金额待项目完成验收后予以结转。

科技开发成本的构成及进展情况进行归结如下：

(单位：元)

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	备注
基于国产测试设备及产业化	1,000,000.00	1,016,977.41	1,016,977.41	该项目已于 2009 年通过验收，但至今未收到相关部门的验收确认函
极大规模集成电路测试技术研究及产业化应用（地方）	788,152.29	7,423.00	--	按计划进行，预计 2011 年底完成
极大规模集成电路测试技术研究及产业化应用（中央）	--	2,030.00	--	按计划进行，预计 2011 年底完成
集成电路 SOC 设计测试研究	--	36,902.29	36,902.29	2010 年已验收完毕
信息安全芯片测试图形实时生成技术研发及产业化应用	1,000,000.00	1,014,057.87	1,014,057.87	已完成，因主管部门无验收办法未验收
信息安全芯片测试图形实时生成技术研发及产业化应用（科学院 0801）	--	8,975.50	--	2010 年已验收完毕
智能卡专用测试设备及测试服务项目	2,024,888.22	1,684,105.02	1,367,301.63	该项目已于 2009 年通过验收，但因未收到验收批复必须参加 2010 年的财政决算
WLAN 基带处理器芯片测试技术研发	1,944,372.11	1,925,868.02	1,912,894.99	已完成，2010 年 3 月 15 日已递交验收申请表
高可靠测试连接技术研发	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	公司于 2007 年 12 月 11 日已提交验收申请，因主管部门无验收办法，所以至今未验收

高速芯片低成本测试技术研究	--	1,366.66	--	按计划进行
产业基地北京微电子测试	25.00	25.00	25.00	05年预立项, 最终未获成功, 并于2010年7月最终撤销该项目
合计	7,757,412.62	6,697,730.77	6,348,159.19	

公司属于独立的半导体检测行业, 剔除上述在产品项下的科技开发成本后, 公司的存货流动性强, 库龄较短, 很少积压。

截至2010年12月31日, 公司的存货不存在减值因素, 无需计提跌价准备。

(八) 固定资产

1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

固定资产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧率(%)
房屋、建筑物	5	30	3.17
机器设备	5	10	9.5
运输工具	5	5-10	9.5-19
其他设备	5	5	19

公司固定资产折旧均采用直线法。

2、固定资产原值、累计折旧和净值

2009年固定资产原值、累计折旧和净值情况

(单位: 元)

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
一、原价合计	27,015,348.40	1,319,901.71	-	28,335,250.11
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	26,248,246.40	1,319,901.71	-	27,568,148.11
运输设备	767,102.00	-	-	767,102.00
其他设备	-	-	-	-
二、累计折旧合计	10,524,555.10	3,515,754.06	-	14,040,309.16
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	10,269,338.51	3,409,535.62	-	13,678,874.13
运输设备	255,216.59	106,218.44	-	361,435.03
其他设备	-	-	-	-
三、固定资产减值准备	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	16,490,793.30	-	-	14,294,940.95
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	15,978,907.89	-	-	13,889,273.98
运输设备	511,885.41	-	-	405,666.97

其他设备	-	-	-	-
------	---	---	---	---

2010年固定资产原值、累计折旧和净值情况

(单位:元)

项 目	2009年12月31日	本年增加	本年年减少	2010年12月31日
一、原价合计	28,335,250.11	1,783,112.96	-	30,118,363.07
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	27,568,148.11	1,783,112.96	-	29,351,261.07
运输设备	767,102.00	-	-	767,102.00
其他设备	-	-	-	-
二、累计折旧合计	14,040,309.16	3,533,423.80	-	17,573,732.96
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	13,678,874.13	3,456,702.82	-	17,135,576.95
运输设备	361,435.03	76,720.98	-	438,156.01
其他设备	-	-	-	-
三、固定资产减值准备	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	14,294,940.95	-	-	12,544,630.11
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	13,889,273.98	-	-	12,215,684.12
运输设备	405,666.97	-	-	328,945.99
其他设备	-	-	-	-

公司的机器设备主要为高精技术设备，设备的技术性能良好，会计核算中基于稳健性原则固定资产的预计使用年限估计趋于谨慎，公司生产设备的实际可使用时间均比会计的折旧年限要长，因此公司累计折旧占固定资产原值较大，并不意味着公司机器设备存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况，公司目前固定资产配置影响公司生产的持续经营。

公司固定资产不存在抵押、担保等受限情况。

(八) 无形资产

公司报告期内无形资产均是向外部独立第三方购买取得，如财务、杀毒、管理等方面的软件。

2010年度无形资产及累计摊销情况：

单位:元

项 目	2010年1月1日	本年增加	本年减少	2010年12月31日
①原价合计	277,960.71	4,418.14	--	282,378.85

财务软件	19,256.41	3,812.14	--	23,068.55
标准化自动出图系统	248,024.00	--	--	248,024.00
杀毒软件	135.00	207.00	--	342.00
上网行为管理软件	9,145.30	--	--	9,145.30
开发套件	1,400.00	399.00	--	1,799.00
② 累计摊销合计	172,755.68	56,753.34	--	229,509.02
财务软件	6,023.59	3,713.46	--	9,737.05
标准化自动出图系统	163,215.63	49,604.76	--	212,820.39
杀毒软件	135.00	207.00	--	342.00
上网行为管理软件	1,981.46	2,829.12	--	4,810.58
开发套件	1,400.00	399.00	--	1,799.00
③无形资产账面价值合计	105,205.03	--	--	52,869.83
财务软件	13,232.82	--	--	13,331.50
标准化自动出图系统	84,808.37	--	--	35,203.61
杀毒软件	--	--	--	--
上网行为管理软件	7,163.84	--	--	4,334.72

2009 年度无形资产及累计摊销情况：

单位：元

项目	2009 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
①原价合计	276,560.71	1,400.00	--	277,960.71
财务软件	19,256.41	--	--	19,256.41
标准化自动出图系统	248,024.00	--	--	248,024.00
杀毒软件	135.00	--	--	135.00
上网行为管理软件	9,145.30	--	--	9,145.30
开发套件	--	1,400.00	--	1,400.00
② 累计摊销合计	117,747.12	55,008.56	--	172,755.68
财务软件	3,172.27	2,851.32	--	6,023.59
标准化自动出图系统	112,610.79	50,604.84	--	163,215.63
杀毒软件	135.00	--	--	135.00
上网行为管理软件	1,829.06	152.40	--	1,981.46
开发套件	--	1,400.00	--	1,400.00
③无形资产账面价值合计	158,813.59			105,205.03

财务软件	16,084.14			13,232.82
标准化自动出图系统	135,413.21			84,808.37
杀毒软件	--			--
上网行为管理软件	7,316.24			7,163.84
开发套件	--			--

2008 年度无形资产及累计摊销情况：

单位：元

项目	2008 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2008 年 12 月 31 日
①原价合计	267,280.41	9,280.30	--	276,560.71
财务软件	19,256.41	--	--	19,256.41
标准化自动出图系统	248,024.00	--	--	248,024.00
杀毒软件	--	135.00	--	135.00
上网行为管理软件	--	9,145.30	--	9,145.30
② 累计摊销合计	62,326.90	55,420.22	--	117,747.12
财务软件	320.95	2,851.32	--	3,172.27
标准化自动出图系统	62,005.95	50,604.84	--	112,610.79
杀毒软件	--	135.00	--	135.00
上网行为管理软件	--	1,829.06	--	1,829.06
③无形资产账面价值合计	204,953.51			158,813.59
财务软件	18,935.46			16,084.14
标准化自动出图系统	186,018.05			135,413.21
杀毒软件	--			--
上网行为管理软件	--			7,316.24

(九) 长期待摊费用

(单位：元)

项目	原始成本	摊销期限	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
房屋租赁费	9,712,720.00	48.5 年	8,642,068.39	8,878,293.87	9,078,556.14
经营性租赁房屋装修款	1,577,549.81	5 年	470,171.18	548,884.00	823,326.00
会员费	398,000.00	10 年	291,866.67	-	-
合计	11,688,269.81		9,404,106.24	9,427,177.87	9,901,882.14

房屋租赁费摊销期为 48.5 年，经营性租赁房屋装修款摊销期为 5 年，

会员费为公司购买的果岭券费用摊销期为 10 年。公司对于长期待摊费用均采用直线法进行摊销。

2005 年公司向北科永丰购买了位于北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层 202 号的房屋，作为公司办公、生产场地，双方于 2005 年 11 月 1 日签订了《房屋买卖合同》。合同签订后，公司向北科永丰一次性支付了全部购房款共计 9,712,720.00 元。由于北科永丰方面的原因，房屋权属转让登记手续无法办理，经友好协商，双方同意将房屋产权转让关系变为房产租赁关系，北科永丰将上述房屋分为三期租赁给公司。经公司董事会和股东会批准，公司与北科永丰于 2009 年 12 月 21 日签订了三份房屋租赁协议：《房屋租赁合同（2005 年 11 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日）》、《房屋租赁合同（2024 年 5 月 21 日至 2044 年 5 月 20 日）》、《房屋租赁合同（2044 年 5 月 21 日至 2054 年 5 月 20 日）》，共计 48.5 年。三个房屋租赁合同互相独立，后两份合同属于附期限生效的合同。另外，租赁合同也约定了较高的违约金，保证合同得以顺利履行。

公司在由买改租后进行了房屋及其装修的调整，房屋原值 9,712,720 元，房屋装修款 1,372,210 元。因此合计调减固定资产 11,084,930 元，相应调增长期待摊费用 11,084,930 元。

由于原有的会计政策为：房屋原按 30 年计提折旧，残值率为原值的 5%；房屋装修款按照 5 年计提折旧，残值率为原值的 5%。调整为长期待摊费用后的会计政策为：房屋租赁款按 48.5 年进行摊销，无残值；房屋装修款按照 5 年计提折旧进行摊销，无残值。因此，公司追述调减上述固定资产入账日起至 2007 年底的折旧额，金额为 1,444,148.27 元；同时追溯调整计提长期待摊费用摊销额 1,183,047.86 元；两者差额 261,100.41 元也进行了相应的调整。

房屋改买为租前，房屋每月折旧额为 25,630.79 元，房屋装修每月折旧额为 21,726.66 元，合计 47,357.45 元；改买为租后，房屋租赁费每月摊销额为 16,688.52 元，房屋装修款每月摊销额为 22,870.17 元，合计 39,558.69 元。改买为租后，每月计提摊销额与原固定资产折旧相比减少 7,798.76 元，每年累计减少 93,585.12 元。

由于公司已经支付了全部租赁费用，公司未来也不会因该房屋租赁支付其他的租赁费用，因此公司对该租赁费用采用长期待摊费用的会计处理方式与采用融资租赁的处理方式相比，除了具体的资产科目不同外（采用融资租赁方式会将该资产计入固定资产科目），两种会计处理方法在公司的总资产、负债、权益等资产负债表一致，公司利润表的结果也一致。

（十）主要资产减值准备

1、坏账准备

（1）坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

（2）坏账损失核算方法：本公司采用备抵法核算坏账损失。

（3）坏账准备的计提方法及计提比例：

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

（4）坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例
1-6 个月	不计提坏账
半年-1 年以内	1%
1-2 年	20%
2-3 年	40%
3-5 年	90%
5 年以上	100%

2、持有至到期投资

资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。

3、可供出售金融资产

资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失，

计入当期损益。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

确认减值损失后，在随后的会计期间有客观证据表明公允价值已上升，且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资发生的减值损失转回计入所有者权益，可供出售债务工具投资发生的减值损失转回计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产以及不具有控制、共同控制或重大影响，没有活跃市场且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生的减值损失，不得转回。

4、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

5、资产减值

(1) 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、在建工程、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产

组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(2) 是否存在减值迹象的判断

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

② 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(3) 资产组的认定

以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。上述资产组发生减值的，将该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。

(4) 上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予

转回。

上述计提方法符合会计制度和会计准则的相关规定，有充分依据，比例合理。

6、资产减值损失情况

(单位：元)

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、坏账准备	15,276.74	5,331.44	4,931.18
二、金融资产减值准备			
三、存货跌价准备			
四、其他资产减值准备			
合 计	15,276.74	5,331.44	4,931.18

五、公司报告期重大债务情况

(一) 应付账款

公司报告期的应付账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	483,313.29	57.64%	582,174.42	69.83%	517,889.03	61.50%
1 年以上	356,367.35	42.44%	251,498.53	30.17%	324,163.90	38.50%
合计	839,680.64	100.00%	833,672.95	100.00%	842,052.93	100.00%

截止2010年12月31日，公司应付账款前五名债权单位总金额为696,313.14元，占本公司期末应付账款总额的82.93%。

截至2010年12月31日，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(二) 预收账款

公司报告期的预收账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	--	--	--	--	--	--

1年以上	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（三）应付职工薪酬

公司报告期的应付职工薪酬情况如下：

（单位：元）

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	948,704.51	732,379.20	1,642,476.64
职工福利费	201,892.27	151,102.42	257,818.65
合计	1,150,596.78	883,481.62	1,900,295.29

报告期内，公司无拖欠职工工资情况。

（四）应交税费

（单位：元）

税项	适用税率	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
增值税	17%、3%	80,541.81	61,759.74	7,035.87
营业税	5%	30,529.49	26,058.02	5,123.72
城建税	7%	7,774.99	6,242.70	851.17
企业所得税	7.5%	238,816.96	75,300.62	126,189.56
个人所得税		12,041.85	9,036.51	11,032.38
教育费附加	3%	3,473.42	2,675.44	364.79
合计		373,178.52	181,073.03	150,597.49

（五）其他应付款

公司报告期的其他应付款情况如下：

（单位：元）

账龄	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,440.41	16.29%	188,003.31	48.13%	73,600.74	26.71%
1 年以上	202,606.00	83.71%	202,617.46	51.87%	202,000.00	73.29%
合计	242,046.41	100.00%	390,620.77	100.00%	275,600.74	100.00%

截至 2010 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(六) 其他流动负债

(单位：元)

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
智能卡专用测试设备及测试服务项目拨款	3,618,910.03	3,618,910.03	3,613,938.66
信息安全芯片测试图形实时生成技术研发及产业化应用拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
高可靠测试连接技术研发拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
基于国产测试设备的Flash芯片测试技术研究及产业化拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00
集成电路SOC设计测试研究拨款	--	40,000.00	40,000.00
基于国产测试设备的Flash芯片测试技术研究及产业化拨款	--	40,000.00	--
极大规模集成电路测试技术研究及产业化应用	13,801,466.96	--	--
北京集成电路测试技术服务平台拨款	--	--	1,360,813.08
高速芯片低成本测试技术研究拨款	64,233.42	513,831.61	--
物业费	13,658.35	18,818.35	3,725.00
租赁费	701,237.94	736,155.27	1,021,061.10
水费	--	3,690.00	3,558.00
其它	70,651.60	40,729.20	86,520.00
供暖费	8,691.65	13,842.43	--
合 计	21,278,849.95	8,025,976.89	8,929,615.84

公司2010会计年度前执行控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司《执行新准则主要会计政策规定试行》第九条对“递延收益”的处理方式规定：“递延收益，核算公司收到的政府无偿支持的除固定资产等资本性支出以外的研发资金，收到时确认递延收益（报表归类为“其他流动负债”）。”

公司从2011会计年度起严格执行企业会计准则，根据新拟定的《中国华大计财字[2010]020号》第二条第二款之规定“加强会计核算管理，保持会计政策、会计估计的一贯性。根据华大集团统一要求，‘递延收益’科目的余额列入报表项目‘其他非流动负债’中。”

六、公司报告期股东权益情况

(单位：元)

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
实收资本(或股本)	23,800,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	11,860,688.15	3,921,031.89	3,921,031.89
减：库存股	-	-	-
盈余公积	395,807.63	1,465,736.54	1,411,550.57
未分配利润	3,562,268.68	9,630,693.46	11,143,019.67
所有者权益合计	39,618,764.46	35,017,461.89	36,475,602.13

注：2010年11月，公司由有限公司整体变更为股份公司，以截止2010年3月31日的净资产35,660,688.15元，折为2,380万股，每股面值1元，剩余净资产11,860,688.15元转为资本公积。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方

关联方指：公司控股股东；持有公司股份5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

1、存在控制关系的关联方

中国华大集成电路设计集团有限公司（以下简称“中国华大”）直接持有公司1071万股股份，占公司股份总数的45%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

中国华大的股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）和国投高科分别持有其50%的股权，根据中国华大及公司的说明，中国电子是国务院国资委直接管理的国有独资特大型集团公司，代表国务院国资委对中国华大

履行出资人职责，为中国华大的控股股东及公司的实际控制人。

中国华大集成电路设计集团有限公司，注册登记号：1100001618870；法定代表人：卢明；住所：北京市朝阳区高家园一号；注册资本：36,700 万元；经营范围：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、

仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

中国电子信息产业集团有限公司，注册登记号：100000000010245；法定代表人：熊群力；住所：北京市万寿路 27 号；注册资本：793,002.2 万元。经营范围：许可经营项目：（无）；一般经营项目：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
刘晋平	董事长
张东	董事
宋矗林	董事
王彤	董事、总经理
姜世平	董事
蔡艳玲	监事会主席
张志杰	监事
程京霞	监事
晏云	财务总监、董事会秘书
肖钢	总工程师

张琳	高级工程师
候政嘉	工程师
石志刚	工程师
吉国凡	工程师
北京自动测试技术研究所	本公司参股股东
北京中电华大电子设计有限责任公司	本公司参股股东

3、受实际控制人控制的其他企业

企业名称	组织机构代码	与本公司的关系
南京微盟电子有限公司	716209811	同一母公司
北京华大九天软件有限公司	690013756	同一母公司
成都华微电子系统有限公司	720342949	同一母公司
华大智宝电子系统有限责任公司	769354027	同一母公司
国民技术股份有限公司	715284481	同一母公司
中国电子进出口总公司	--	最终控制方控制的其他企业
中国电子器材总公司	--	最终控制方控制的其他企业
中国瑞达系统装备有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
华北计算机系统工程研究所	--	最终控制方控制的其他企业
中国电子产业开发公司	--	最终控制方控制的其他企业
武汉中原电子集团有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
深圳桑达电子集团有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
中国电子工业上海公司	--	最终控制方控制的其他企业
中国电子物资总公司	--	最终控制方控制的其他企业
中国电子系统工程总公司	--	最终控制方控制的其他企业
北京华利计算机公司	--	最终控制方控制的其他企业
长城开拓投资管理有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
深圳市爱华电子有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
国营长海机器厂	--	最终控制方控制的其他企业
中国电子科技开发有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
烟台科信房地产开发有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
北京中电昌盛投资管理有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
中国电子集团控股有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	--	最终控制方控制的其他企业

北京长城高腾信息产品有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
金峰通信有限责任公司	--	最终控制方控制的其他企业
长城科技股份有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
上海华虹（集团）有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
中电广通股份有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
中国软件与技术服务股份有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
中电新视界技术有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
夏新电子有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
中电华清微电子工程中心有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
中国电子财务有限责任公司	--	最终控制方控制的其他企业
中国电子为华实业发展有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
建设综合勘察研究设计院	--	最终控制方控制的其他企业
上海浦东软件园股份有限公司	--	最终控制方控制的其他企业
长城信息产业股份有限公司	--	最终控制方控制的其他企业

（二）关联交易

1、关联销售

①销售商品

（单位：元）

关联方名称	2010年		2009年		2008年	
	金额（元）	占年度同类交易比例 %	金额（元）	占年度同类交易比例 %	金额（元）	占年度同类交易比例 %
北京中电华大电子设计有限责任公司	13,241,670.40	75.85	10,133,465.01	76.17	12,538,446.97	77.75
国民技术股份有限公司	53,901.54	0.31	48,371.95	0.36	--	--
南京微盟电子有限公司	1,669,410.26	9.56	811,632.45	6.1	370,136.78	2.3
合计	14,964,982.29	85.72	10,993,469.41	82.63	12,908,583.75	80.05

②2009年度营业收入中收取北京中电华大电子设计有限责任公司设备租赁费 384,500.00 元，2010年收取设备租赁费 475,784.00 元，主要是上述客户因

涉及技术的保密性和工艺的特殊性要求自行进行测试，公司收取机时租赁费。

2、关联采购

中国华大拥有一套集成电路测试设备（泰瑞达 J750 测试机以及探针台、适配器等配套设备），由于中国华大并不从事集成电路测试服务业务，因此公司向中国华大租赁该套测试设备，设备租金为 300,000 元每年，公司 2008 年度应支付给中国华大设备租赁费 300,000.00 元，实际支付 550,000 元（含前期应付未付）；2009 年度支付租赁费 300,000.00 元；2010 年度支付租赁费 300,000.00 元（含前期应付未付）。

3、关联往来

（单位：元）

企业名称	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	百分比%	金额	百分比%	金额	百分比%
应收账款：						
北京中电华大电子设计有限责任公司	3,421,040.20	88.53	3,877,120.80	80.26	3,716,136.31	78.14
成都华微电子系统有限公司	25,000.00	0.65	25,000.00	0.52	25,000.00	0.53
南京微盟电子有限公司	218,160.00	5.65	371,150.00	7.68	62,500.00	1.31
合计	3,664,200.20	94.83	4,273,270.80	88.46	3,803,636.31	79.98
其他应收款：						
中国华大集成电路设计集团有限公司	6,300.00	9.54	6,300.00	2.48	6,300.00	0.73
合计	6,300.00	9.54	6,300.00	2.48	6,300.00	0.73
应付账款：						
中国华大集成电路设计集团有限公司	--	--	150,000.00	17.99	150,000.00	17.81
合计	--	--	150,000.00	17.99	150,000.00	17.81
其他应付款：						
中国华大集成电路设计集团有限公司	606.00	0.25	--	--	--	--
合计	606.00	0.25	--	--	--	--

（三）关联交易决策程序执行情况

有限责任公司阶段，公司没有制定关联交易的相关管理制度，但公司与关联方之间交易的交易均以市场价格或公允性价格作为定价基础。

2010年11月，公司整体变更为股份公司后，制定了《关联交易决策制度》，制度规定公司与关联方之间的交易均以市场价格或公允性价格作为定价基础，且重大关联交易须履行了必要的授权和审批程序。《关联交易决策制度》制定至2010年12月31日，尚未发生重大关联交易须履行了必要的授权和审批程序。

八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及本公司《章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取10%法定盈余公积；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

（二）报告期内的分配情况

2009年3月26日，公司对上一年度利润进行分配，分配金额2,000,000元（含税）。

十、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）偿债能力分析

2008年末、2009年末和2010年末公司的资产负债率分别为24.91%、22.75%和37.61%，总体保持平稳，并处于较低水平，长期偿债风险较小。

2008年、2009年和2010年公司的流动比率分别为1.81、2.08和1.74，速动比率分别为1.13、1.36和1.33。上述两项财务指标平稳，都在安全边际范围之内，且公司在报告期内的流动负债均大多数商业信用产生的，公司短期偿债风险较小。

（二）盈利能力分析

公司2008年、2009年和2010年的毛利率分别为51.29%、36.61%和62.91%，公司2009年度毛利率有所降低的主要原因是公司作为国内指定的四家二代身份证专用芯片检测机构之一，拥有成熟的技术，毛利率平均维持在约60%。但随着二代身份证业务随着身份证换领工作的结束，业务量急剧萎缩，该业务总量下降后，毛利率也因无规模效应而下降，这就导致公司整体毛利率的降低；此外，2009年受金融危机影响，为了保证业务量不受影响和充分利用机时，公司适当调低了测试服务价格，导致2009年度公司毛利率有所下降。

2010年公司进行了技术革新，各种产品测试能力增强；另一方面，公司加大营销力度，与客户的合作加深，改变了单一产品结构的现象，市场份额得到较大提高。2010年公司中测业务的出货量比上年增长33%，且中测业务的毛利率较上一年度提高；成测业务是改变了过去的小批量多品种的格局，规模效益得以体现。所以2010年公司的毛利率和收益均有较大提高。

2008年、2009年和2010年公司的净资产收益率分别为0.65%、1.55%和11.61%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为0.64%、0.33%和9.55%；2008年度、2009年和2010年公司的每股收益分别为0.01元、0.03元和0.22元，扣除非经常性损益后每股收益分别为0.01元、0.01元和0.18元。

（三）营运能力分析

公司的应收账款周转率较低的原因是公司的有的业务正处于发展阶段, 尚未达到规模化产出, 总体营业收入较低所致; 但公司应收账款账龄大都在一年以内, 客户诚信度高回款及时, 因此公司的营运能力仍然较强。随着业务规模不断扩大, 销售收入的增长会使得应收账款周转率回到正常水平。

2008年、2009年和2010年公司的存货周转率分别为1.03、1.09和0.77, 存货周转率较低的主要原因是存货中科技开发成本占比较大, 剔除该因素影响, 修正存货周转率分别为5.77、6.88、5.62, 周转率保持稳定且较快。

总体而言, 公司的营运能力较强。

(四) 现金流量状况分析

(单位: 元)

项目 \ 时间	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,566,280.28	4,473,338.26	3,365,690.22
投资活动产生的现金流量净额	10,267,189.95	-1,439,731.08	-2,211,485.85
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,920,000.00	-5,109,395.00
合计	18,833,470.23	1,113,607.18	-3,955,190.63

上表显示, 2008年、2009年和2010年公司整体经营活动产生的现金流量净额为正, 且基本保持稳定, 从公司现金流量净额与经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的关系来看, 除去2008年公司归还2007年短期借款、2009年公司进行分配利润和2010年公司收到政府拨款研发资金1,775万以外, 公司的现金及现金等价物的增减变化主要取决于公司的经营活动, 从这个角度出发, 公司经营活动的正常运转也决定了公司现金流量的正常和健康。

第十一章 备查文件

- (一) 公司章程;
- (二) 审计报告;
- (三) 法律意见书;
- (四) 北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函;
- (五) 公司董事会、股东大会有关股份报价转让的决议及股东大会授权董事会处理相关事宜的决议。

(正文完)

(本页无正文，为北京确安科技股份有限公司股份报价转让说明书的签字、盖章页)

(董事签字)

王 张 李 李
李



北京确安科技股份有限公司董事会

2011年 7月 25日